

民國八十九年度年報

300mm

200mm

150mm

**tsmc**

台灣積體電路製造股份有限公司

## 辦事處名稱

公司本部及晶圓二廠、五廠  
300 新竹科學工業園區園區三路121號  
電話 : 886-3-578-0221  
傳真 : 886-3-578-1546

晶圓一廠  
310 新竹縣竹東鎮中興路四段195號67館  
電話 : 886-3-582-1240  
傳真 : 886-3-582-2616

晶圓三廠、四廠  
300 新竹科學工業園區研新一路9號  
電話 : 886-3-578-1688  
傳真 : 886-3-578-1548

晶圓六廠  
741 台南縣善化鎮南科北路1號  
電話 : 886-6-505-2000  
傳真 : 886-6-505-2058

晶圓七廠  
300 新竹科學工業園區研新二路6號  
電話 : 886-3-578-5112  
傳真 : 886-3-578-2038

晶圓八廠  
300 新竹科學工業園區力行路25號  
電話 : 886-3-567-8888  
傳真 : 886-3-566-2051

美國子公司  
2585 Junction Avenue, San Jose,  
CA 95134, U.S.A.  
電話 : 1-408-382-8000  
傳真 : 1-408-382-8008

歐洲子公司  
World Trade Center, Strawinskylaan 1145,  
1077 XX Amsterdam, The Netherlands  
電話 : 31-20-305-9900  
傳真 : 31-20-305-9911

日本子公司  
21Fl., Queen's Tower C, 2-3-5,  
Minato, Mirai, Nishi-ku, Yokohama,  
Kanagawa, 220-6221, Japan  
電話 : 81-45-682-0670~2  
傳真 : 81-45-682-0649

## 公司發言人

姓名 : 陳國慈  
職稱 : 資深副總經理  
電話 : 886-3-578-0221  
傳真 : 886-3-578-1545

## 簽證會計師

事務所名稱 : 勸業會計師事務所  
會計師姓名 : 黃樹傑、魏永熹  
105 台北市民生東路三段156號12樓  
電話 : 886-2-2545-9988  
傳真 : 886-2-2545-9966

## 辦理股票過戶機構

中國信託商業銀行代理部  
100 台北市重慶南路一段83號5樓  
電話 : 886-2-2361-3033  
傳真 : 886-2-2311-6723

## 美國存託憑證(ADR)存託銀行

Citibank, N.A.  
Depository Services Department  
20Fl., 111 Wall Street, New York,  
NY 10005, U.S.A.  
電話 : 1-212-657-2770  
傳真 : 1-212-825-5398

## 公司網址

<http://www.tsmc.com.tw>

300mm

200mm

150mm

# 目 錄

## 致股東報告書

### 公司概況

- 一、公司簡介
- 二、公司組織
- 三、公司資本及股份、特別股、公司債及參與發行海外存託憑證之發行情形

### 營運概況

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷
- 三、市場分析
- 四、勞資關係
- 五、從業員工
- 六、環保支出資訊
- 七、重要契約
- 八、訴訟或非訴訟事件

### 營業及資金運用計劃

- 一、民國九十年度產銷計劃
- 二、民國九十年度處分或取得不動產或長期投資計劃
- 三、研究與發展
- 四、資金運用計劃
- 五、台積電文教基金會

### 財務概況

- 一、簡明資產負債表
- 二、簡明損益表
- 三、財務分析
- 四、每股淨值、盈餘、股利及市價
- 五、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
- 六、監察人審查報告書
- 七、財務狀況及經營結果之檢討與分析
- 八、財務報表暨會計師查核報告書
- 九、合併財務報表暨會計師查核報告書

### 特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、公司股利政策及執行狀況
- 三、內部控制制度執行狀況
- 四、其他必要補充說明事項

# 經營理念

堅持高度職業道德

專注於「專業積體電路製造服務」本業

放眼世界市場，國際化經營

注意長期策略，追求永續經營

客戶是我們的夥伴

品質是我們工作與服務的原則

鼓勵在各方面的創新，確保高度企業活力

營造具挑戰性、有樂趣的工作環境

建立開放型管理模式

兼顧員工福利與股東權益，盡力回饋社會

# 致股東報告書

各位股東女士、先生：

台積公司一直致力於做一個全球最有聲譽、以服務為導向，並替客戶創造最大利益的專業積體電路製造服務公司，因而成為獲利最高的一流半導體企業。秉持著這個願景，在民國八十九年之中，我們以最先進的技術、充沛的產能以及更為即時的服務，不斷強化與客戶之間的合作關係，為公司的長期發展奠下更紮實的根基。

## 技術精進

民國八十九年當中，本公司持續為客戶提供最先進的製程技術，以提升其全球市場競爭力。我們不但在市場主流的0.13微米製程發展上表現卓越，首次超越了國際半導體技術藍圖（ITRS，International Technology Roadmap for Semiconductors）。在主流的邏輯製程之外，各種先進製程技術也都十分完備，如混合訊號、射頻、矽鍍、雙載子互補式金氧半導體、嵌入式記憶體、高電壓元件、互補式金氧半導體影像感測器等，可以服務不同客戶的所有需求。而以0.13微米製程為例，八十九年底我們已經陸續利用多種不同的核心邏輯、高速、低功率以及微處理器等製程，為客戶順利產製出多款積體電路產品。

本公司在製程技術上的領導地位，不僅有助於客戶提升其競爭力，也對我們的獲利助益良多。在八十九年第四季的營收中，先進的0.25、0.18、0.15以及0.13微米製程產品已經佔本公司營收的二分之一，大幅提升了整體的獲利能力。

## 產能擴充

在八九年六月底，本公司完成了與德碁、世大兩家公司的合併，滿足了客戶立即的大量產能需求。同時，在八九年中還投入新台幣1,140億元來積極提升產能，以配合客戶的成長需求：我們位於台南科學工業園區的全球最大單一八吋晶圓廠房—晶圓六廠，率先在三月份啓用；年底，在晶圓六廠的十二吋晶圓生產線，更成功

In 2000, TSMC delivered foundry's first 300mm customer wafers.



董事長 張忠謀

總經理 曾繁城

地為客戶產出第一批十二吋晶圓產品，帶動全球半導體製造服務業進入全新的紀元；而另外在興建中的尚有兩座十二吋晶圓廠，分別是位於新竹的晶圓十二廠以及位於台南的晶圓十四廠。

在轉投資方面，位於新加坡的合資公司-SSMC 建廠進度超前，八十九年九月間已成功生產出首批晶圓，成為本公司下一個產能擴充的重要據點。同年十二月，本公司提高對WaferTech 公司的持股比率至近100%，為我們在北美地區的產能擴張與營運策略做出更佳的佈局。

藉由以上的各項努力，本公司八十九年全年晶片產量擴增到340 萬片八吋晶圓（約當量），較八十八年的180 萬片八吋晶圓約增加了九成。

#### **強化線上服務**

為了讓客戶能夠專注於提升產品創意層次，本公司在八十九年中率先結合全球一流的積體電路設計自動化領導廠商、元件資料庫和半導體智財供應商以及產品設計執行服務業者，開創了設計服務聯盟（Design Service Alliance）。透過此項聯盟的服務，客戶可以非常方便地取得並採用各式各樣經過本公司製程驗證過的半導體智財產品與服務。

在同一年中，我們更依照個別客戶需求，為其量身打造了「個人化」線上服務系統，透過這項透明化的資訊服務，強化了客戶的營運以及供應鏈效能。此項服務在大幅縮短客戶新產品量產時程的同時，也協助客戶降低了生產成本。

#### **營收獲利創新高**

民國八十九年對全球半導體產業和專業積體電路製造業來說，都是大幅成長的一年，而本公司的種種努力，也充分地反映在亮麗的營收獲利上。其中八十九年全年的營收淨額新台幣1,662 億2 仟8 佰萬元，稅後純益新台幣651 億6 佰萬元，比八十八年分別成長了127.3% 與165.1%，雙雙創下歷史新高紀錄。至於八十九年全年每股盈餘則達到新台幣5.71 元，亦較八十八年大幅成長。

#### **獲獎與肯定**

除了亮麗的財務成績外，在過去一年中，我們在經營管理上的卓越成績，以及對品質、環境與安全衛生管理的實際作為，也贏得多項國內外機構的認可與媒體的肯定。本公司除了成為台灣第一家取得OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統驗證的半導體公司外，晶圓五廠也被Semiconductor International 雜誌選為全年度全球表現最佳的半導體晶圓廠之一。

此外，在天下雜誌的標竿聲望調查中，我們已經連續四年蟬連冠軍，同時也因為善盡企業的社會責任，榮獲全國最佳企業公民排行的第一名；在遠東經濟評論的民國八九年亞洲200 大企業排行榜中，我們亦再度高居台

灣十大企業榜首；而在Cheers 雜誌民國八十九年「大學生最愛的一百家企業」調查中，本公司則榮膺全國大學生的首選。

### 未來展望

對比民國八十九年全球半導體產業景氣的過熱氣氛，一般預料民國九十年的景氣將趨於平緩。然而，就長期而言，本公司所開創的專業積體電路製造服務業的成長則仍將繼續超越整體半導體產業的水準。

前瞻未來，本公司除了與專業積體電路設計公司、整合元件製造大廠、系統公司等客戶群繼續維持密切合作外，我們在全球半導體產業的技術發展上，也將扮演更為重要的角色。在這方面，我們將持續大幅增加研究發展預算來開發新的製程，也將全力擴充十二吋晶圓產能，以因應全球半導體產業未來快速成長的需求。

最後，要再次感謝我們所有的客戶、股東以及全體同仁，因為您們不斷的支持與貢獻，本公司才得以在民國八十九年中成就了創記錄的佳績，在此謹致上最誠摯的謝忱！

董事長 張忠謀

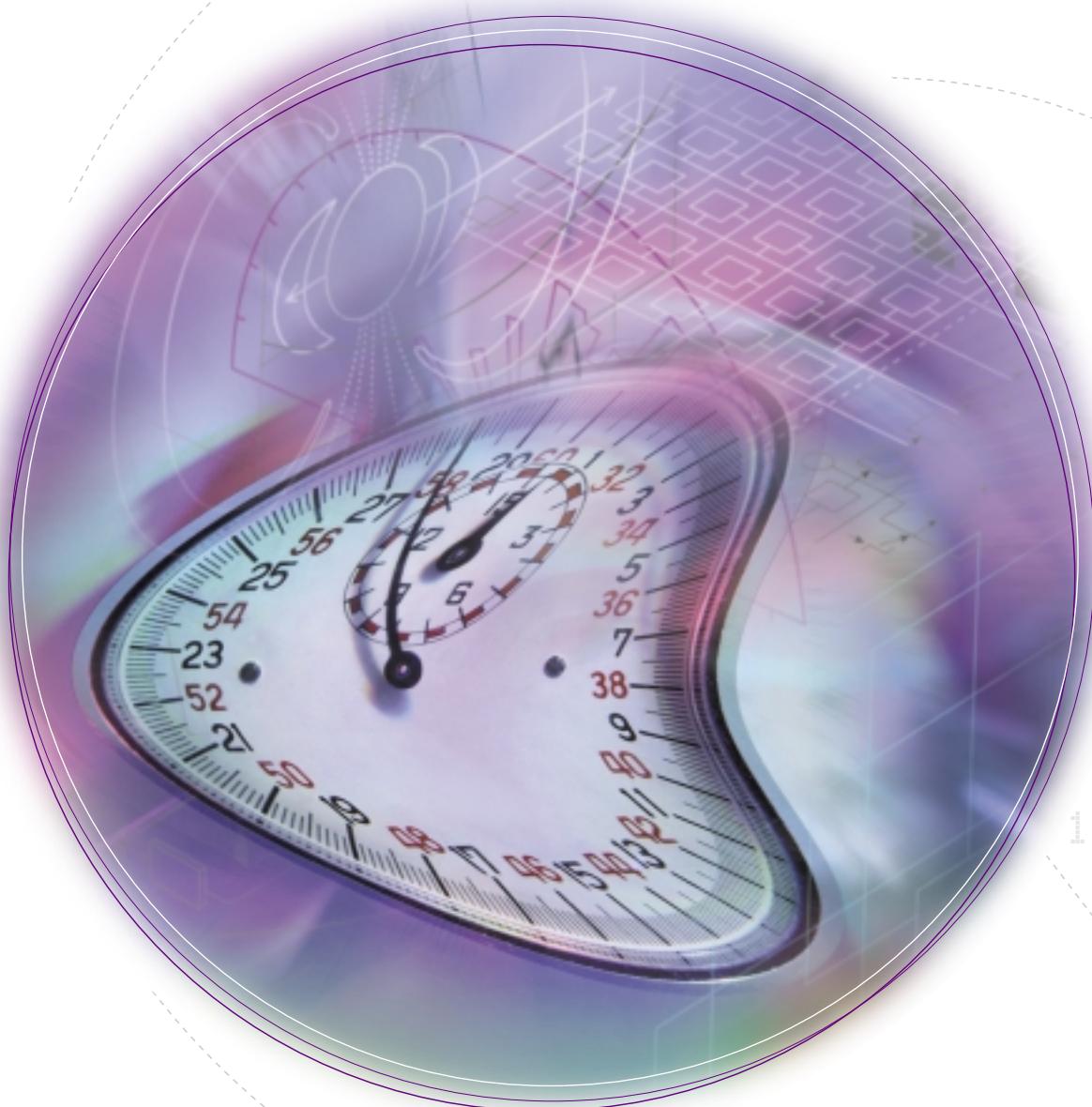
總經理 曾繁城

300mm

做一個全球最有聲譽、以服務為導向、並替客戶創造  
最大利益的專業積體電路製造服務公司，  
因而成為獲利最高的一流半導體企業。

# Trust

200mm



150mm

## 一、公司簡介

台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積公司），成立於民國七十六年，並於民國八十三年成為在台灣證券交易所掛牌之上市公司。本公司之美國存託憑證亦於民國八十六年在美國紐約證券交易所（NYSE）以TSM為代號開始掛牌交易。

本公司總部位於有台灣矽谷之稱的新竹科學工業園區，是全球第一家以最先進的製程技術提供專業積體電路製造服務（即一般所謂「晶圓代工」）的公司，專注於提供所有的產能為客戶服務，而不從事設計或生產自有品牌產品。由於此項策略與堅持，使本公司成立以來，不但成為全球積體電路業者最忠實的伙伴，促成了全球無晶圓廠設計公司的蓬勃發展，更確立了全球半導體產業的專業分工模式，並帶動全球專業積體電路製造服務發展成為一個年營業額達到百億美元的產業，而在半導體產業持續分工以及新晶圓廠投資日益龐大的趨勢下，專業積體電路製造服務公司已經逐漸成為全球半導體製造產能的主要供應來源。

為了確保提供客戶豐沛的產能及保持生產彈性，有計劃地提昇產能是本公司的經營策略之一。截至民國八十九年底，本公司在台灣設有六吋積體電路晶圓廠兩座（晶圓一、二廠），八吋晶圓廠六座（晶圓三、四、五、六廠、七廠及八廠），也管理部分投資公司世界先進公司的產能。同時，在全球佈局上，本公司亦擁有位於新加坡的合資公司SSMC以及在美國轉投資子公司WaferTech公司的充沛產能支援。總計民國八十九年台積公司共產出340萬片八吋晶圓（約當量），是全世界最大的專業積體電路製造服務公司。

在全球最先進的十二吋製程產能上，本公司位於台南科學園區的晶圓六廠中全台灣第一條十二吋生產線已經在民國八十九年開始生產。此外，本公司正在新竹及臺南興建兩座純十二吋晶圓廠--晶圓十二廠及十四廠，將分別於民國九十年第四季及九十一年開始生產。

除了充沛的產能之外，我們也一直為客戶提供全面的各類積體電路製程製造服務，例如互補金氧半導體邏輯製程（CMOS Logic）、類比 / 數位混合製程（mixed-signal）、射頻互補金氧半導體邏輯製程（RF CMOS Logic）、單晶片或嵌入式（embedded）記憶體製程、雙載子互補金氧半導體製程（BiCMOS），以及銅製程技術來充份滿足不同客戶的各種需求。此外，本公司亦不斷開發新一世代之量產製程技術，以確保技術領先的優勢。

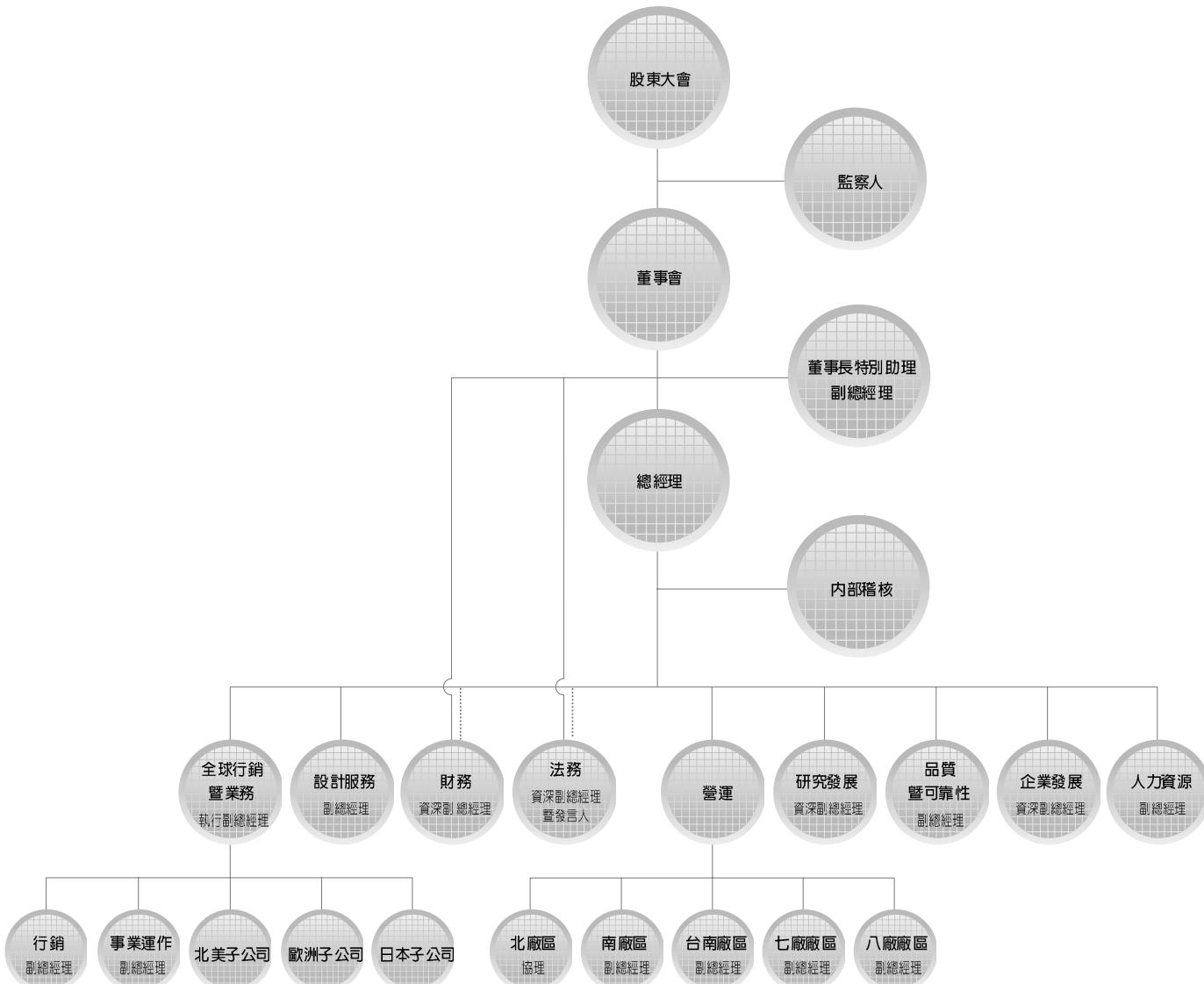
要在專業積體電路製造服務業中贏得長期勝利，服務水準尤為關鍵所在。本公司提出成為客戶「虛擬晶圓廠」的願景，其目標就是提供客戶最好的服務，提供客戶得到相當於擁有自己的晶圓廠的便利與好處，更能免除客戶自行設廠所需的大筆資金及管理上的問題。在此策略領導下，台積公司提出業界首創的eFoundry服務理念，積極地將更多的客戶服務內容延伸至網際網路上，建立更即時便捷的溝通模式。

本公司自成立以來，一直致力於技術及市場的領先，並以實際行動回饋員工、股東及社會大眾，在民國八十七年正式成立「財團法人台積電文教基金會」，積極推動教育、科技、藝術及文化在台灣社會生根，並因應社會各方面的需求，每年主動規劃、贊助各種長、中、短期的公益計劃。此外，本公司歷年來屢獲政府單位頒發環境保護、污染防治、工業安全、人力培訓、員工福利、熱心公益等績優企業獎項，並多次被中外著名媒體評選為台灣最佳標竿企業。

董事長張忠謀博士於民國八十八年獲得全球無晶圓廠半導體產業協會（Fabless Semiconductor Association）頒贈有史以來的第一座「Exemplary Leadership Award」，並將此獎項改以張董事長的英文名字命名，訂為「The Dr. Morris Chang Award for Exemplary Award」，以表彰張董事長對全球專業積體電路設計產業的卓越貢獻。此外，張董事長在民國八十九年更獲頒國際電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）成立以來第一座「Robert N. Noyce Medal」，表揚張董事長其創立專業積體電路製造服務產業的先知卓見與貢獻。

## 二、公司組織

(一) 組織系統圖



本資料基準日為89年12月31日

## (二) 董事、監察人及主要經理人

本資料基準日為89年12月31日

職稱 姓名	就任日期	任期	持有股份*	配偶／未成年子女持有股份*	主要學經歷	備註
董事長 張忠謀	89.4.14	三年	57,634,912	-	美國史丹福大學電機工程博士 / 世界先進積體電路（股）公司董事長	
董事 范德普	89.4.14	三年	1,658,733,948	-	荷蘭 Eindhoven 技術大學電子工程系 / 飛利浦半導體國際（股）公司總裁暨執行長	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 羅貝茲	89.4.14	三年	1,658,733,948	-	荷蘭 Erasmus 大學商業經濟系 / 飛利浦半導體國際（股）公司財務總長	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 許祿寶	89.4.14	三年	1,658,733,948	-	國立成功大學物理系 / 飛利浦在台各企業組織諮詢資政	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 施振榮	89.4.14	三年	2,159,520	-	國立交通大學電子工程碩士 / 宏碁集團董事長	積成投資有限公司代表人
董事 史欽泰	89.4.14	三年	1,413,936,368	-	美國普林斯頓大學電機博士 / 工業技術研究院院長	行政院開發基金管理委員會代表人
董事兼 總經理 曾繁城	89.4.14	三年	16,942,109	49,828	國立成功大學電機工程博士 / 世界先進積體電路（股）公司董事	
監察人 樊富利	89.4.14	三年	1,658,733,948	-	荷蘭 Erasmus University / Delft University of Technology 企業管理碩士 / 飛利浦在台各企業組織執行副總裁	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
監察人 許欽洲	89.4.14	三年	1,413,936,368	-	美國約翰霍浦金斯大學經濟系博士候選人 / 行政院開發基金副執行秘書	行政院開發基金管理委員會代表人
監察人 簡學仁	89.4.14	三年	1,005,120	-	美國麻省理工學院化工碩士 / 世界先進積體電路（股）公司總經理	欣瑞投資有限公司代表人

\* 以上所列董事持有股數為89年12月31日實際持有股數

## (三) 台灣積體電路製造股份有限公司法人股東董監事相關資料

本資料基準日為89年12月31日

法人股東名稱	股權比例達百分之十以上或股權比例占前十名之股東名稱
荷蘭商飛利浦電子股份有限公司	股權比例達百分之十以上之股東名稱：無。 股權比例占前十名之股東名稱：因荷蘭當地實務之限制，無法提供。
行政院開發基金管理委員會	行政院開發基金
積成投資有限公司	台積電及功成、啓信、柏成、欣瑞、承暉等投資有限公司
欣瑞投資有限公司	台積電及功成、啓信、柏成、積成、承暉等投資有限公司

### 三、公司資本及股份、特別股、公司債及參與發行海外存託憑證之發行情形

#### (一) 資本及股份

單位：股份

股份種類	核定股本				合計	
	已發行股份			未發行股份		
	已上市（櫃）	未上市（櫃）	合計			
記名式普通股	11,689,364,587	-	11,689,364,587	3,433,034,095	1,377,601,318	17,800,000,000
記名式特別股	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-	

#### (二) 特別股發行情形

發行	發行日期	期間	股利率	流通在外股數	資金用途	執行情形
記名式特別股	89.11.29	2.5 年	3.5%	1,300,000,000	購置晶圓十二廠機器設備	進行中

#### (三) 公司債發行情形

種類	發行日期	期間	票面利率 (或到期值利率)	流通在外金額	資金用途	執行情形
新台幣四十億元普通公司債	87.03.04	五年	年息7.71%	新台幣四十億元	償還銀行借款	已完成
新台幣六十億元普通公司債	87.11.18 - 87.12.01	五年	年息7.12%	本公司已於 89.11.18 - 89.12.02 分別贖回本公司債各券		
新台幣一百億元普通公司債	88.10.21	甲類:三年 乙類:五年	甲類: 年息5.67% 乙類: 年息5.95%	甲類: 新台幣五十億元 乙類: 新台幣五十億元	轉投資德基半導 體股權及購買晶 圓五廠機器設備	已完成
新台幣一百五十億元普通公 司債	89.12.04 - 89.12.15	甲類:五年 乙類:七年	甲類: 年息5.28% 乙類: 年息5.36%	甲類: 新台幣一百零五億元 乙類: 新台幣四十五億元	購買晶圓八廠機 器設備	已募集 完成

#### (四) 美國存託憑證發行情形

發行及上市地點：紐約證券交易所

代號：TSM

一單位美國存託憑證代表五單位台積電普通股

存託銀行：花旗銀行 - 紐約分行

保管銀行：花旗銀行 - 台北分行

截至八十九年十二月三十一日，本公司美國存託憑證總發行數為145,071,739單位，流通在外之美國存託憑證數量為  
144,608,739單位

發行日期	發行數量*	發行金額（美金）	表記有價證券來源
民國八十六年十月八日	24,000,000 單位	594,720,000	本公司股東所持有之台積電普通股
民國八十七年十一月二十日	12,094,000 單位	184,554,440	本公司股東所持有之台積電普通股
民國八十八年一月十二日至 民國八十八年一月十四日	2,000,000 單位	35,500,000	本公司股東所持有之台積電普通股
民國八十八年七月十五日	12,094,000 單位	296,499,641	本公司股東所持有之台積電普通股
民國八十八年八月二十三日至 民國八十八年九月九日	5,486,000 單位	158,897,088.5	本公司股東所持有之台積電普通股 (依據本公司存託憑證轉換銷售辦法辦理)
民國八十九年二月二十二日至 民國八十九年三月八日	6,560,000 單位	379,134,598.8	本公司股東所持有之台積電普通股 (依據本公司存託憑證轉換銷售辦法辦理)
民國八十九年四月十七日	4,000,000 單位	224,640,000	本公司股東所持有之台積電普通股
民國八十九年六月七日 民國八十九年六月十五日	32,667,800 單位	1,167,873,850	現金增資 本公司股東所持有之台積電普通股

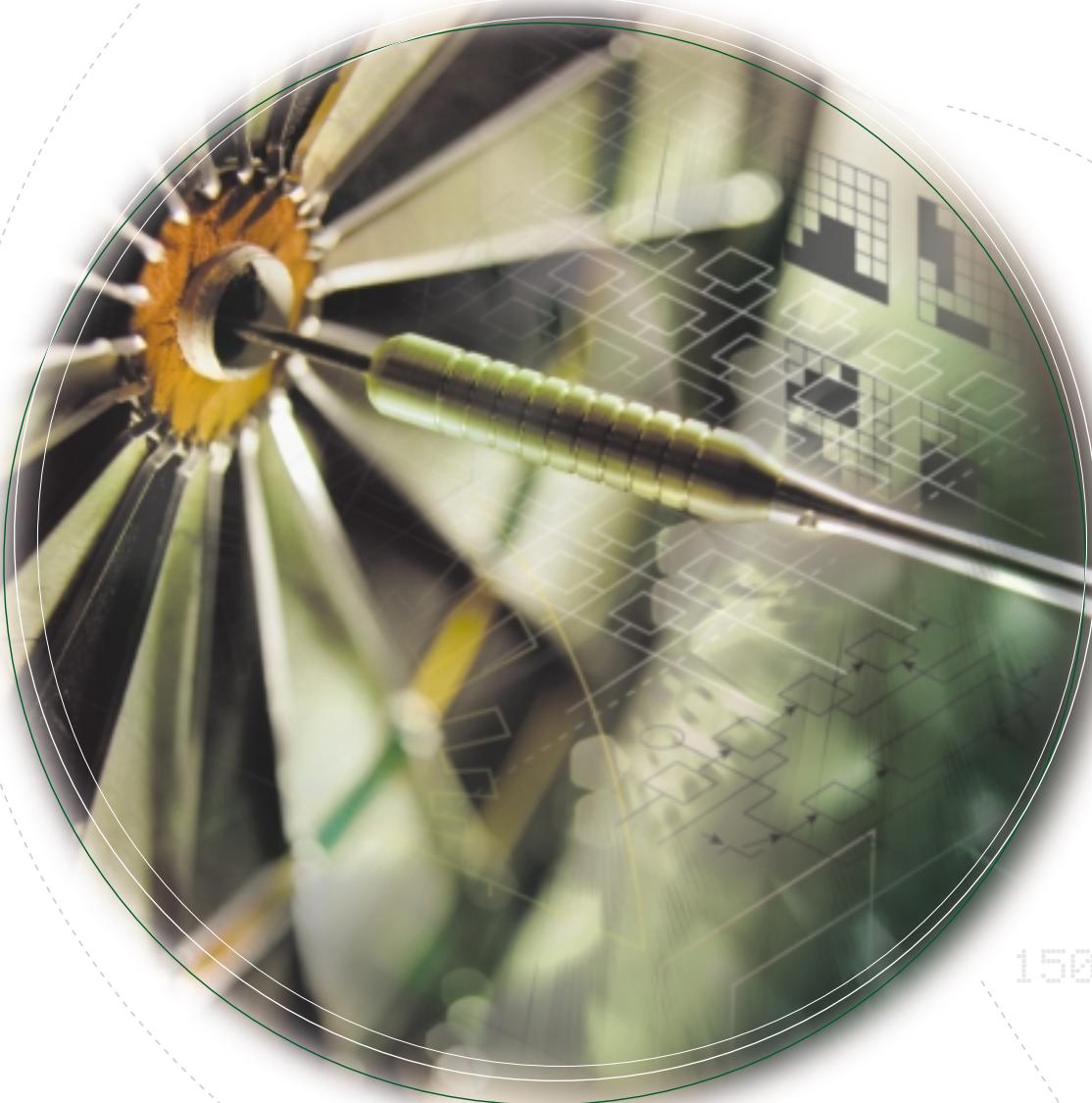
\* 本公司美國存託憑證總發行數量與各次發行數量總合之差異係由於民國八十七年、八十八年及八九年股票股利之發放所致，其配股率分別為45%，23%及28%。

300mm

# ►►Focus

做一個全球最有聲譽、以服務為導向、並替客戶創造最大利益的專業積體電路製造服務公司，因而成為獲利最高的一流半導體企業。

200mm



150mm

# 營運概況

## 一、業務內容

### (一) 業務範圍

台積公司專注於「專業積體電路製造服務」之本業，以卓越的製造與服務能力為核心競爭優勢，致力於提供全球半導體廠商極大型及超大型積體電路製造、晶圓針測、包裝及測試、光罩製作以及設計支援等全系列的各項服務，其中積體電路製造約佔本公司民國八十九年全年整體營收的90%。

過去十三年來，我們的客戶已利用本公司的「虛擬晶圓廠」製造服務，生產出涵蓋各種應用層面的積體電路產品。據估計，在民國八十九年全球積體電路產品中，大約有6%是透過本公司所提供的服務所產製的。

### (二) 主要產品之用途

本公司經由提供整體的先進專業積體電路製造服務，以協助客戶生產範圍廣泛的產品，應用於包括個人電腦、網路伺服器、電腦週邊、網際網路應用產品、有線及無線通訊產品、消費性電子產品、汽車及工業用設備等各項系統產品之中。

## 二、市場及產銷

隨著全球半導體市場的強勁成長與無晶圓廠積體電路設計公司出人意外的高成長，本公司在民國八十九年締造了營業額新台幣1,662 億的亮麗成績，較民國八十八成長127.3%。

本公司有如此優異的表現，可歸功於三個主要原因：（1）本公司經過十餘年努力所累積的龐大客戶基礎與堅強客戶關係，使本公司擁有為數超過400家的客戶，其中超過五成在八九年當中向本公司下單。（2）在策略上，鑑於半導體產業長期穩定的成長趨勢與快速因應客戶的需求，本公司在所管理的九座八吋晶圓廠中積極擴充先進產能；同時本公司亦於八九年持續興建兩座純十二吋晶圓廠，此兩座十二吋晶圓廠將是在產業中最早期進入量產的十二吋晶圓廠行列之中。（3）本公司自成立開始即以服務為本位，我們除了建立以服務為導向的組織，並全力投入電子商務以實現本公司「成為客戶半導體產品生產的虛擬晶圓廠」的目標。

以上三個原因，再加上領先的市場地位與最先進製程的量產能力，才得以確保本公司在八九年全面需求成長但競爭劇烈的產業中仍能保持優異的經營績效。

最近二年度生產量值表

晶圓			
年度	產能	產量	產值
88年*	1,895,112	1,788,472	43,759,960
89年	3,263,236	3,467,270	76,545,082

單位：產能、產量（片，八吋晶圓約當量）

產值（新台幣仟元）

\* 民國八十八年度之產能與產量，經予重新計算，  
俾配合民國八十九年度之表達

最近二年銷售量值表

年度	晶圓		包裝元件		其他		合計	
	量	值	量	值	量	值	量	值
88年	1,686,433	64,428,905	67,832	5,131,796	-	3,570,505	1,754,265	73,131,206
89年	3,314,407	152,595,853	93,682	5,815,381	-	7,817,186	3,408,089	166,228,420

單位：量（片，八吋晶圓約當量） 值（新台幣仟元）

### 三、市場分析

自民國八十九年十一月起全球半導體市場由過熱漸趨和緩，而對於民國九十年全球半導體成長狀況，各家的預期則有極大的差異，預測範圍從負成長到10%左右的成長，其中記憶體元件方面因為民國九十年上半年個人電腦銷售之疲軟及高庫存，因此預期成長將小於5%；邏輯元件則將稍高於整體半導體市場的成長；然而依賴晶圓專業製造服務的無晶圓廠積體電路設計公司，預期將因提供較高附加價值的產品而仍將有兩位數的成長率。

民國九十年半導體產業景氣能見度雖仍低迷，台積公司仍將會策略性地持續擴充先進技術的產能以滿足客戶的需求。本公司目前正在興建兩座純十二吋晶圓廠（晶圓十二廠位於新竹科學園區，晶圓十四廠位於台南科學園區），晶圓十二廠將在民國九十年第四季開始生產，而晶圓十四廠的廠房與潔淨室預計將於九十年底完工。

除了支援快速成長的無晶圓廠積體電路設計公司，本公司亦持續經營多角化客戶群，引進長期合作的新客戶，其中又以整合元件製造公司（Integrated Device Manufacturers：IDMs）為主。整合元件製造公司擁有廣大客戶群與豐富多樣的產品線，隨著製造外包比例的增加，將顯著加速專業積體電路製造服務產業的成長。本公司無晶圓廠積體電路設計公司客戶有Altera、Broadcom 及Qualcomm等公司；整合元件製造公司客戶則包括了Philips 和Motorola 等公司。

在產品組合上，過去幾年，本公司策略性地控制了投入記憶體市場的程度，務使記憶體製造服務總額不超過公司營業額的一定百分比。由於邏輯元件需求強勁產生的產能排擠效果與記憶體市場的高風險性，本公司故仍將持續執行此一的策略，但針對逐漸成長的嵌入式記憶體應用市場，則將繼續加強技術與客戶的開發。

在邏輯元件產品方面，民國八九年本公司在繪圖晶片、寬頻通訊、數位消費性電子與無線通訊產品等高成長且需先進製程技術的市場，分別引進了新客戶與產品，並陸續開始進行量產，預期未來幾年也將因其市場持續成長而大量使用本公司的先進技術與產能。本公司亦將持續行銷上的努力，爭取更多對成長性高且對先進技術需求度高的客戶。

在供應鏈方面，由於產業解構（Dis-integration）的趨勢，本公司將成為直接的受惠者。在此一趨勢下，由於無晶圓廠積體電路設計公司、系統公司與整合元件製造公司集中心力於核心事業，並將製造與其它服務外包給具專業能力的聯盟夥伴，而網際網路促成的無阻力事業流程更將加速此一解構趨勢的發展。本公司的持續成長正足以影響供應鏈上的各聯盟夥伴擴展對專業積體電路製造服務模式的支持，半導體設備廠商中如Applied Materials、ASML 以及 Tokyo Electron 與原料產業的廠商如Komatsu、Shinetsu 以及中德電子公司均針對專業積體電路製造服務廠商持續增加技術與服務的計劃。

在技術層次方面，消費者需求更低成本且更多功能的產品，將引導本公司的客戶增加整合晶片的設計，從而產生對更高集成度先進製程的需求。本公司希望能透過先進產能的不斷擴充以滿足客戶需求，進而維持較高的平均銷售單價。

放眼未來，本公司深信專業積體電路製造服務將在全球半導體產業的生產製造上扮演愈來愈重要的角色。不僅無晶圓廠的積體電路設計公司需要專業積體電路製造服務公司提供積體電路的製造服務，而有晶圓廠的整合元件製造公司預期也將逐漸增加其對專業積體電路製造服務公司的需求。預估到民國九十年，全球半導體業預計將有超過15% 的產品出自專業積體電路製造服務公司，預期至民國九十九年此一比率將超過30%。隨著設計自動化軟體與智財權 (Intellectual Property : IP) 整合工具的持續改良，產品發展風險的不斷降低，將加速系統公司將部分積體電路需求直接外包給專業積體電路製造服務公司。因此，本公司將在降低半導體產業進入障礙上持續扮演領導者的角色。

在未來產業的發展上，仍將會有激烈的競爭壓力。因此，為確保未來的領導地位與獲利能力，本公司將繼續致力與客戶建立更緊密的夥伴關係及提供最先進的製程技術與最周延的服務。

本公司將專注於以下製造服務技術的提供：

#### (一) 先進的互補金氧半導體邏輯製程

民國八十九年上半年客戶已成功地運用本公司所提供的0.15微米高速互補金氧半導體(CMOS)邏輯製程發展新產品並進行量產，0.18微米低功率製程亦已在八十九年下半年進入量產。為緊密配合市場變遷、協助客戶推出新產品，0.13微米高效能及超高速CMOS邏輯製程技術也將在民國九十年第二季進入量產。另外，本公司也將在同年的第三季推出0.13微米低功率製程供生產可攜式產品的客戶使用。而0.10微米製程則預計於民國九十年下半年開始量產。這些先進的製程將為本公司的客戶提供功能更強、整合度更高的生產技術，而使客戶保有在產品性能及成本效益的優勢。

#### (二) 先進的類比／數位訊號製程

在類比／數位訊號的應用市場上，本公司已於民國八十九年上半年分別成功開發出0.18微米單層矽晶、六層金屬的類比／數位訊號製程與0.25微米射頻製程，並於該年順利進入量產；同年下半年0.18微米射頻製程亦進入量產，建立了本公司在消費性電子、資訊傳輸與通訊網路積體電路上獨特的生產服務地位；同時多媒體產品亦需要此一類比／數位混合製程，以利數位訊號處理技術及媒體處理技術的應用，而台積公司0.13微米的類比／數位訊號技術與射頻技術則將於民國九十年下半年完成。

#### (三) 先進的靜態隨機存取記憶體及嵌入式靜態隨機存取記憶體製程

本公司在民國八十九年初已提供0.18微米高速靜態隨機存取記憶體技術進入量產，0.18微米低功率靜態隨機存取記憶體製程亦在民國八十九年第一季完成開發並進入量產，至於0.13微米高速與低功率製程技術則預計在九十年開發完成並提供給客戶使用。在嵌入式靜態隨機存取記憶體技術方面，本公司則已於民國八十九年第一季完成0.15微米單層矽晶、七層金屬製程技術的開發，並隨即進入量產提供給客戶使用；而0.13微米嵌入式靜態隨機存取記憶體製程則已於民國八十九年年底進行試產，並於九十年上半年進行量產，以幫助客戶降低成本與提高產品性能。

#### (四) 先進的快閃記憶體及嵌入式快閃記憶體製程

在非揮發性記憶體方面，本公司於民國八十九年年初進行0.25微米以邏輯電路為主的雙層矽晶、雙層金屬、分離式閘極的快閃記憶體技術與0.25微米類比／數位混合訊號雙層矽晶、五層金屬、分離式閘極的嵌入式快閃記憶體技術的量產；而0.22微米單層矽晶、五層金屬的電性可抹除可程式唯讀記體—可程式邏輯元件技術也於民國八十九年年中開發完成。這些製程將提供客戶整合快閃記憶體與邏輯元件於同一晶片上的能力，特別是在需要高度整合的應用上，例如微控制器、數位訊號處理器與其它系統晶片整合技術等。另外，0.18微米的快閃記憶體及嵌入式快閃記憶體技術亦預計可在民國九十年年中完成研發並進入量產。

#### (五) 特殊半導體製程

除了先進製程的研發，本公司亦投入針對利基市場的特殊製程開發，包括互補式金氧半導體影像感應器、彩色濾光膜與高電壓製程。0.35微米互補式金氧半導體影像感應器製程已於八十九年第一季量產；0.25微米互補式金氧半導體影像感應器製程則已八十九年年底完成開發，並將在九十年年初進入量產。此外，八吋彩色濾光膜製程亦在八九年完成。高電壓CMOS製程則在八十八年年底開發完成0.5微米製程並於八十九年年初進入量產；民國八十九年年初完成了0.8微米雙載子互補式金氧半導體(BiCMOS)高電壓製程的開發並量產。民國九十年年底以前，本公司預計將開發完成0.35微米的高電壓製程提供客戶使用。

#### (六) 設計支援服務

在標準電路元件庫、智財權(IP)、電子自動化設計(EDA)與設計工程服務上，民國八九年是本公司豐收的一年。這一年中，本公司開發完成0.13微米的標準電路元件庫並為客戶所使用，該元件庫包括兩部分：一為內部自行開發，另一則與主要專業智財權公司和設計工程服務公司進行策略聯盟以滿足客戶設計所需。民國九十年本公司將推出具可量產化設計流程的高性能0.10微米標準電路元件庫與主要智財供客戶使用在包括系統化晶片的應用上，以強化本公司設計服務的能力。

### 四、勞資關係

本公司在全球擁有14,000多名的員工，在員工關係方面以員工發展及爭取員工承諾與認同列為重點方向。本公司十大經營理念中便主張兼顧員工福利和股東權益，盡力回饋社會以及營造具挑戰性、有樂趣的工作環境。

本公司在人才招募、發展及維持高素質的人力資源方面向來不遺餘力，因此使本公司在過去四年連續獲選為天下雜誌標竿企業聲望調查第一名。此外，在職工福利、職廠安全衛生及勞動條件等各方面也屢獲肯定，並多次經行政院勞委會評定為全國績優廠商。

本公司勞資關係和諧。在民國八十九年，本公司人力資源的重點工作分別是：

### (一) 人才招募

身為全球最大的積體電路製造服務公司，台積公司是本產業中廣為人才嚮往的職場環境，尤以在台灣為最具代表性。在八十九年本公司並榮獲由Cheer雜誌所舉辦「大學生票選最喜愛的企業」第一名。

台積公司由來自台灣及世界各地的高素質和高技能人才所組成。八九年，除了原有從德碁、世大合併的3,100位同仁加入外，亦有6,000多名新的生力軍加入，其中，約有自35,000位應徵者中精選出的2,500位工程及專業類的精英。此外，在技術人員方面，則約有3,500位的優秀人才從15,000名左右的應徵者中脫穎而出加入台積公司。

### (二) 員工發展

本公司一貫秉持不斷學習和專業成長的員工發展哲學。我們廣泛和獨特的員工發展計劃亦獲得許多肯定。在民國八九年，我們提供了超過1,500個訓練計劃，有高達43,000人次參與。這其中還包含了為本公司全球組織及內部客戶特別量身訂作的學習發展專案，來強化及提升團隊間的合作和默契。

特別在民國八九年我們增加了許多新的學習計劃：包括對新進工程師的“線上學習”倡導；對經理級以上人員所設計的以營運發展和領導技能為重點的強化管理發展計劃；以及在全公司推行的員工績效管理與發展制度的學習計劃。這些課程是針對本公司發展員工潛能及培養才能而特別設計的，這一套針對所有同仁開發的課程被稱為“專業發展計劃”，而對經理人員則是“專業發展策略”。為了讓來自德碁、世大合併進來的同仁對本公司能有更多的文化認同及歸屬，我們亦為這些同仁量身制訂了一套特別的學習發展計劃。

此外，為了讓同仁能有一個更好的學習環境，在八九年，本公司特別成立了一個可以同時容納500名學員的訓練學習中心，提供各項學習發展課程的使用。

### (三) 分紅制度

本公司的分紅及配股福利制度行之有年，除了落實「員工即公司所有人」的經營理念外，更重要的是透過績效與報酬的充分結合，讓員工將個人的目標與公司整體的目標相整合，進而使員工產生對公司的認同、投入及承諾，並進而達成員工與公司有福同享。

### (四) 員工福利

完善的員工福利措施及健康方案則是本公司「以員工為先」的文化表徵，在八九年我們積極推出許多增加及提升員工健康及生活平衡的新措施，包括保健中心門診、書局、咖啡吧和藝術展覽等多項員工服務。

此外，為了使同仁更融入台積公司大家庭，本公司全年度贊助並組織各種社團活動和家庭親子活動，包括有親子日、運動會、音樂會和藝文講座等等。

## 五、從業員工

年度	員工人數					平均 年齡	平均 年資	學歷分佈比率						
	直接人員	工程職	行政職	管理職	合計			博士	碩士	學士	專科	高中	高中以下	合計
88年	3,675	2,765	316	704	7,460	29	3.8	2.3%	23.1%	15.9%	22.5%	36.1%	0.1%	100.0%
89年	7,370	5,739	503	1,024	14,636	29	3.2	2.2%	23.7%	14.6%	26.3%	33.1%	0.1%	100.0%

註：自民國八十九年度起，員工的類別經重新定義，「管理職」專指經理人員。

## 六、環保支出資訊

本公司自民國八十五年施行環境管理系統，並取得ISO 14001驗證，繼晶圓一、二、三、四、七廠之後，晶圓五廠亦在八十九年取得ISO 14001驗證。除了ISO 14001之外，本公司一、二、三、四、五廠也領先同業取得職業安全衛生管理系統OHSAS 18001的驗證。

秉持工安環保政策的精神，本公司在民國八十九年持續努力於各項工安環保精進方案，也因此獲得經濟部頒發「工業精銳獎」以及獲工業局評選為「污染防治設施操作績優工廠」等榮譽。這些精進方案包括：在全氟化物(PFCs)減量上，配合「台灣半導體協會」減量基準年及目標年的訂定，在公司內部成立PFC減量小組，積極推動降低四氟化碳(CF4)及三氟化氮(NF3)之使用量，以減少其排放量；評估及規劃替代氣體、尾氣削減等技術可行性。在水污染防治方面，除了符合放流水標準外，依據各廠廢水水質特性增設廢水處理設備以持續提昇處理效能，同時增加廢水回收設備或調整回收設備之效率以提昇用水回收率。在空氣污染防治方面，本公司不僅新增空氣污染防治設備以符合新修訂之環保標準，並規劃於九十年擴充備用之防制設備，以期將設備故障之風險降至最低。在事業廢棄物管理方面，持續朝資源化方向努力，八十九年度經環保署核准通過的事業廢棄物再利用申請案有：異丙醇(IPA)、N-甲基-2-咯酮(N-Methyl-2-Pyrrolidinone)及光阻劑。

此外，台南廠區擴廠計劃、晶圓八廠及十二廠之環境影響評估事宜，亦是八十九年的年度大事，經過多方努力，各廠區之環境影響評估已陸續審查通過，擴廠時之相關工安環保事宜，均將依照世界級的先進標準據以施行。

經過縝密的策劃，本公司第一版的「環保年報」在八九年四月出爐，為台灣半導體業之創舉。這項出版是世界級公司的環保責任表現，更代表了本公司對環保的積極態度，藉由環保年報的溝通將使我們與外部團體能有更正面積極的互動。

本公司在最近二年，計有三件環保違規事項，分別為：(1) 少量廢水誤排入雨水溝，(2) 未及時申報毒化物的運作備查，以及(3) 實驗室化學品的標示問題而受行政處分，其中第(3)項依法該標示責任非屬本公司，因此此案正向環保單位申請訴願中。以上三項處分之總金額為新台幣二十八萬元，違規事項均已於發現後立即完成改善措施。

未來三年，本公司仍將努力投入相關的環境改善及保護措施，在既設廠區之持續改善工程以及新設廠區之相關環保設施，預估將再投入約新台幣十八億三仟九佰萬元之環保支出。

## 七、重要契約

### (一) 技術合作契約

契約期間：民國八十六年七月九日至民國九十六年七月八日

契約對象：荷蘭商飛利浦電子股份有限公司

契約內容：本公司與飛利浦公司簽訂技術合作契約，並按約定產品銷貨收入淨額之特定比例支付權利金。

### (二) 次微米技術授權契約

契約期間：民國七十九年十一月二十日至民國八十九年十二月三十一日

契約對象：工業技術研究院

契約內容：本公司與工研院簽訂次微米技術授權契約，應於五年內支付授權費新台幣壹億貳仟玖佰肆拾萬元（該等授權費已全數支付完畢），並按約定產品銷貨收入淨額之特定比例支付權利金。

### (三) 房屋及設備租賃契約（一廠）

契約期間：民國八十六年四月一日至民國九十一年三月三十一日

契約對象：經濟部

契約內容：本公司向經濟部租用約定之房屋及機器設備。

### (四) 土地及公用設施使用租賃契約（一廠）

契約期間：民國八十六年四月一日至民國九十一年三月三十一日

契約對象：工業技術研究院

契約內容：本公司向工研院租用約定之土地及公用設備。

### (五) 晶圓代工相關契約

契約期間：民國八十四年至民國九十三年

契約對象：歐、美、亞洲等地區十餘家公司

契約內容：歐、美、亞洲各地區委製晶圓產品之客戶與本公司簽約預定未來數年之產能，至民國八十九年年底已簽約之客戶有十餘家。

## (六) 製造契約

契約期間：自 WaferTech, LLC 量產後起三年

契約對象：WaferTech, LLC

契約內容：本公司有義務於WaferTech, LLC 量產後三年內，向WaferTech, LLC 購買其百分之八十五之產能。若本公司無法購足其百分之八十五之產能，本公司應就未購足部份予以賠償。

## (七) 合資協議書

契約期間：無，得依合約規定終止

契約對象：荷蘭商飛利浦電子股份有限公司、新加坡經濟發展局

契約內容：本公司與飛利浦公司、新加坡經濟發展局同意共同出資於新加坡設立晶圓代工廠“Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd”（“SSMC”），其中本公司持有股份百分之三十二。依約定飛利浦公司與本公司有義務購買特定比例之SSMC 產能。

## (八) 技術合作契約

契約期間：民國八十八年三月三十日至民國九十八年三月二十九日

契約對象：Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd（“SSMC”）

契約內容：依契約約定本公司應移轉製程技術予SSMC，SSMC 則應按其銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金予本公司。

## (九) 技術移轉契約

契約期間：民國八十九年六月二十七日至民國九十九年六月二十六日

契約對象：National Semiconductor Corporation（“NS”）

契約內容：依契約約定，本公司應移轉製程技術予NS，NS 應給付技術授權費予本公司。

## (十) 晶圓代工契約

契約期間：民國八十九年二月十四日至民國九十四年二月十三日

契約對象：世界先進積體電路股份有限公司

契約內容：依契約約定，世界先進公司應保留其特定產能予本公司，並依雙方約定之價格條件製造本公司客戶所要求之產品。

## 八、訴訟或非訴訟事件

### SRAMs 反傾銷調查

美商美光公司（Micron Technology Inc.）於八十六年二月對韓國及台灣輸美之靜態隨機存取記憶體（SRAMs）提出傾銷控訴。美國國際貿易委員會已於八十七年四月作出美國產業受有損害之最終判決，美國商務部隨即公佈台灣各廠商之傾銷稅率。國內業界隨後向美國國際貿易法庭就美國國際貿易委員會之最終判決提出上訴。經美國國際貿易法庭兩度發回美國國際貿易委員會重新審查，美國國際貿易委員會於八十九年六月二度審查本案時，做成台灣SRAMs 進口未對美國產業造成損害之決定，並經美國國際貿易法庭確認該項決定。美光公司已就本案繼續向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴，現正審理中。因SRAMs 占本公司銷售比例極為有限，且本公司直接輸美之SRAMs 數量更少，預估對本公司無重大影響。

380mm



280mm

180mm

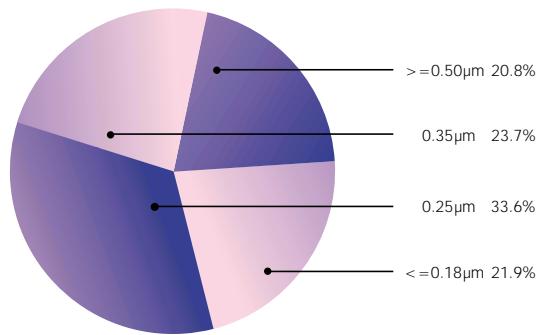
# Vision → Vision

做一個全球最有聲譽、以服務為導向、並替客戶創造  
最大利益的專業積體電路製造服務公司，  
因而成為獲利最高的一流半導體企業。

# 營業及資金運用計劃

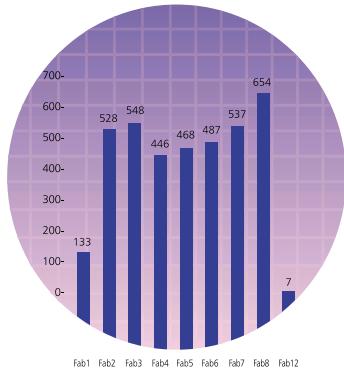
## 一、民國九十年度產銷計劃

銷售計劃



生產計劃

單位：千片八吋晶圓



\*台積公司擁有及管理之產能（含世界先進、WaferTech 及 SSMC），共計4,463千片八吋晶圓；若不計世界先進、WaferTech 及 SSMC 的產能支援則為3,808千片八吋晶圓。

## 二、民國九十年度處分或取得不動產或長期投資計劃

處分不動產或長期投資達新台幣參億元或公司實收資本額百分之二十者

名稱	性質	數量或面積	坐落地點	預計處分日期	預計處分價格	處分目的
台宏半導體股份有限公司	長期投資	普通股 50,000,000 股	林口	2001 年第二季	未定	策略性調整長期投資

取得不動產或長期投資達新台幣參億元或公司實收資本額百分之二十者

名稱	性質	數量或面積	坐落地點	預計取得日期	預計取得價格	預計資金來源	取得目的
建築物	不動產	325,174 平方公尺	新竹及台南	90 年第一季起	新台幣 4,846 佰萬元	保留盈餘或借款	增加晶圓代工產能 提昇本業之競爭力
Systems on Silicon Manufacturing Company Pte. Ltd.	長期投資	普通股：292,352	新加坡	90 年第一季起	美金 146 佰萬元	保留盈餘或借款	增加晶圓代工產能 提昇本業之競爭力
Emerging Alliance, Fund, L.P.	長期投資	股權之 99.5%	Cayman Island	90 年第一季起	美金 29.85 佰萬元	保留盈餘	分散長期投資，發展策略性技術夥伴關係

### 三、研究與發展

#### (一) 願景與使命

台積公司研究發展的使命是提供客戶全球最佳、最具競爭力、最具成本效益與最完備積體電路製造技術平台。藉由積極創新的研究計劃，讓我們不只在半導體技術發展上領先群倫，同時更能進一步促進技術普及，拓展全人類的生命經驗與福祉。

本公司在半導體製程技術的發展上，一向位居專業積體電路製造服務業界之領導地位，擁有最先進、多樣完備的邏輯、類比 / 數位混合訊號 (mixed-signal)、嵌入式 (embedded) 記憶體、彩色影像感測器 (color image sensor) 以及高電壓的製程技術，並能在最短時間內為客戶量產成功，作為客戶發展下一世代電腦、通訊、工業及消費性電子產品的生產技術平台。同時，本公司在互補式金氧半導體 (CMOS) 邏輯製程的發展上尤具優勢，能夠提供包括中央處理器、高效能、低耗功率、嵌入式記憶體邏輯以及系統整合單晶片 (SOC) 等各項先進製程技術。

尤其值得一提的是，在民國八十九年，本公司不僅持續領先國際半導體技術藍圖 (ITRS, International Technology Roadmap for Semiconductors)，更創下專業積體電路製造服務廠首度授權整合元件製造商 (IDM) 技術的重要里程碑，一舉改寫多年來專業積體電路製造服務業技術外求的現況，再次證明台積公司的製程技術實力已獲半導體業界高度肯定。

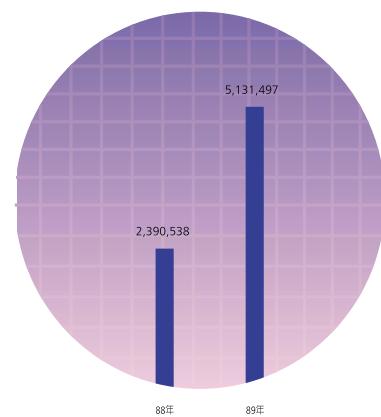
#### (二) 研發團隊及投資

台積公司的研究發展組織是全球專業積體電路製造服務業中最卓越的研發團隊之一。本公司開創專業積體電路製造服務業的成功模式，吸引國內外優秀人才紛紛加入，創造無可比擬的研發優勢。在民國八十九年中，我們投入超過新台幣五十一億元的經費在研究發展上，比前一年增加了115%；而在民國九十年，我們在研究發展的投資則預計超過新台幣九十七億元。

除了擁有獨立自主的研發能力之外，台積公司同時也與設備、材料廠商結成發展聯盟，這樣的合作關係有助於新製程的研發與新製造技術的運用，更重要的是生產成本也能大幅降低。台積公司在國際半導體製程、設備及材料發展等領域佔有相當重要的地位。目前，本公司積極參與世界性的下世代微影技術聯盟 (NGL, Next Generation Lithography) 與157nm Consortium 二大全球半導體組織，以建立未來0.10微米以下微影及製程相關技術的領先地位。此外，我們也是國內唯一參與國際半導體研發聯盟 (International Sematech) 的公司，再次證明台積公司是專業積體電路製造服務產業的研發領導者。

積體電路製程研發支出

金額：新台幣仟元



### (三) 研發成就

「鼓勵在各方面的創新，確保高度企業活力」是台積公司十大企業經營理念之一。民國八十九年中，我們在半導體製程技術方面共獲得523項美國專利以及524項中華民國專利，充分體現了不斷創新的經營理念。同時，我們也持續加速新技術的開發，維持每年推出一個新技術世代的成績。

台積公司的研發團隊在民國八十九年寫下許多優異的成績，其中最重要的是推出業界最先進的0.13微米邏輯製程。這項製程技術領先國際半導體技術藍圖的0.13微米時程整整一年以上，同時也擁有最高品質的銅導線與低介電係數 (low-k)，能發揮極佳的效能表現。

本公司的0.13微米製程技術十分完備，以各種高效能、低耗功率以及標準核心製程技術來滿足系統單晶片的各項廣泛應用。此項技術提供高效能、低電壓的技術應用在相關應用產品，例如：微處理器 (microprocessors)、網路處理器 (network processors)、媒體處理器 (media processors) 等；以低耗功率技術製造電池 / 行動無線通訊產品（例如：行動電話）；以及提供標準的特殊應用積體電路邏輯 (ASIC-logic) 製程技術，使工業與消費電子產品能有最具成本效益的選擇。本公司的0.13微米製程技術具有全球最嚴格的設計準則，可以生產出世界級水準的低耗電壓、高效能，且閘長小於0.07微米的電晶體。此項領先業界的0.13微米製程技術，結合運轉速度更快的電晶體與更先進的八層銅導線 / 低介電係數，能夠支援速度高於1.5GHz的微處理器 (microprocessor) 及其他高效能產品。

在民國八十九年，台積公司對銅導線 / 低介電係數 (Cu / low-k) 材料的掌握，廣受業界肯定，已經成為0.13微米製程技術的先驅。這些最新世代的技術除了能生產更快速度與較低功率消耗的晶片之外，並能同時展現更佳的機械、化學特性，因此有助於產品良率與品質的提昇。在0.13微米的製程研發過程中，我們是台灣第一家引進193奈米步進掃瞄式微影系統機台與製程的專業積體電路製造服務公司。

### (四) 多樣完備的製程技術

台積公司優異的研發能力使我們成為半導體業界技術的領導者，研發團隊無時不以為客戶發展最新技術為使命。民國八十九年初台積公司成功量產出0.15微米的邏輯製程技術產品，並於同年年底推出0.13微米製程技術。八十九年度台積公司還推出了其他多樣的製程技術如下：

#### ● 高電壓邏輯製程

在高電壓、低耗功率的技術領域中，台積公司於民國八十九年除了導入0.6及0.5微米的製程來改善既有的1微米16V和40V的製程外，也開發完成了0.8微米40V的LDMOS半導體技術，此一製程並可完全相容於台積公司既有的邏輯及混訊製程，使5V及高電壓的系統得以順利整合。

#### ● 0.18 微米混合訊號 / 射頻 (mixed-signal / RF) 製程技術

本公司領先業界，在民國八十九年推出0.18微米互補式金氧半導體 (CMOS) 混合訊號 / 射頻製程技術，在單一晶片上結合射頻、類比與基頻 (baseband) 等多種功能，提供一個先進的技術平台，滿足客戶對藍芽技術 (Bluetooth) 及其他通訊應用的設計要求。

本公司此項技術具備多樣的模組數位元件 (modular digital devices)，模組類比元件 (modular analog devices) 及精密被動元件 (passive components)，例如high-Q metal-insulators-metal 電容 (capacitors) 與電感 (inductors) 上。

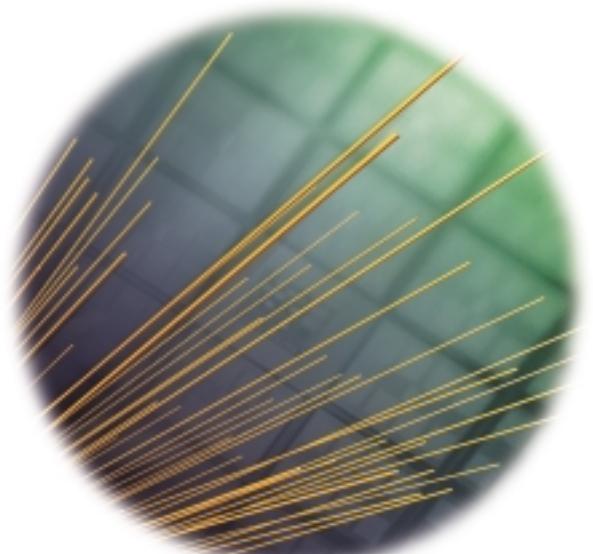
#### ● 0.25 微米互補式金氧半導體 (CMOS) 影像感測 (image sensor) 製程技術

本公司領先業界，推出解析度高達三百萬像素數的彩色影像感測器製程，可應用於最先進的單晶片相機 (Camera-on-a-Chip)，此項新世代的彩色影像感測技術能強化既有的0.8、0.6、0.5、0.35微米的相關製程技術外，並能藉由彩色濾波器和微透鏡的提昇，使其靈敏度倍增。

#### ● 嵌入式記憶體 (embedded memory) 製程技術

在系統單晶片的整合方面，嵌入式記憶體製程技術扮演一個極重要的角色。過去一年中，本公司在嵌入式記憶體製程技術表現優異。本公司目前的嵌入式記憶體製程技術所需使用的元件資料庫，與現有的邏輯製程技術的元件資料庫完全相容，因此客戶選擇使用本公司嵌入式記憶體製程技術時，可以直接使用既有的邏輯製程技術的元件資料庫，無須重新經過驗證。此外，本公司各式的嵌入式記憶體製程技術皆備有一系列完整的編譯器、設計手冊及測試支援，能協助客戶加速其產品的設計及生產問市。

此外，本公司也提供一系列無論在密度，執行速度，或是漏電度上都極具競爭力的六晶體 (6T) 靜態隨機存取記憶體 (SRAM) 單元。以0.13微米6T嵌入式SRAM元件為例，其記憶單元小於2.2平方微米，而編譯器的執行速度可高於1GHz。這種六晶體SRAM單元也能提供給高速、高密度，或低耗功率獨立 (stand-alone) SRAM晶片的應用。



台積公司，專業積體電路製造服務業界銅導線製程技術的領導者

- **先進的0.25微米快閃記憶體（Flash）技術**

本公司的0.25微米快閃記憶體技術於民國八十九年導入獨立與嵌入式應用。同時，我們的0.22微米EEPLD技術也已轉移至生產線上進行量產，成為全球第一個可真正量產的2.5V EEPLD製程技術。

- **十二吋晶圓產品製造技術**

本公司能在民國八十九年，成功地在位於台南晶圓六廠的十二吋晶圓生產線，為客戶產出業界首批的十二吋晶圓產品，其中研發團隊的貢獻功不可沒。目前研發團隊仍繼續投入各項相關研究，以協助確認台積公司首兩座純十二吋晶圓廠--晶圓十二廠（位於新竹）及晶圓十四廠（位於台南）的生產設備模組。

- **最新世代的光罩技術**

本公司擁有全球專業積體電路製造服務產業中最大的自有光罩生產設施，並擁有優良的品質和交期，充分支援研究發展、產品開發及產品量產的需求。我們擁有最先進的電子光束光罩機和檢測工具，能同時供應量產及研發的需求，其中包括先進的光學臨近效應校正（OPC）和相位移轉光罩（PSM）技術，這些技術不僅可以應用在0.15、0.13與0.10微米邏輯製程，同時也是發展下一代技術的關鍵。

## **(五) 未來展望**

展望未來，本公司將繼續投入研發投資，不斷開發新一代之量產製程技術，確保技術領域的領先。民國九十年的研發重點是0.10微米邏輯／混合訊號技術平台及其他符合系統單晶片應用的嵌入式記憶體製程。此外，我們也將持續開發最佳的十二吋晶圓產品生產模組。目前正在進行的還包括新一代的0.13微米混合訊號／射頻、0.13微米嵌入式記憶體、0.18微米矽鍶（SiGe）雙載子互補金氧半導體（BiCMOS）、0.18微米彩色影像感測器、以及0.35微米高電壓等種種製程技術與新世代電晶體的研發計劃。

本公司自民國八九年開始積極投入0.10微米的製程研發，並著手研究0.07微米以下的元件，並對先進的高介電係數閻極絕緣體，與低介電係數絕緣體材料的發展投入極大的心力。此外，台積公司晶圓十二廠則預計在民國九十年底開始生產，屆時將可引入0.10微米以下各世代的先進製程技術。

本公司擁有業界最堅強的研發團隊，一直不斷在最先進的製程、工具和材料上持續投資，相信我們的努力定能提供全球最佳且最具成本效益的技術解決方案，為客戶創造最強有力的競爭優勢。

## 四、資金運用計劃

### (一) 民國九十年度擬擴充業務或廠房設備之計劃內容、資金來源、運用概算及可能產生之效益

項目	金額（新台幣佰萬元）	預計產生效益
晶圓十四廠廠房興建	5,724	預計生產十二吋晶圓
晶圓十二廠廠房興建	33,507	預計生產十二吋晶圓
晶圓八廠	4,237	預計九十年底可達月產八吋晶圓57,000片
晶圓七廠	2,277	預計九十年底可達月產八吋晶圓45,000片
晶圓六廠	7,926	預計九十年底可達月產八吋晶圓42,000片
晶圓一 ~ 五廠	4,334	產品組合升級
十二吋晶圓試產線	1,112	先進模組整合測試
設備汰舊換新及其它	12,380	維持技術優勢，提升競爭力
	<b>71,497</b>	

### (二) 前各次籌資計劃尚未完成者其資金運用計劃及執行情形

計劃項目	募集資金	資金運用計劃	執行情形
民國八十九年六月七日 23,000,000 ADRs	US\$822,250,000	購買晶圓六廠機器設備	至民國八十九年十二月三十一日止，已依進度完成 77.22%
民國八十九年十一月二十九日 1,300,000,000 股特別股	NT\$13,000,000,000	購買晶圓十二廠機器設備	將依進度於民國九十年第一季開始執行
民國八十九年十二月四日 - 民國八十九年十二月十五日 新台幣一佰五十億元普通公司債	NT\$15,000,000,000	購買晶圓八廠機器設備	將依進度於民國九十年第一季開始執行

## 五、台積電文教基金會

台積公司除了在專業積體電路製造服務的本業不斷努力外，亦一直致力於參與各項教育文化及公益活動，回饋社會。為了有更明確的計劃及方向經營回饋社會的理念，並於民國八十七年初成立「台積電文教基金會」，選定三大經營方向：

### (一) 高科技教育與人才培育

為培養兼具專業高科技、管理技能及法學素養之人才，長期捐助清華大學、交通大學及成功大學學術計劃，包括：「台積電獎學金」、「台積電智慧財產權獎學金」及「台積電講座」。此外，並支持清華大學成立全國首座「科技管理學院-台積館」，期能為台灣培養更多高科技傑出精英。

### (二) 參與社區總體營造

新竹及臺南地區是上萬個台積電家庭之社區，提供更美好的居住環境品質，回饋鄉里，是台積公司義不容辭的責任，包括教育、藝文、環境美化、保健及公益等社區活動，都是歷年來積極推動的方向。民國八十九年並特別捐助因九二一地震受損嚴重的新竹縣大坪國小校園修復工程費用，以提供師生一個安全無虞的教學環境。

### (三) 贊助全國性文藝教育活動

一些全國性文藝教育活動，不經由企業贊助或政府補助，往往無法舉辦。希望透過台積公司的贊助與推動，使國人有更多的機會欣賞到優質精緻的展演活動。例如贊助「達文西大展」、「優劇場-聽海之心全省巡迴演出」等。此外，台灣本土文化資產的保護亦是八九年工作重點之一，例如認養「龍潭聖蹟亭」及捐助「前美國駐台北領事館」修復費用。





300mm

200mm

財務概況 >>

# 財務概況

## 一、簡明資產負債表

最近五年度財務資料

項目	85年	86年	87年	88年	89年
流動資產	16,529,359	23,790,795	26,378,422	38,770,670	<b>85,950,586</b>
長期股權投資	12,608,506	19,220,371	17,537,765	28,208,643	<b>33,422,010</b>
固定資產	41,978,952	61,697,723	73,636,209	89,566,029	<b>207,005,370</b>
其他資產	2,018,827	3,804,923	6,554,817	4,877,392	<b>14,594,492</b>
流動負債					單位：新台幣仟元
分配前	5,357,895	10,088,672	8,138,796	14,469,329	<b>41,188,662</b>
分配後	5,926,138	10,250,285	8,276,867	14,684,480	*
長期借款	5,720,000	20,009,357	25,025,206	20,000,000	<b>29,000,000</b>
其他負債	9,943,809	9,001,390	6,872,545	6,183,565	<b>9,030,097</b>
股本	26,542,000	40,813,000	60,471,760	76,708,817	<b>129,893,646</b>
資本公積	59,086	62,082	164,219	11,831,411	<b>55,285,821</b>
保留盈餘					
分配前	25,523,456	28,641,292	24,162,113	33,320,615	<b>76,924,173</b>
分配後	10,684,213	8,820,919	9,010,971	11,785,153	*
資產總額	73,135,644	108,513,812	124,107,213	161,422,734	<b>340,972,458</b>
負債總額					
分配前	21,021,704	39,099,419	40,036,547	40,652,894	<b>79,218,759</b>
分配後	21,589,947	39,261,032	40,174,618	40,868,045	*
股東權益總額					
分配前	52,113,940	69,414,393	84,070,666	120,769,840	<b>261,753,699</b>
分配後	51,545,697	69,252,780	83,932,595	120,554,689	*

\* 俟股東會決議後定案

## 二、簡明損益表

最近五年度財務資料

項目	85年	86年	87年	88年	89年
銷貨收入	39,400,179	43,935,627	50,233,008	73,131,206	<b>166,228,420</b>
銷貨毛利*	21,411,531	20,134,920	20,336,042	32,215,693	<b>73,924,745</b>
營業損益	18,235,246	15,489,780	16,202,245	25,916,619	<b>60,541,105</b>
利息收入	653,462	501,434	566,020	808,616	<b>1,575,460</b>
利息費用	277,161	546,490	981,388	1,415,527	<b>1,858,197</b>
稅前損益	18,972,932	15,517,103	13,648,622	24,109,865	<b>63,837,594</b>
稅後損益	19,400,689	17,960,075	15,344,203	24,559,884	<b>65,106,194</b>
每股盈餘	7.31**	4.40**	2.54**	3.24**	<b>5.71**</b>
	1.97***	1.83***	1.56***	2.49***	-
利息支出資本化	181,168	255,054	661,414	305,312	<b>72,903</b>

\* 85年至88年度損益表資料若干科目經予重新分類，僅配合89年度財務報表之表達。

\*\* 按各年度流通在外加權平均股數計算之每股盈餘。

\*\*\* 按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘。

### 三、財務分析

#### 最近五年度財務資料

項目	85年	86年	87年	88年	89年
<b>財務結構</b>					
負債佔資產比率 (%)	28.74	36.03	32.26	25.18	<b>23.23</b>
長期資金佔固定資產比率 (%)	137.77	144.94	148.16	157.17	<b>140.46</b>
<b>償債能力</b>					
流動比率 (%)	308.50	235.82	324.11	267.95	<b>208.68</b>
速動比率 (%)	247.77	185.78	273.86	233.95	<b>178.13</b>
利息保障倍數 (次)	42.40	20.04	8.91	14.83	<b>34.02</b>
<b>經營能力</b>					
應收帳款週轉率 (次)	8.80	6.22	5.90	7.18	<b>7.87</b>
應收帳款收現日數	41.00	58.68	61.85	50.82	<b>46.38</b>
存貨週轉率 (次)	7.24	6.12	6.82	9.96	<b>11.01</b>
平均售貨日數	50.43	59.69	53.49	36.66	<b>33.14</b>
固定資產週轉率 (次)	0.94	0.71	0.68	0.82	<b>0.80</b>
總資產週轉率 (次)	0.54	0.41	0.40	0.45	<b>0.49</b>
<b>獲利能力</b>					
資產報酬率 (%)	32.40	20.35	14.04	18.19	<b>24.12</b>
股東權益報酬率 (%)	45.28	29.56	19.99	23.98	<b>31.43</b>
佔實收資本比率 (%) - 營業利益	68.70	37.95	26.79	33.79	<b>46.61</b>
佔實收資本比率 (%) - 稅前純益	71.48	38.02	22.57	31.43	<b>49.15</b>
純益率 (%)	49.24	40.88	30.55	33.58	<b>39.17</b>
每股淨值 (元)	19.63	17.01	13.90	15.74	<b>21.28</b>
每股盈餘 (元)	1.97**	1.83**	1.56**	2.49**	<b>5.71</b>
每股股利 (元)	8.00	5.00	4.50	2.30	<b>2.80</b>
現金股利 (元)	-	-	-	-	***
股票股利 (元)	8.00	5.00	4.50	2.30	<b>2.80</b>
<b>現金流量</b>					
現金流量比率 (%)	452.74	201.55	417.00	273.50	<b>213.74</b>
現金流量允當比率 (%)	113.70	97.96	102.04	106.00	<b>106.15</b>
現金再投資比率 (%)	28.21	16.28	21.65	19.31	<b>22.53</b>
<b>槓桿度</b>					
營業槓桿度	1.79	2.15	2.69	2.47	<b>2.34</b>
財務槓桿度	1.02	1.04	1.06	1.06	<b>1.03</b>

\* 85年至88 年度損益表資料若干科目經予重新分配，俾配合89 年度財務報表之表達。

\*\* 按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘。

\*\*\* 俟股東會決議後定案。

#### 四、 每股淨值、盈餘、股利及市價

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

87年

88年

**89年**

每股市價	87年	88年	89年
最高	173.00	171.00	<b>222.00</b>
最低	56.50	68.00	<b>74.50</b>
平均	100.80	117.10	<b>146.30</b>
每股淨值			
分配前	13.90	15.74	<b>21.28</b>
分配後	11.12	12.07	-
每股盈餘			
加權平均股數	6,047,176,000	7,572,598,000	<b>11,400,882,000</b>
每股盈餘	2.54	3.24	<b>5.71</b>
每股盈餘 <sup>1</sup>	2.03	2.49	-
每股股利			
現金股利	-	-	*
無償配股			
盈餘配股	4.50	2.30	<b>2.555</b>
資本公積配股	-	-	<b>0.245</b>
投資報酬分析			
本益比 <sup>2</sup>	39.69	36.14	<b>25.62</b>
本利比 <sup>3</sup>	-	-	*
現金股利殖利率 <sup>4</sup>	0	0	*

\* 俟股東會決議後定案

註 1 按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘

註 2 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘

註 3 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利

註 4 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價

## 五、 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師姓名	查核意見
85年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
86年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
87年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
88年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
89年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見

台北市民生東路3段156號12樓 電話：886-2-2545-9988

## 六、 監察人審查報告書

董事會造送本公司八十八年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、主要財產之財產目錄及盈餘分派議案等，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及主要財產之財產目錄業經委託勤業會計師事務所查核完竣，並出具財務報告。上述表冊及報告經本監察人等審核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

台灣積體電路製造股份有限公司

監察人 樊富利


監察人 許欽洲


監察人 簡學仁


中華民國九十年三月九日

## 七、財務狀況及經營結果之檢討與分析

### (一) 流動分析

項目	89 年度	88 年度	增減比率
流動比率	<b>208.68%</b>	267.95%	-22.12%
速動比率	<b>178.13%</b>	233.95%	-23.86%

### (二) 經營結果分析

單位：新台幣仟元

項目	89 年度	88 年度	增減金額	增減比率
銷貨收入總額	<b>169,223,128</b>	74,036,935	95,186,193	128.57%
銷貨退回及折讓	<b>(2,994,708)</b>	(905,729)	(2,088,979)	230.64%
銷貨收入淨額	<b>166,228,420</b>	73,131,206	93,097,214	127.30%
銷貨成本	<b>(92,303,675)</b>	(40,915,513)	(51,388,162)	125.60%
銷貨毛利	<b>73,924,745</b>	32,215,693	41,709,052	129.47%
營業費用	<b>(13,383,640)</b>	(6,299,074)	(7,084,566)	112.47%
營業收益	<b>60,541,105</b>	25,916,619	34,624,486	133.60%
營業外收入				
保險理賠收入	<b>1,623,832</b>	184,607	1,439,225	779.62%
利息收入	<b>1,575,460</b>	808,616	766,844	94.83%
兌換淨益	<b>828,025</b>	-	828,025	-
按權益法認列之投資淨益	<b>779,326</b>	-	779,326	-
技術服務收入	<b>138,514</b>	-	138,514	-
權利金收入	<b>116,248</b>	63,809	52,439	82.18%
處分投資利益	<b>104,643</b>	29,041	75,602	260.33%
處分固定資產利益	<b>62,921</b>	4,310	58,611	1359.88%
迴轉備抵短期投資損失	<b>688</b>	120,766	(120,078)	-99.43%
其他收入	<b>179,650</b>	38,557	141,093	365.93%
合計	<b>5,409,307</b>	1,249,706	4,159,601	332.85%
營業外費用				
利息費用	<b>(1,858,197)</b>	(1,415,527)	(442,670)	31.27%
權利金費用	<b>(108,133)</b>	(86,746)	(21,387)	24.65%
處分固定資產損失	<b>(99,220)</b>	(35,810)	(63,410)	177.07%
公司債發行成本	<b>(32,658)</b>	(114,839)	82,181	-71.56%
按權益法認列之投資淨損	<b>-</b>	(1,191,891)	1,191,891	-100.00%
兌換淨損	<b>-</b>	(81,436)	81,436	-100.00%
處分短期投資損失	<b>-</b>	(75,366)	75,366	-100.00%
其他損失	<b>(14,610)</b>	(54,845)	40,235	-73.36%
合計	<b>(2,112,818)</b>	(3,056,460)	943,642	-30.87%
稅前利益	<b>63,837,594</b>	24,109,865	39,727,729	164.78%
所得稅利益	<b>1,268,600</b>	450,019	818,581	181.90%
純益	<b>65,106,194</b>	24,559,884	40,546,310	165.09%

## 八、財務報表暨會計師查核報告書

台灣積體電路製造股份有限公司民國八十九年及八十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國八十九年及八十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司已編製民國八十九年度及八十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此致

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師 黃樹傑

黃樹傑



台灣省會計師公會會員證第1723號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(83)台財證(六)第12213號

會計師 魏永蕙

魏永蕙



台灣省會計師公會會員證第705號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(72)台財證(一)第2583號

中華民國九十年一月二十九日

資產負債表

民國八十九年及八十八年十二月三十一日

單位：除每股市額外，為新台幣仟元

資產	八十九年底		八十八年底	
	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金（附註二及四）	\$35,664,440	11	\$16,650,017	10
短期投資（附註二）	-	-	236,250	-
應收關係人款項（附註十四）	994,815	-	468,903	-
應收票據	125,175	-	164,134	-
應收帳款	30,335,314	9	13,380,253	8
備抵呆帳（附註二）	(946,734)	-	(422,202)	-
備抵退貨及折讓（附註二）	(2,204,167)	(1)	(706,886)	-
存貨（附註二及五）	10,967,935	3	4,529,714	3
遞延所得稅資產（附註二及十三）	8,122,000	2	2,329,000	2
預付費用及其他流動資產（附註二、十四、十五及十七）	2,891,808	1	2,141,487	1
流動資產合計	<u>85,950,586</u>	<u>25</u>	<u>38,770,670</u>	<u>24</u>
長期投資（附註二及六）	<u>33,422,010</u>	<u>10</u>	<u>28,208,643</u>	<u>17</u>
<b>固定資產（附註二、七及十四）</b>				
成本				
建築物	46,307,643	14	21,337,655	13
機器設備	210,461,923	62	102,672,163	64
辦公設備	3,672,927	1	1,939,392	1
	<u>260,442,493</u>	<u>77</u>	<u>125,949,210</u>	<u>78</u>
累積折舊	(94,332,168)	(28)	(57,969,725)	(36)
預付款項及未完工程	40,895,045	12	21,586,544	14
固定資產淨額	<u>207,005,370</u>	<u>61</u>	<u>89,566,029</u>	<u>56</u>
合併商譽（附註二）	<u>3,309,707</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>其他資產</b>				
出租資產（附註二）	625,647	-	-	-
遞延借項－淨額（附註二及八）	3,122,610	1	578,544	-
遞延所得稅資產（附註二及十三）	6,559,293	2	4,273,252	3
存出保證金	967,985	-	16,346	-
其他	9,250	-	9,250	-
其他資產合計	<u>11,284,785</u>	<u>3</u>	<u>4,877,392</u>	<u>3</u>
資產總計	<u>\$340,972,458</u>	<u>100</u>	<u>\$161,422,734</u>	<u>100</u>

負債及股東權益	八十九年底		八十八年底	
	金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>				
應付關係人款項（附註十四）	\$4,346,578	1	\$1,916,526	1
應付帳款	7,989,953	3	2,525,086	2
應付工程及設備款	24,392,400	7	6,958,098	4
應付所得稅（附註二及十三）	-	-	146,300	-
一年內到期之長期負債（附註二及九）	50,000	-	-	-
應計費用及其他流動負債（附註十七）	4,409,731	1	2,923,319	2
流動負債合計	<u>41,188,662</u>	<u>12</u>	<u>14,469,329</u>	<u>9</u>
應付公司債（附註十）	<u>29,000,000</u>	<u>8</u>	<u>20,000,000</u>	<u>12</u>
<b>其他負債</b>				
存入保證金	7,086,379	2	5,185,362	3
應計退休金負債（附註二及十二）	1,509,535	1	998,203	1
未實現售後租回利益（附註二）	434,183	-	-	-
其他負債合計	<u>9,030,097</u>	<u>3</u>	<u>6,183,565</u>	<u>4</u>
負債合計	<u>79,218,759</u>	<u>23</u>	<u>40,652,894</u>	<u>25</u>
<b>股東權益（附註二及十一）</b>				
股本—每股面額10元，額定一八九年17,800,000仟股， 八八年9,100,000仟股				
普通股發行—一八九年11,689,365仟股， 八八年7,670,882仟股	116,893,646	34	76,708,817	48
特別股發行—1,300,000仟股	13,000,000	4	-	-
資本公積	55,285,821	16	11,831,411	7
法定公積	10,689,323	3	8,258,359	5
特別盈餘公積	1,091,003	1	-	-
未分配盈餘	65,143,847	19	25,062,256	16
長期投資未實現跌價損失	(71,564)	-	-	-
累積換算調整數	(278,377)	-	(1,091,003)	(1)
股東權益合計	<u>261,753,699</u>	<u>77</u>	<u>120,769,840</u>	<u>75</u>
負債及股東權益總計	<u>\$340,972,458</u>	<u>100</u>	<u>\$161,422,734</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

**損益表**

民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，為新台幣仟元

	八九年底		八八年底	
	金額	%	金額	%
銷貨收入總額（附註二、十四及十八）	\$169,223,128		\$74,036,935	
銷貨退回及折讓	(2,994,708)		(905,729)	
銷貨收入淨額	166,228,420	100	73,131,206	100
銷貨成本（附註十四）	92,303,675	56	40,915,513	56
銷貨毛利	73,924,745	44	32,215,693	44
營業費用（附註十四）				
管理費用	5,299,135	3	2,097,835	3
行銷費用	2,953,008	2	1,810,701	2
研究發展費用	5,131,497	3	2,390,538	4
合計	13,383,640	8	6,299,074	9
營業利益	60,541,105	36	25,916,619	35
營業外收入				
保險理賠收入	1,623,832	1	184,607	1
利息收入	1,575,460	1	808,616	1
兌換淨益（附註二及十七）	828,025	1	-	-
按權益法認列之投資淨益（附註二及六）	779,326	-	-	-
技術服務收入（附註十四）	138,514	-	-	-
權利金收入（附註二及十七）	116,248	-	63,809	-
處分投資利益	104,643	-	29,041	-
處分固定資產利益	62,921	-	4,310	-
迴轉備抵短期投資損失	688	-	120,766	-
其他收入（附註十四）	179,650	-	38,557	-
合計	5,409,307	3	1,249,706	2
營業外費用				
利息費用（附註七及十七）	1,858,197	1	1,415,527	2
按權益法認列之投資淨損（附註二及六）	-	-	1,191,891	2
權利金費用（附註二及十七）	108,133	-	86,746	-
處分固定資產損失	99,220	-	35,810	-
公司債發行成本	32,658	-	114,839	-
兌換淨損（附註二及十七）	-	-	81,436	-
處分短期投資損失	-	-	75,366	-
其他損失	14,610	-	54,845	-
合計	2,112,818	1	3,056,460	4
稅前利益	63,837,594	38	24,109,865	33
所得稅利益（附註二及十三）	1,268,600	1	450,019	1
純益	\$65,106,194	39	\$24,559,884	34
每股盈餘				
按普通股加權平均發行股數八九年11,400,882仟股及				
八十八年7,572,598仟股計算	\$5.71		\$3.24	
按追溯調整後9,863,489仟股計算				
				\$2.49

後附之附註係本財務報表之一部分。

## 股東權益變動表

民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	發行股本				資本公積（附註二）						保留盈餘（附註十一）			長期投資未實			累積換算 調整數 (附註二)	
	普通股	金額	特別股	金額	合併	投票發	長期投資	債券轉	處份固定	捐贈	合計	法定公積	特別盈	未分配盈餘	合計			
	(仟股)		(仟股)		溢額	行溢價		換溢價	資產利益				餘公積					
八十八年初餘額	6,047,176	\$60,471,760	-	\$-	\$-	\$-	\$99,128	\$-	\$65,036	\$55	\$164,219	\$6,724,240	\$-	\$17,437,873	\$24,162,113	\$-	(\$727,426) \$84,070,666	
盈餘分配																		
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,534,119	-	(1,534,119)	-	-		
員工福利 - 股票	110,457	1,104,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,104,566)	(1,104,566)	-	-	-		
投票股利 - 23%	1,390,850	13,908,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,908,505)	(13,908,505)	-	-	-		
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138,071)	(138,071)	-	-	-	(138,071)	
八十八年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,559,884	24,559,884	-	24,559,884	
可轉換公司債轉換	122,399	1,223,986	-	-	-	-	11,289,998	-	-	11,289,998	-	-	-	-	-	-	12,513,984	
處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	4,022	-	4,022	-	-	(4,022)	(4,022)	-	-	
認列被投資公司處分固定資產																		
利益轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	246,218	-	-	246,218	-	-	-	(246,218)	(246,218)	-	-	
按權益法認列調整被投資公司股權																		
比例變動	-	-	-	-	-	-	126,954	-	-	126,954	-	-	-	-	-	-	126,954	
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(363,577)	(363,577)	
八十八年底餘額	7,670,882	76,708,817	-	-	-	-	472,300	11,289,998	69,058	55	11,831,411	8,258,359	-	25,062,256	33,320,615	-	(1,091,003) 120,769,840	
盈餘分配																		
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430,964	-	(2,430,964)	-	-		
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,091,003	(1,091,003)	-	-	-		
員工福利 - 股票	172,121	1,721,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,721,208)	(1,721,208)	-	-	-		
投票股利 - 25.55%	1,959,910	19,599,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,599,103)	(19,599,103)	-	-	-		
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(215,151)	(215,151)	-	-	-	(215,151)	
資本公積撥充股本 - 2.45%	187,937	1,879,366	-	-	-	-	(1,879,366)	-	-	(1,879,366)	-	-	-	-	-	-	-	
現金 - 六月八日	115,000	1,150,000	-	-	-	23,172,550	-	-	-	23,172,550	-	-	-	-	-	-	24,322,550	
合併發行新股 - 六月三十日 (附註一)	1,583,515	15,835,152	-	-	22,329,129	-	-	-	22,329,129	-	-	(135,077)	(135,077)	-	-	-	38,029,204	
發行特別股 - 十一月二十九日	-	1,300,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000	
八十九年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,106,194	65,106,194	-	65,106,194	
處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	-	58,178	-	58,178	-	-	(58,178)	(58,178)	-	-	-	
認列被投資公司處分固定資產利益																		
轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	5,502	-	-	5,502	-	-	(5,502)	(5,502)	-	-	-	
按權益法認列調整被投資公司股權																		
比例變動	-	-	-	-	-	-	(231,583)	-	-	(231,583)	-	-	231,583	231,583	-	-	-	
提列子公司長期投資未實現跌價損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,564)	-	(71,564)		
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,626	812,626		
八十九年底餘額	11,669,365	\$116,893,646	1,300,000	\$13,000,000	\$22,329,129	\$23,172,550	\$246,219	\$9,410,632	\$127,236	\$55	\$55,285,821	\$10,689,323	\$1,091,003	\$65,143,847	\$76,924,173	(\$71,564)	(\$278,377)	\$261,753,699

後附之財務報表為本財務報表之一部分。

現金流量表  
民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

八十九年度 八十八年度

營業活動之現金流量：		
純益	\$65,106,194	\$24,559,884
被合併公司上半年純益	(135,077)	-
折舊及攤銷	33,051,197	18,041,320
遞延所得稅	(1,059,841)	(383,686)
按權益法認列之投資淨損（益）	(779,326)	1,191,891
處分長期投資利益	-	(9,881)
處分固定資產淨損	13,823	31,854
應付利息補償金	-	585,614
提列退休金費用	360,673	249,483
備抵呆帳	490,835	139,112
備抵退貨及折讓	965,503	264,913
營業資產及負債之淨變動		
短期投資	236,250	5,425,077
應收遠匯款	7,108	(2,633)
應收關係人款項	(538,201)	(234,396)
應收票據	96,364	(129,266)
應收帳款	(14,268,429)	(5,443,998)
存貨	(2,985,133)	(840,937)
預付費用及其他流動資產	729,775	(1,289,994)
應付關係人款項	3,552,646	1,557,429
應付帳款	2,379,105	477,215
應付所得稅	(146,300)	(629,208)
應付遠匯款	76,168	102,784
應計費用及其他流動負債	883,185	1,336,588
營業活動之淨現金流入	<u>88,036,519</u>	<u>44,999,165</u>
投資活動之現金流量：		
長期投資增加	(11,866,583)	(12,105,618)
處分長期投資價款	-	16,106
購置固定資產	(79,270,461)	(29,842,159)
處分固定資產價款	219,233	36,824
遞延借項增加	(1,089,730)	(433,187)
存出保證金（增加）減少	(770,733)	5,572
合併德碁世大二家公司之現金流入	1,412,404	-
投資活動之淨現金流出	<u>(91,365,870)</u>	<u>(42,322,462)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(12,635,000)	-
應付商業本票減少	(5,479,288)	-

(接次頁)

(承前頁)

	八十九年度	八十八年度
公司債增加	<u>\$9,000,000</u>	\$9,450,634
長期借款減少	<u>(7,550,000)</u>	(2,692,938)
存入保證金增加(減少)	<u>1,900,663</u>	(938,463)
董事事酬勞	<u>(215,151)</u>	(138,071)
發行新股	<u>37,322,550</u>	-
融資活動之淨現金流入	<u>22,343,774</u>	5,681,162
現金及約當現金淨增加	<u>19,014,423</u>	8,357,865
年初現金及約當現金餘額	<u>16,650,017</u>	8,292,152
年底現金及約當現金餘額	<u>\$35,664,440</u>	<u>\$16,650,017</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息(不含資本化利息)	<u>\$2,366,026</u>	<u>\$1,300,591</u>
支付所得稅	<u>\$-</u>	<u>\$540,873</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
匯率影響數	<u>\$1,009,264</u>	<u>(\$66,376)</u>
一年內到期之長期負債	<u>\$50,000</u>	<u>\$-</u>
購置固定資產價款	<u>\$89,963,658</u>	\$33,619,158
應付工程及設備款	<u>(10,693,197)</u>	<u>(3,776,999)</u>
支付淨額	<u>\$79,270,461</u>	<u>\$29,842,159</u>
可轉換公司債轉換為股本及資本公積	<u>\$-</u>	<u>\$12,513,984</u>

吸收合併資訊之補充揭露：

本公司以發行新股方式吸收合併德基公司與世大公司，該等公司八十九年六月三十日之資產負債金額表列如下：

	德基公司 (公平價值)	世大公司 (帳面價值)	合計
現金	\$736,594	\$675,810	\$1,412,404
存貨	1,647,845	1,805,243	3,453,088
其他流動資產	2,308,391	3,150,257	5,458,648
固定資產－淨額	19,846,708	40,512,706	60,359,414
其他資產	7,335,526	5,101,000	12,436,526
流動負債	(16,699,147)	(12,454,686)	(29,153,833)
長期負債	(2,000,000)	(4,950,000)	(6,950,000)
其他負債	(654,863)	(23,498)	(678,361)
取得淨資產	12,521,054	33,816,832	46,337,886
因合併而註銷原持有消滅公司股份	(8,173,605)	-	(8,173,605)
合併發行新股	(4,335,152)	(11,500,000)	(15,835,152)
資本公積	<u>\$12,297</u>	<u>\$22,316,832</u>	<u>\$22,329,129</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

## 財務報表附註

(除另予註明者外，金額為新台幣仟元)

### (一) 公司沿革

本公司係由行政院開發基金管理委員會及荷蘭商飛利浦電子股份有限公司（飛利浦公司）等共同投資設立。本公司股票於台灣證券交易所上市。八十六年十月八日起，本公司部份已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。

本公司主要業務為有關積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計，暨光罩之製造及設計服務。

本公司以八十九年六月三十日為合併基準日，採取吸收合併方式合併德碁半導體公司（德碁公司）及世大積體電路公司（世大公司），以本公司為存續公司，德碁公司及世大公司則分別因合併而解散。合併股份換發比例約三點九股德碁公司股份換發一股本公司股份及二股世大公司股份換發一股本公司股份，合計本公司因此合併案而增發1,583,515 仟股之普通股，其權利義務與本公司原已發行股份相同。

德碁公司係於七十九年三月三十一日核准設立，並於八十一年一月開始營業，主要業務為動態隨機存取記憶體及其他種類積體電路之研發、設計、製造、封裝、測試及銷售等服務。

世大公司係於八十五年三月六日核准設立，於八十七年十二月一日開始主要營業活動。主要營業項目為積體電路製造代工服務。

### (二) 重要會計政策之彙總說明

#### 約當現金

約當現金係指自投資日起三個月內到期之附買回條件政府公債。

#### 短期投資

短期投資係按成本與市價孰低計價。出售成本則採個別辨認。

#### 備抵呆帳

係按應收款項收回之可能性評估認列。

#### 銷貨收入及備抵退貨及折讓

銷貨收入係於貨物移轉時認列，備抵退貨及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售年度列為銷貨之減項，相關銷貨成本則列為銷貨成本之減項。

#### 存貨

存貨係以成本與市價孰低計價。存貨平時按標準成本計價，結帳日時再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。

#### 長期投資

本公司具有重大影響力之長期股權投資，係採用權益法計價；原始投資成本與取得股權時被投資公司股權淨值間之差額，係採直線法分五年平均攤銷，並列為投資損益。本公司非按原持股比例認購採權益法計價之被投資公司增發之新股，致使投資比例發生變動，因而使所投資之股權淨值發生增減者，其增減數調整「資本公積」及「長期投資」。被投資公司之虧損如係以投資後產生之資產重估增值準備以外之資本公積彌補者，本公司依持有股份比例計算應負擔金額，調整「資本公積」及「保留盈餘」。當國外子公司之功能性貨幣為外幣時，其外幣財務報表換算後所產生之兌換差額列為股東權益項下之「累積換算調整數」。

本公司不具有重大影響力之長期股權投資，係按成本法計價。被投資公司發放現金股利時，除投資當年度應貸記長期投資外，列為當年度股利收入。取得被投資公司發放之股票股利時，僅註記增加股數，不增加投資帳面價值，亦不認列投資收益。長期投資為上市或上櫃公司股票者，則按成本與市價孰低評價，當投資帳面金額超過該股票市價時，則改按股票市價計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失列為股東權益之減項，若嗣後股票市價回升時，則應於已提列金額內予以沖回。

其他長期投資係投資海外基金，按成本與基金淨值孰低評價。當投資帳面金額超過該基金淨值時，則改按基金淨值計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失，列為股東權益之減項，若嗣後基金淨值回升時，則應於已提列金額內予以沖回。

股票出售時，其成本係按加權平均法計算。

採權益法計價時，被投資公司之當期損益中，若有出售固定資產盈餘者，則按減除所得稅後之淨額，於認列投資損益年度，按持股比例轉列資本公積，嗣後出售時，再按出售比例轉回保留盈餘。若被投資公司長期投資按成本與市價孰低評價所產生之長期投資未實現跌價損失，則按持股比例認列，並於資產負債表上列為股東權益之減項。

本公司與按權益法計價之被投資公司間順流交易所產生之未實現利益按持股比例予以銷除；若本公司對被投資公司具有控制能力者，則全數予以銷除，俟實現始認列利益。

本公司與按權益法計價之被投資公司間逆流交易所產生之未實現利益，皆按投資公司之持股比例予以銷除。

#### 固定資產及出租資產

固定資產及出租資產係按成本減累積折舊計價。重大之增添、更新及改良列為資本支出，修理及維護支出，則列為當年度費用。固定資產於購建期間支出款項所負擔之利息予以資本化。租賃資產以最低租金給付額之現值總額及租賃資產在租賃開始日之公平市價孰低入帳，應付資本租賃款則按利息法在租賃期間分期攤銷。

折舊係以直線法按下列耐用年數計提：建築物，十至二十年；機器設備，五至十年；辦公設備，三至五年。

固定資產報廢或出售時，其成本及相關之累積折舊均自帳上予以減除，出售及處分損益列為當年度損益。出售利益扣除有關所得稅後再於當年底轉列資本公積。

#### 合併商譽

本公司因併購所產生之商譽，係採直線法分十年平均攤銷。

#### 遞延借項

遞延借項主要係電腦軟體制度設計費用、公司債發行成本、應付短期票券發行成本及技術權利金及技術股作價等，分別按三、五年及票券發行期間及合約或經濟效益年限攤銷。

#### 員工退休金

本公司按精算結果認列退休金費用，未認列過渡性淨給付義務係按二十五年攤提。

#### 未實現售後收回利益

固定資產出售後再自行收回時，則出售固定資產損益予以遞延，列為未實現售後收回利益，營業租賃按租賃期間，逐期攤銷為租金費用調整項目；資本租賃則按估計之使用年數或租賃期間，逐期攤銷為折舊費用調整項目。

#### 所得稅

本公司所得稅之會計處理係作跨期間之所得稅分攤，即將可減除暫時性差異、未使用以前年度虧損扣抵及投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列相關備抵評價金額；而應課稅暫時性差異所產生之影響數認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期回轉期間之長短劃分為流動或非流動項目。

以前年度應付所得稅之調整，包含於當年度所得稅中。

本公司未分配盈餘加徵百分之十之所得稅，列為股東會決議年度費用。

#### 衍生性金融商品交易

為規避外幣淨資產或淨負債匯率風險之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率衡量入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間攤銷，應收或應付遠期外匯期末餘額，再按期末之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

非以交易為目的之利率交換合約，於簽約日因無本金移轉，僅作備忘記錄，於約定結算日及資產負債表日就合約利率與市場實際利率所計得之應收或應付金額，作為被避險資產或負債有關之利息收入或利息費用之調整。

非以交易為目的之外幣選擇權合約，於訂約日不認列資產或負債，因實際交割所產生之兌換差額，則列為當期損益。購買（或出售）外幣選擇權時，所支付（或取得）之權利金於合約期間平均攤銷，列為當期損益。

#### 以外幣為進之交易事項

非衍生性金融商品之外幣交易，係按交易當日匯率折算之新台幣金額入帳。外幣現金實際兌換成新台幣或外幣應收應付款以新台幣收付結清時，因適用不同匯率所產生之損失或盈益，列為兌換或結清年度之損益。外幣現金、資產及負債之年底餘額，按年底時之匯率予以換算，因而產生之兌換損益，則列為當期損益。

#### 科目重分類

本公司為配合八十九年度財務報表之表達而將八十八年度財務報表若干項目予以重分類，其中包括依新修訂之財務會計準則公報第十七號之規定編製現金流量表。

#### 合併

本公司合併德碁公司之會計處理係依照財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理」，並自八九年七月一日起將其損益科目併入本公司；另合併世大公司則係依照「權益結合法」之會計處理辦理，故本公司八十九年度之損益科目包含依權益結合法吸收合併原世大公司之損益科目。

另假設本公司於八十八年初即吸收合併德碁公司及世大公司，其八九年及八十八年度之合併經營結果之擬制性資訊如下：

	八十九年度	八十八年度
銷貨收入淨額	<b>\$170,163,166</b>	\$87,015,703
純益	<b>65,050,836</b>	17,714,691
每股盈餘 按加權平均發行股數－八九年11,616,455 仟股及八十八年11,029,303 仟股計算	<b>\$5.60</b>	\$1.61
於合併基準日八十九年六月三十日前個別公司資訊：		
	本公司	德碁公司
八十九年度上半年		
銷貨收入淨額	\$60,089,632	\$3,934,746
純益（損）	23,458,253	(55,358)
八十八年度		
銷貨收入淨額	73,131,206	10,655,995
純益（損）	24,559,884	(6,127,604)
	(1,032,890)	

(三) 依照「權益結合法」之會計處理，假設本公司八十八年度合併世大公司重編後之財務報表

**資產負債表**

民國八十八年十二月三十一日

現金及約當現金	\$28,505,434
短期投資	266,890
應收 帳款淨額	13,940,578
存貨	5,791,791
遞延所得稅資產	2,498,455
質押定期存款	3,161,000
預付費用及其他流動資產	2,578,883
<b>流動資產合計</b>	<b>56,743,031</b>
長期投資	28,240,267
固定資產－淨額	118,942,185
遞延所得稅資產	6,794,609
遞延借項－淨額	2,317,245
存出保證金	54,903
其他	105,137
<b>其他資產合計</b>	<b>9,271,894</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$213,197,377</b>
短期借款	5,026,631
應付商業本票	94,797
應付關係人款項	1,922,911
應付帳款	2,871,065
應付工程及設備款	6,958,098
應付所得稅	146,300
應計費用及其他流動負債	7,596,561
<b>流動負債合計</b>	<b>24,616,363</b>
長期借款	9,791,000
應付公司債	20,000,000
<b>長期負債合計</b>	<b>29,791,000</b>
應計退休金負債	1,012,045
存入保證金及其他負債	5,207,781
其他負債合計	6,219,826
<b>負債總計</b>	<b>60,627,189</b>
股本	85,208,817
預收股款	13,118,025
資本公積	22,013,734
法定公積	8,258,359
未分配盈餘	25,062,256
累積換算調整數	(1,091,003)
股東權益總計	152,570,188
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$213,197,377</b>

**損益表**

民國八十八年一月一日至十二月三十一日

銷貨收入淨額	\$76,359,708
銷貨成本	45,640,417
銷貨毛利	<u>30,719,291</u>
營業費用	
管理費用	2,326,662
行銷費用	1,976,623
研究發展費用	<u>3,090,790</u>
	7,394,075
營業利益	<u>23,325,216</u>
營業外收入	
利息收入	1,026,003
保險理賠收入	184,607
迴轉備抵短期投資損失	120,766
權利金收入	63,809
處分投資利益	29,041
租金收入	3,667
其他	<u>111,272</u>
	1,539,165
營業外費用	
利息費用	1,954,366
依權益法認列之投資淨損	1,191,891
處分固定資產損失	164,351
兌換淨損	119,141
公司債發行成本	114,839
權利金支出	86,746
處分短期投資損失	75,366
其他	<u>80,706</u>
	3,787,406
稅前利益	21,076,975
所得稅利益	<u>2,450,019</u>
純益	<u>\$23,526,994</u>

**(四) 現金及約當現金**

	八十九年底	八十八年底
現金及銀行存款	\$35,053,733	\$16,575,032
附買回條件政府公債	610,707	74,985
	<u>\$35,664,440</u>	<u>\$16,650,017</u>

(五) 存貨

	八十九年底	八十八年底
製成品	\$1,606,368	\$653,347
在製品	8,422,401	3,618,693
原料	423,444	320,685
物料及零件	<u>1,083,348</u>	718,344
	<u>11,535,561</u>	5,311,069
備抵存貨損失	(567,626)	(781,355)
	<u>\$10,967,935</u>	<u>\$4,529,714</u>

(六) 長期投資

	八十九年底		八十八年底	
	帳列金額	持股比例	帳列金額	持股比例
	%	%		
<u>股票（股單）</u>				
按權益法計價				
台積國際投資公司	\$23,678,522	100	\$10,078,880	100
世界先進積體電路公司	5,615,075	25	5,010,897	25
德碁半導體公司	-	-	3,630,193	32
台灣積體電路（北美）公司	666,924	100	255,025	100
台灣積體電路（歐洲）公司	9,594	100	25,956	100
台灣積體電路（日本）公司	37,803	100	10,168	100
SYSTEMS ON SILICON MANUFACTURING COMPANY PTE LTD. (SSMC )	935,870	32	360,177	32
柏成投資有限公司	136,984	25	103,017	25
啓信投資有限公司	139,000	25	103,012	25
功成投資有限公司	158,752	25	102,773	25
積成投資有限公司	130,794	25	102,770	25
欣瑞投資有限公司	128,100	25	103,003	25
承暉投資有限公司	138,200	25	103,005	25
TSMC PARTNERS	535,162	100	9,968	100
	<u>32,310,780</u>		<u>19,998,844</u>	
<u>按成本法計價</u>				
上市公司				
台灣光罩公司	32,129	2	32,129	2
未上市公司				
德碁半導體公司特別股	-	-	4,854,742	28
台宏半導體公司	500,000	19	500,000	19
聯亞氣體工業公司	146,250	10	146,250	11
台灣信越半導體公司	105,000	7	105,000	7
普實創業投資公司	50,000	4	50,000	4
宏通創業投資公司	120,000	10	80,000	10
	<u>953,379</u>		<u>5,768,121</u>	

(接次頁)

(承前頁)

基金

CRIMSON ASIA CAPITAL	\$64,547	-	\$34,534	-
HORIZON VENTURES	<u>93,304</u>	-	<u>31,744</u>	-
	<u>157,851</u>		<u>66,278</u>	

預付股款

台積國際投資公司	-	-	2,375,400	-
	<u>\$33,422,010</u>		<u>\$28,208,643</u>	

本公司八十九及八十八年度按權益法計價之長期投資（損）益金額係按同期間財務報表認列如下：

	八十九年度	八十八年度
台積國際投資公司	\$138,589	(\$1,007,218)
世界先進積體電路公司	597,812	(527,823)
其他	<u>42,925</u>	<u>343,150</u>
合計	<u>\$779,326</u>	<u>(\$1,191,891)</u>

本公司上述按權益法認列之投資（損）益，除八十八年度台灣積體電路（日本）公司外，其餘係依各該公司同期間經會計師查核之財務報表計算。

長期投資有關股票市價及淨值之資料如下：

	八十九年度	八十八年度
上市上櫃公司股票市價	\$8,729,639	\$19,753,642
未上市上櫃按持股比例之淨值	27,597,593	20,177,278
基金淨值	<u>157,851</u>	<u>66,278</u>

(七) 固定資產

累積折舊如下：

	八十九年度	八十八年度
建築物	\$9,816,698	\$7,441,342
機器設備	82,775,965	49,369,894
辦公設備	<u>1,739,505</u>	<u>1,158,489</u>
	<u>\$94,332,168</u>	<u>\$57,969,725</u>

截至八十九年底止，本公司擴建積體電路廠房及設備計畫如下：

擴廠計劃名稱	預計投資金額	累積支出金額	預訂或實際生產年月
積體電路第六廠	\$76,889,000	\$67,565,100	89.03
積體電路第七廠	22,540,400	11,121,100	90.03
積體電路第八廠	28,314,300	15,217,800	90.03
積體電路第十二廠－第一期	38,280,800	21,372,000	90.11
積體電路第十四廠－第一期	9,711,000	7,946,600	91.05

八十九及八十八年度利息資本化金額分別為72,903仟元及305,312仟元。

截至八十九年底止，帳列未折減餘額計7,171,081仟元之固定資產業已抵押作為長期借款之擔保品。

(八) 遲延借項－淨額

	八十九年度	八十八年度
技術權利金	\$1,442,292	\$-
電腦軟體設計費	1,420,528	541,306
技術股作價	157,500	-
公司債發行費用	45,595	37,238
其他	<u>56,695</u>	-
	<u>\$3,122,610</u>	<u>\$578,544</u>

(九) 應付租賃款

	八十九年底
應付租賃款－九十年六月底到期	\$50,000
一年內到期部分	<u>(50,000)</u>
	<u>\$-</u>

(十) 應付公司債

本公司於八十七年三月四日發行國內第一次無擔保普通公司債，發行總額4,000,000仟元，票面年利率7.71%，每半年付息一次，至九十二年三月四日到期一次償還。

本公司分別於八十七年十一月十八日至十二月一日間分次發行國內第二次無擔保普通公司債，面額總計6,000,000仟元，票面利率皆為7.12%，每年付息一次，分別於九十二年十一月底前到期，到期一次償還。本公司債券持有人得於本公司債發行日後屆滿第二年及第三年之日前三十日，要求本公司於本公司債屆滿第二年或第三年之日，以債券面額加計當期應計利息後，行使債券賣回權；本公司亦可依上述條件行使債券贖回權。本公司已於八十九年十一月提前贖回第二次無擔保普通公司債。

本公司於八十八年十月二十一日發行國內第三次無擔保普通公司債，發行總額10,000,000仟元，分為甲、乙兩類，票面利率分別為5.67%及5.95%，均為每年付息一次，分別於九十二年十月二十一日及九十三年十月二十一日到期一次償還。

本公司於八十九年十二月四日至十五日間分次發行國內第四次無擔保普通公司債，發行總額15,000,000仟元，分為甲、乙兩類。票面利率分別為5.25%及5.36%，均為每年付息一次，分別於九十四年十二月及九十六年十二月到期一次償還。

(十一) 股東權益

依據公司法之規定，資本公積只能用於彌補虧損或撥充股本。

依據本公司章程規定，每年度純益於彌補虧損後，應分配如下：

- 1 先提撥百分之十為法定公積；
- 2 次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積；
- 3 次提其餘額百分之一為董事監事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利；
- 4 次則優先發放甲種特別股股息，股息訂為年率3.5%，按當年度實際發行日數計算；
- 5 剩餘部分依股東會決議分派之。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認，並於該年度入帳。

依公司法之規定，法定公積應繼續提撥至其總額達股本總額為止。法定公積得用以彌補虧損；且當該項公積已達實收股本百分之五十時，亦得以其半數撥充股本。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就八十八年度（及以前年度）發生之股東權益減項提列特別盈餘公積1,091,003仟元後，方得以分配，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉金額分配盈餘。

本公司若分配屬於八十六年度（含）以前未分配盈餘時，股東將不獲配股東可扣抵稅額。若分配屬於八十七年度（含）以後未分配盈餘時，除屬非中華民國境內居住者之股東外，其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣抵稅額。

本公司於八十九年十一月二十九日發行不得上市之甲種特別股1,300,000仟股，其權利義務如下：

- 1 股息為年率3.5%，累積且優先於普通股分派。
- 2 不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
- 3 對於剩餘財產權之求償權優先於普通股，但以不超過發行金額為限。
- 4 於股東會與普通股股東有相同之表決權。
- 5 發行期限為二年六個月且不得轉換為普通股。屆至期限未收回者，其權利義務得以延續至收回為止。

#### (十二) 員工退休金

本公司對正式員工訂有退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休時之平均薪資計算。本公司每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶。

本公司退休金相關資訊揭露如下：

淨退休金成本為：	八十九年度	八十八年度
服務成本	\$376,689	\$248,378
利息成本	91,234	78,961
退休基金資產預期報酬	(26,675)	(22,317)
攤銷數	8,300	8,300
淨退休金成本	<u>\$449,548</u>	<u>\$313,322</u>

退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債之調節如下：

	八十九年底	八十八年底
給付義務		
既得給付義務	\$-	\$-
非既得給付義務	<u>763,879</u>	<u>428,257</u>
累積給付義務	<u>763,879</u>	<u>428,257</u>
未來薪資增加之影響數	<u>1,550,009</u>	<u>975,345</u>
預計給付義務	<u>2,313,888</u>	<u>1,403,602</u>
退休基金資產公平價值	<u>(661,099)</u>	<u>(364,994)</u>
提撥狀況	<u>1,652,789</u>	<u>1,038,608</u>
未認列前期服務成本	-	-
未認列過渡性淨給付義務	<u>(165,991)</u>	<u>(174,291)</u>
未認列退休金盈益	<u>22,737</u>	<u>135,448</u>
補列之退休金負債	-	-
應計退休金負債	<u>\$1,509,535</u>	<u>\$999,765</u>

(接次頁)

(承前頁)

退休金給付義務及計算退休金成本之假設為：

折現率	6.0%	6.5%
未來薪資水準增加率	6.0%	6.0%
退休基金資產預期投資報酬率	6.0%	6.5%
<b>退休金基金提撥及支付情況</b>		
本期提撥	<u>\$95,932</u>	<u>\$67,227</u>
吸收合併轉入	<u>\$173,339</u>	<u>\$-</u>
本期支付	<u>\$1,458</u>	<u>\$3,591</u>

### (十三) 所得稅

1 帳列稅前利益按法定稅率計算之所得稅與當期應負擔所得稅費用調節如下：

	八十九年度	八十八年度
稅前利益按法定稅率（20%）計算之稅額	(\$12,760,503)	(\$4,821,973)
所得稅調整項目之稅額影響數：		
免稅所得	7,770,000	3,434,802
暫時性差異	(49,497)	(221,129)
未分配盈餘加徵	(88,024)	-
當年度應負擔所得稅費用	<u>(\$5,128,024)</u>	<u>(\$1,608,300)</u>

2 所得稅利益構成項目如下：

	八十九年度	八十八年度
當年度應負擔所得稅費用	(\$5,128,024)	(\$1,608,300)
所得稅抵減	<u>5,128,024</u>	<u>1,587,000</u>
本期應付	-	(21,300)
遞延所得稅資產淨變動		
投資抵減	3,146,369	1,798,325
暫時性差異	(388,671)	(111,139)
遞延所得稅備抵評價調整數	(1,678,791)	(1,303,500)
以前年度所得稅調整	<u>189,693</u>	<u>87,633</u>
	<u>\$1,268,600</u>	<u>\$450,019</u>

3 遞延所得稅資產（負債）明細如下：

	八十九年度	八十八年度
流動		
投資抵減	\$8,422,000	\$2,329,000
備抵評價	<u>(300,000)</u>	<u>-</u>
淨額	<u>\$8,122,000</u>	<u>\$2,329,000</u>

(接次頁)

(承前頁)

非流動

投資 抵減	\$15,490,536	\$5,806,891
備抵評價	(8,312,433)	(1,303,500)
暫時性差異	238,879	197,268
折舊	(857,689)	(427,407)
淨額	<u>\$6,559,293</u>	<u>\$4,273,252</u>

4 兩稅合一相關資訊：

	八十九年底	八十八年底
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$5,888</u>	<u>\$1,497</u>

本公司八十九年度預計及八十八年度實際盈餘分配之稅額扣抵比率皆約為0.009%。

由於本公司得分配予股東之可扣抵稅額，應以股利盈餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為計算基礎，因是八十九年底預計盈餘分配之稅額扣抵比率可能會因本公司依所得稅法規定預計可能產生之各項可扣抵稅額與實際不同而須調整。

5 八十九年底及八十八年底中屬於八十六年度(含)以前之未分配盈餘分別為4,827仟元和752,612仟元。

本公司八十九年底及八十八年底用以計算遞延所得稅之有效稅率約7.54%及5.9%。

截至八十九年底止，未使用之機器設備及研究發展費用投資抵減，得用以抵減以後年度應納稅額如下：

到期年度	投資抵減金額
八十九	\$2,899,245
九十	4,015,461
九十一	4,800,268
九十二	5,738,563
九十三	<u>6,458,999</u>
	<u>\$23,912,536</u>

截至八十九年底止，本公司各次增資擴展可享受四年免稅如下：

增資擴展案	免稅期間
二廠擴建、電腦輔助設計擴充及新增三廠	八十五年至八十八年度
一廠、二廠第一、二生產單位及三廠擴建、新增四廠	八十六年至八十九年度
一廠、二廠第一、二生產單位、三廠及四廠擴建、新增五廠	八十八年至九十一年度

本公司截至八十五年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

#### (十四) 關係人交易

除已於財務報表及其他附註中揭露者外，重大之關係人交易及餘額彙總如下：

##### 1 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
工研院本公司董事長為工研院之董事	
飛利浦公司	本公司主要股東之一
台積國際投資公司	本公司之子公司
台灣積體電路（北美）公司（北美子公司）	本公司之子公司
台灣積體電路（歐洲）公司（歐洲子公司）	本公司之子公司
台灣積體電路（日本）公司（日本子公司）	本公司之子公司
世界先進積體電路公司（世界先進公司）	本公司之被投資公司
德碁半導體公司（德碁公司）	被合併公司
Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)	本公司之被投資公司
WAFERTECH,LLC	本公司間接持有之子公司
TSMC Technology	本公司間接持有之子公司

##### 2 關係人交易

	八十九年		八十八年	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)
<u>全年度</u>				
銷貨收入				
工研院	\$198,146	-	\$132,507	-
飛利浦及其聯屬公司	5,289,927	3	2,864,149	4
世界先進公司	17,012	-	48,473	-
德碁公司	-	-	22,246	-
WAFERTECH,LLC	30,816	-	59,438	-
	<u>\$5,535,901</u>	<u>3</u>	<u>\$3,126,813</u>	<u>4</u>
進貨				
WAFERTECH,LLC	\$13,296,633	37	\$4,636,780	40
世界先進公司	6,572,110	19	381,989	3
德碁公司	-	-	808,926	7
	<u>\$19,868,743</u>	<u>56</u>	<u>\$5,827,695</u>	<u>50</u>
租金費用				
工研院	\$161,575	14	\$161,488	54
製造費用				
飛利浦公司（技術報酬金）	<u>\$2,137,175</u>	<u>86</u>	<u>\$862,398</u>	<u>100</u>
管理費用				
世界先進公司（顧問費）	<u>\$-</u>	<u>-</u>	<u>\$20,400</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

行銷費用

北美子公司（佣金）	\$994,686	34	\$692,927	38
北美子公司（服務費）	118,852	4	99,087	5
歐洲子公司（佣金）	143,461	5	87,414	5
日本子公司（佣金）	165,087	5	81,951	4
	<u>\$1,422,086</u>	<u>48</u>	<u>\$961,379</u>	<u>52</u>

出售固定資產

WAFERTECH,LLC	\$-	-	\$350,969	100
世界先進公司	87,189	37	-	-
	<u>\$87,189</u>	<u>37</u>	<u>\$350,969</u>	<u>100</u>

營業外收入

SSMC（主要係技術服務收入）	\$152,347	3	\$-	-
世界先進公司	5,604	-	-	-
其他	1,787	-	-	-
	<u>\$159,738</u>	<u>3</u>	<u>\$-</u>	<u>-</u>

年底餘額

應收關係人款項

工研院	\$56,078	6	\$18,458	4
飛利浦及其聯屬公司	643,604	65	133,245	28
日本子公司	-	-	17,550	4
世界先進公司	159,890	16	25,674	6
WAFERTECH,LLC	20,361	2	198,163	42
TSMC TECHNOLOGY	25,728	2	47,343	10
SSMC	89,154	9	5,353	1
德碁公司	-	-	23,117	5
	<u>\$994,815</u>	<u>100</u>	<u>\$468,903</u>	<u>100</u>

預付費用及其他流動資產

預付租金－工研院	\$42,664	6	\$42,541	2
----------	----------	---	----------	---

應付關係人款項

飛利浦及其聯屬公司	\$797,375	18	\$305,756	16
北美子公司	166,063	4	125,637	6
歐洲子公司	66,343	2	13,422	1
日本子公司	16,165	-	13,189	1
世界先進公司	1,808,964	42	184,741	10
WAFERTECH, LLC	1,487,181	34	730,483	38
TSMC TECHNOLOGY	4,487	-	3,832	-
德碁公司	-	-	539,466	28
	<u>\$4,346,578</u>	<u>100</u>	<u>\$1,916,526</u>	<u>100</u>

上列與關係人交易之價格及收付款條件除出售固定資產及技術服務係依合約規定外，餘均與非關係人相當。應付WAFERTECH, LLC款項，係本公司向其購買成品及不足預定產能之補償金，因無相關同類交易可循，其金額均依合約約定計算。

### (十五) 重大長期營業租賃

本公司積體電路第一廠之土地、廠房及部分機器設備係向工業技術研究院（工研院）承租，至九十一年三月底止。目前年租金為170,656仟元（含服務費及管理費），租約到期時雙方可協議續約。

本公司積體電路第二廠至第十四廠之土地係向科學工業園區管理局承租，租期分別於九十七年三月至一〇八年十一月間到期。租金每年共計172,000仟元，到期時可再續約。

前述租約未來五年及以後年度之租金如下：

年度	金額
九十	\$342,657
九十一	214,664
九十二	172,000
九十三	172,000
九十四	172,000
九十五至一〇八	1,488,431
	<u>\$2,561,752</u>

### (十六) 承諾事項

截至八十九年底止，重大承諾事項如下：

- 1 與飛利浦公司簽訂技術合作合約，自七十七年一月一日起，按約定產品銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金。合約有效期間為十年；除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。本公司已於八十六年五月十二日與飛利浦公司修訂上述合約，自八十六年七月九日起生效，合約延展十年，並於到期後自動展期，每次三年。依據上述修訂合約之規定，自修訂合約生效滿五年後，本公司若須支付權利金予任何第三人，該金額可自應支付予飛利浦公司之技術報酬金中扣除，惟每年應支付之技術報酬金仍不得低於特定比例。
- 2 於特定股權條件，承諾飛利浦及其聯屬公司每年得預訂本公司最高達百分之三十之產能，惟應於合理期間前通知。
- 3 與工研院簽訂次微米技術授權契約，於五年內支付授權費129,400仟元（含5%加值型營業稅，業已全數支付），並按約定產品銷貨收入淨額之一定百分比支付權利金至八十七年底止，合約有效期間至八十九年十二月三十一日止。另與工研院簽訂技術合作契約，本公司應於契約有效期限內提供經濟部及其指定對象最高達35%之產能。
- 4 與TSMC Development, Inc.（台積國際投資公司之子公司）共同簽訂一製造合約。依該約規定，須於WAFERTECH, LLC (TSMC Development, Inc. 投資設立之晶圓代工廠) 量產後三年內，向其購買至少百分之八十五之產能；若不購足，本公司應就未購足部份產品價款扣除未投入成本後之淨額補償TSMC Development, Inc.，TSMC Development, Inc.已將此合約之權利讓與WAFERTECH, LLC。
- 5 與若干主要客戶簽訂晶圓代工相關合約，依合約之規定本公司以預收保證金之方式保留一定產能予該等客戶。截至八十九年底止，該等存入保證金計美金213,865仟元。
- 6 與飛利浦公司及新加坡經濟發展局於八十八年三月三十日簽訂合資協議書。依該協議書約定，由三方共同出資約十二億新加坡幣於新加坡設立晶圓代工廠”Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd” (“SSMC”)，其中本公司持有股份百分之三十二。依約定飛利浦公司與本公司有義務購買特定比例之SSMC產能，若任一方無法購足其承諾之產能且SSMC產能使用率低於一定比例時，應賠償SSMC相關成本損失。
- 7 與SSMC於八十八年五月十二日簽訂技術合作合約，依合約規定SSMC應按其銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金予本公司，合約有效期間為十年，除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。
- 8 本公司分別為TSMC Development, Inc.及北美子公司之融資美金268,000仟元及40,000仟元提供背書保證。
- 9 與National Semiconductor Corporation (“National”)於八十九年六月二十七日簽訂技術移轉契約。依該契約約定，National應給付技術授權費予本公司。合約有效期間為十年，除非任一方於特定條件下提前終止本契約，本契約於到期後自動展期，每次二年。

10 與世界先進公司簽訂晶圓代工合約，自八十九年二月起，世界先進公司應保留特定產能予本公司，並按雙方約定之價金製造本公司客戶所要求之產品，本公司亦同意給付世界先進公司新台幣1,200,000 仟元之保證金。另本公司每訂購一定產能，世界先進公司應按特定比例無息分批退還該保證金，本合約有效期間為五年。

11 於八十九年底已開立未使用之信用狀金額約250,338 仟元。

#### **(十七) 其他附註揭露之事項**

(一) 重大交易事項及 (二) 轉投資事業相關資訊：

- 1 資金貸與他人。（附表一）
- 2 為他人背書保證。（附表二）
- 3 期末持有有價證券情形。（附表三）
- 4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表四）
- 5 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表五）
- 6 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 7 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表六）
- 8 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表七）
- 9 被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊。（附表八）
- 10 從事衍生性商品交易：

本公司八十九及八十八年度從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率及利率波動所產生之風險，本公司之避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的，均屬非以交易為目的之避險活動，茲將有關資訊揭露如下：

(1) 遠期外匯買賣合約：

截至八九年及八十八年底止，尚未到期之遠期外匯合約金額如下：

	幣別	合約金額（仟元）	公平價值（仟元）	到期日	到期值（仟元）
<u>八九年年底</u>					
買入遠期外匯	美金	USD 60,000	NTD 1,978,998	90.01	NTD 1,989,006
賣出遠期外匯	美金	USD 106,993	NTD 3,582,959	90.01~02	NTD 3,553,080
賣出遠期外匯	美金	USD 156,875	NTD 5,100,386	90.01	NTD 5,091,560
賣出遠期外匯	美金	USD 365,000	NTD 12,105,459	90.01~12	NTD 12,032,465
<u>八十八年底</u>					
買入遠期外匯	美金	USD 25,000	JPY 2,472,080	89.07	NTD 879,154
賣出遠期外匯	美金	USD 81,367	JPY 8,303,350	89.01~07	NTD 2,564,297
賣出遠期外匯	美金	USD 16,000	NLG 34,926	89.01	NTD 497,159
賣出遠期外匯	美金	USD 30,000	NTD 941,847	89.01	NTD 947,880

本公司八九年及八十八年底因遠期外匯買賣合約所產生之應收款項分別為49,480 仟元及19,144 仟元（帳列其他流動資產）及應付款項分別為178,952 仟元及102,784 仟元（帳列其他流動負債）。八九年及八十八年度分別認列兌換淨損266,393 仟元及兌換淨益105,859 仟元。

上述遠期外匯合約係為規避下列淨資產或淨負債之匯率變動風險。

淨資產或淨負債	八十九年底	八十八年底
應收帳款	USD 813,685	USD 375,749
應付帳款及應付工程及設備款	USD 571,332	USD 151,392
	JPY 21,237,708	
	EUR 62,480	
存入保證金	-	USD 764,765

(2) 利率交換合約

本公司與數家銀行簽訂利率交換合約，以固定區間利率換取浮動利率，用以規避長期借款採浮動利率計息產生之利率變動風險，八九年及八十八年度產生之利息支出分別為113,683 仟元及112,213 仟元，截至八十九年底止，本公司簽訂之利率交換合約彙總如下：

合約簽訂日	期間	合約金額（仟元）
87年4月28日	87年5月21日~92年5月21日	\$2,000,000
87年4月29日	87年5月21日~92年5月21日	1,000,000
87年6月26日	87年6月26日~92年6月26日	1,000,000
87年6月26日	87年7月6日~92年7月6日	1,000,000

(3) 外幣選擇權合約

本公司八十九及八十八年度因預期將自外銷貨取得美金收入及外購機器設備以日幣支應，故與銀行簽訂外幣選擇權合約，以規避外幣匯率波動所可能造成之不利影響。

截至八九年及八十八年底止，尚未到期之外幣選擇權合約彙總如下：

類別	交易	選擇權	合約金額（仟元）	帳面價值	公平價值	執行價格	到期日
<u>八十九年底</u>							
歐式	出售	賣權	EUR 525,537	\$ -	(\$189,735)	0.8870~0.9680 (美元兌歐元)	90.05
歐式	出售	買權	USD 203,500	-	(264,885)	107.77~110.5 (美元兌日幣)	90.03
歐式	出售	買權	USD 20,000	-	(1,485)	32.42 (美元兌台幣)	90.01
歐式	買入	賣權	USD 15,000	-	37	110~110.5 (美元兌日幣)	90.02
<u>八十八年底</u>							
歐式	出售	買權	USD 100,000	\$ 3,911	\$3,911	0.9785~0.9940 (美元兌歐元)	89.01
歐式	出售	買權	USD 60,000	3,035	3,035	106.6 (美元兌日幣)	89.01

八九年及八十八年度認列之權利金收入分別為116,248 仟元及63,809 仟元，權利金支出分別為108,133 仟元及86,746 仟元。

(4) 交易風險

- a 信用風險－交易對象皆為國內信用良好之金融機構，預期不致產生重大信用風險。
- b 市場價格風險－從事衍生性金融商品交易即在規避外幣淨資產或淨負債因匯率或利率波動所產生之風險，因是匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷，而利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場價格風險並不重大。
- c 流動性風險及現金流量風險－從事遠期外匯及外幣選擇權交易即在規避淨資產或淨負債之匯率變動風險，因到期時有相對之現金流入或流出，本公司之營運資金足以支應，而利率交換合約之利率亦已考量本公司未來資金成本所訂定，故無籌資風險。因遠期外匯及外幣選擇權合約之匯率及利率交換合約之利率已確定，不致有重大之現金流量風險。

(5) 金融商品之公平價值

非衍生性金融商品	八十九年底		八十八年底	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<b>資產</b>				
現金及約當現金	\$35,664,440	\$35,664,440	\$16,650,017	\$16,650,017
短期投資	-	-	236,250	241,850
應收關係人款項	994,815	994,815	468,903	468,903
應收票據及帳款	30,460,489	30,460,489	13,544,387	13,544,387
長期投資	33,422,010	36,485,083	28,208,643	39,997,198
質押定存	46,856	46,856	8,710	8,710
存出保證金	967,985	967,985	16,346	16,346
<b>負債</b>				
應付關係人款項	4,346,578	4,346,578	1,916,526	1,916,526
應付帳款	7,989,953	7,989,953	2,525,086	2,525,086
應付工程及設備款	24,392,400	24,392,400	6,958,098	6,958,098
應付公司債	29,000,000	29,035,803	20,000,000	20,013,774
存入保證金	7,086,379	7,086,379	5,185,362	5,185,362
<b>衍生性金融商品</b>				
買入遠期外匯	1,984,740	1,978,998	784,875	760,906
賣出遠期外匯	20,802,311	20,788,804	3,998,698	3,998,108
利率交換合約	1,601	234,017	7,488	7,488
選擇權合約	-	(456,068)	6,946	6,946

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- a 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
- b 短期投資係以市場價格為公平價值。
- c 長期投資於上市上櫃公司者以其市場價格為公平價值，投資於非上市上櫃公司及其他長期投資者，以資產負債表之淨值作為估計其公平價值之基礎。
- d 存出（入）保證金之未來收現（支付）金額與帳面金額相近，故以帳面金額為公平價值。
- e 長期負債以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以本公司所能獲得類似條件之長期負債利率為準。本公司之長期負債利率除公司債外，均屬浮動利率，其帳面價值即為公平市價，故僅評估公司債之折現值。
- f 本公司係以銀行報價所顯示之外匯換匯匯率及利率，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率及利率交換合約分別計算個別合約之公平價值。

因部份金融商品及非金融商品無須列示其公平價值，是以上表所列公平價值總數並不代表本公司之總價值。

#### (十八) 部門別資訊

##### **1 外銷銷貨資訊**

本公司之外銷銷貨明細如下：

地區	八十九年度	八十八年度
美洲	\$81,686,803	\$38,084,870
亞洲	42,906,968	16,493,721
歐洲	11,360,517	4,778,646
	<u>\$135,954,288</u>	<u>\$59,357,237</u>

本公司外銷銷貨資訊係以收款地區為計算基礎。

##### **2 重要客戶資訊**

佔本公司銷貨收入百分之十以上之客戶：無

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

資金貸與他人

民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表一

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象 資金貸與限額 (美金為仟元)	本期最高餘額 (美金為仟元)	期末餘額 (美金為仟元)	利率區間	資金貸 與原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品	業務往 來金額	資金貸與最 高限額
										名稱		
1	台積國際投資公司	TSMC Technology	其他應收款	-	USD13,887	USD13,887	7.75%	營運資金	\$-	-	\$-	USD779,788 (註一)
2	世界先進公司	VIS America	預付費用	(註二)	\$6,122	\$1,232	-	預付委託 開發設計費	-	-	-	5,706 \$4,400,000 (註三)

註一： 貸放資金總額不得超過公司實收資本額。

註二： 貸放資金予個別對象不得超過公司實收資本額之10%，並限於借款人實收資本額之30%以內。

註三： 貸放資金總額不得超過公司實收資本額之20%。

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

為他人背書保證

民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象 公司名稱 關係 (註二)	對單一企業背書保證之限額	本期最高背書 保證餘額 (美金為仟元)	期末背書 保證餘額 (美金為仟元)	以財產擔保 之背書保證 金額	累計背書保 證金額佔最 近期財務報 表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註一)
0	台灣積體 電路公司	TSMC Develop- ment Inc.	3 不超過本公司實收資本額之 10%，惟以該被背書保證公 司之實收資本額為限：	\$8,865,172 (USD268,000)	\$8,865,172 (USD268,000)	\$8,865,172	3.39%	\$38,968,094
	台灣積體電路 (北美) 公司	2 倘經董事會核准，則不受單一 企業背書保證之限制。		\$1,323,160 (USD40,000)	\$1,323,160 (USD40,000)	1,323,160	0.51%	

註一：本公司實收資本額百分之三十。

註二：2係直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

3係母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

期末持有有價證券情形  
民國八十九年十二月三十一日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
<b>台灣積體電路公司</b>							
台灣積體電路（北美）公司股票	子公司	長期投資	11,000	\$666,924	100	\$666,924	
台灣積體電路（歐洲）公司股票	子公司	長期投資	-	9,594	100	9,594	
台灣積體電路（日本）公司股票	子公司	長期投資	2	37,803	100	37,803	
世界先進積體電路公司股票	被投資公司	長期投資	556,133	5,615,075	25	8,642,314	
台積國際投資公司股票	子公司	長期投資	779,788	23,678,522	100	23,678,522	
柏成投資有限公司股單	被投資公司	長期投資	-	136,984	25	136,984	
啓信投資有限公司股單	被投資公司	長期投資	-	139,000	25	139,000	
功成投資有限公司股單	被投資公司	長期投資	-	158,752	25	158,752	
積成投資有限公司股單	被投資公司	長期投資	-	130,794	25	130,794	
欣瑞投資有限公司股單	被投資公司	長期投資	-	128,100	25	128,100	
承暉投資有限公司股單	被投資公司	長期投資	-	138,200	25	138,200	
TSMC Partners 股票	子公司	長期投資	300	535,162	100	535,162	
SSMC 股票	被投資公司	長期投資	90	935,870	32	935,870	
台灣光罩公司股票	-	長期投資	6,887	32,129	2	87,325	
聯亞氣體工業公司股票	-	長期投資	10,058	146,250	10	155,041	
台灣信越半導體公司股票	-	長期投資	10,500	105,000	7	105,476	
普實創業投資公司股票	-	長期投資	5,000	50,000	4	81,059	
台宏半導體公司股票	-	長期投資	50,000	500,000	19	434,385	
宏通創業投資公司股票	-	長期投資	12,000	120,000	10	125,927	
Crimson Asia Capital 受益憑證	-	長期投資	-	64,547	不適用	64,547	
Horizon Ventures Fund 受益憑證	-	長期投資	-	93,304	不適用	93,304	
<b>積成投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	2,160	98,282	-	184,451	
柏成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,191	15	82,191	

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱 行人之關係	與有價證券發 行 人 之 關 係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
啓信投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	\$83,400	15	\$83,400	
欣瑞投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	76,860	15	76,860	
功成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	95,251	15	95,251	
承暉投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,920	15	82,920	
<hr/>							
功成投資公司							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	4,827	226,819	-	412,317	質押4,827仟股
柏成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,191	15	82,191	
啓信投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	83,400	15	83,400	
積成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	78,476	15	78,476	
欣瑞投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	76,860	15	76,860	
承暉投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,920	15	82,920	
<hr/>							
柏成投資公司							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	3,814	236,150	-	325,790	質押2,814仟股
啓信投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	83,400	15	83,400	
積成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	78,476	15	78,476	
欣瑞投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	76,861	15	76,861	
功成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	95,251	15	95,251	
承暉投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,920	15	82,920	
<hr/>							
承暉投資公司							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	4,298	243,391	-	367,074	質押3,297仟股
柏成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,191	15	82,191	
啓信投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	83,400	15	83,400	
積成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	78,476	15	78,476	
欣瑞投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	76,860	15	76,860	
功成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	95,251	15	95,251	

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期末			備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	
<b>啓信投資公司</b>						
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	2,544	\$138,747	-	\$217,270 質押2,543仟股
柏成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,191	15	82,191
積成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	78,476	15	78,476
欣瑞投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	76,860	15	76,860
功成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	95,251	15	95,251
承暉投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,920	15	82,920
<b>欣瑞投資公司</b>						
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	1,006	85,850	-	85,936
柏成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,191	15	82,191
啓信投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	83,400	15	83,400
積成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	78,476	15	78,476
功成投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	95,251	15	95,251
承暉投資公司股單	主要股東	長期投資	6,000	82,920	15	82,920
<b>台積國際投資公司</b>						
InveStar Semiconductor Development Fund Inc.股票	本公司之子公司 台積國際投資公 司之子公司	長期投資	45,000	USD53,602	97	USD53,995
InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.股票	本公司之子公司 台積國際投資公 司之子公司	長期投資	13,950	USD14,046	97	USD14,046
TSMC Development Inc.股票	本公司之子公司 台積國際投資公 司100% 持有之 子公司且該公司 董事長為本公司 董事長	長期投資	1	USD648,332	100	USD648,332

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
<b>台積國際投資公司</b>							
TSMC Technology Inc.股票	本公司之子公司 台積國際投資公 司持有之子公司 且該公司董事長 為本公司董事長	長期投資	1	(USD5,285)	100	(USD5,285)	
3DFX. Interactive Inc.股票	-	長期投資	68	USD297	-	USD84	
<b>世界先進公司</b>							
VIS Associates Inc.股票	本公司之子公司	長期投資	23,570	\$464,077	100	\$464,077	
力晶半導體公司股票	被投資公司	長期投資	168,488	2,651,216	9	3,315,837	
鈺創科技公司股票	-	長期投資	5,590	310,132	3	278,118	
華新先進電子公司股票	被投資公司	長期投資	31,410	414,481	10	414,481	
米錦科技公司股票	-	長期投資	16,500	177,000	15	177,000	
Form Factor Inc. 股票	-	長期投資	267	64,360	1	64,360	
聯亞氣體工業公司股票	-	長期投資	2,313	29,250	2	29,250	
<b>VIS Associates Inc.</b>							
VIS Investment Holding, Inc.股票	本公司之子公司 VIS Associates Inc.100%持有之 子公司	長期投資	67,500	USD871	100	USD871	
Silicon Valley Equity Fund 權益證券	-	長期投資	-	USD9,448	35	USD9,448	
Silicon Valley Equity Fund II 權益證券	-	長期投資	-	USD3,326	16	USD3,326	
Grand Palace Trust 信託	-	長期投資	-	-	100	-	
<b>VIS Investment Holding, Inc.</b>							
VIS Micro Inc.股票	被投資公司	長期投資	200	USD237	100	USD237	
VIS America 股票	被投資公司	長期投資	6,500	USD627	100	USD627	

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期末			備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	
<b>TSMC Development</b>						
WAFERTECH, LLC 股份	本公司之子公司 TSMC Develop- ment 之被投資公 司且該公司董事 長為本公司董事長	長期投資	-	USD623,957	97	USD623,957
<b>TSMC Partners</b>						
台灣積體電路公 司美國存託憑證	母公司	短期投資	495	USD7,357	-	USD8,916
<b>InveStar Semiconductor Development Fund Inc.</b>						
Silicon Image, Inc. 普通股股票	-	短期投資	411	USD720	-	USD2,237
Sage, Inc. 普通股股票	-	短期投資	140	USD506	-	USD2,065
Centillium Tec. Corp. 普通股股票	-	短期投資	165	USD650	-	USD3,671
Marvell Technology Group Ltd. 普通股股票	-	短期投資	4,665	USD4,579	-	USD102,347
Silicon Labo Ratories 普通股股票	-	短期投資	15	USD482	-	USD219
常億科技股份有限公司普通股股票	-	長期投資	1,113	USD1,500	-	USD1,500
Capella Microsystems, Inc. 普通股股票	-	長期投資	42	USD10	-	USD10
Equator Technologies, Inc. 普通股股票	-	長期投資	133	USD90	-	USD260
Scenix Semiconductor Inc. 普通股股票	-	長期投資	861	USD172	-	USD172
Global Test Corp. 普通股股票	-	長期投資	11,292	USD5,559	-	USD9,242
Chip strate 普通股股票	-	長期投資	6,660	USD2,142	-	USD2,190
Ritch Tech 普通股股票	-	長期投資	790	USD313	-	USD302
APE 富鼎先進普通股股票	-	長期投資	2,750	USD1,518	-	USD1,411
<b>InveStar Semiconductor Development Fund Inc.</b>						
Integrated Memory Logic, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,831	USD1,809	-	USD2,559
Divio (Next wave) 特別股股票	-	長期投資	667	USD500	-	USD2,233
SiRF Technology Inc. 特別股股票	-	長期投資	306	USD1,333	-	USD1,771

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
Rise 特別股股票	-	長期投資	600	USD1,500	-	USD1,500	
Capella Microsystems, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,383	USD1,298	-	USD1,383	
Sensory, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,404	USD1,250	-	USD1,250	
Equator Technologies, Inc. 特別股股票	-	長期投資	443	USD1,338	-	USD864	
Light Speed Semiconductor Corporation 特別股股票	-	長期投資	2,252	USD3,064	-	USD5,639	
Empower Tel Networks, Inc. 特別股股票	-	長期投資	3,840	USD5,128	-	USD14,980	
Lara Technology, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,544	USD772	-	USD10,034	
Scenix Semiconductor Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,056	USD1,361	-	USD2,919	
RapidSteam 特別股股票	-	長期投資	2,056	USD1,050	-	USD7,286	
Tropian, Inc (Premier R.F., Inc.) 特別股股票	-	長期投資	1,758	USD2,334	-	USD7,498	
Sonics, Inc. 特別股股票	-	長期投資	2,686	USD3,530	-	USD4,110	
Pico Turbo, Inc 特別股股票	-	長期投資	1,050	USD1,250	-	USD1,250	
T-Span Systems Corporation 特別股股票	-	長期投資	1,266	USD1,385	-	USD3,653	
NanoAmp Solutions, Inc. 特別股股票	-	長期投資	541	USD853	-	USD1,900	
Formfactor, Inc. 特別股股票	-	長期投資	267	USD2,000	-	USD2,747	
Monolithic Power Systems, Inc 特別股股票	-	長期投資	2,521	USD2,000	-	USD2,000	
Memsic, Inc 特別股股票	-	長期投資	3	USD1,500	-	USD1,500	
Reflectivity, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,064	USD2,000	-	USD2,000	
Signia 特別股股票	-	長期投資	3,000	USD1,500	-	USD1,500	
Match Lab, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,875	USD1,500	-	USD1,500	
HINT Corporation 特別股股票	-	長期投資	1,000	USD1,000	-	USD1,000	
Creosys, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,500	USD1,500	-	USD1,500	
Incentia Design Systems, Inc. 特別股股票	-	長期投資	286	USD500	-	USD500	
Rise 債券	-	長期投資	不適用	USD300	-	USD300	

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類 及名稱 行人之關係	與有價證券發 行 人 之 關 係	帳列科目	期末			備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	
<b>InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.</b>						
Lara Networks, Inc. 特別股股票	-	長期投資	188	USD1,500	-	USD1,500
Seagull Semiconductor, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,389	USD1,250	-	USD1,250
Memsic, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,818	USD1,000	-	USD1,000
OEpic 特別股股票	-	長期投資	600	USD750	-	USD750
FabCentric, Inc. 特別股股票	-	長期投資	500	USD250	-	USD250
Equator Technologies, Inc. 特別股股票	-	長期投資	770	USD1,501	-	USD1,501
NanAmp Solutions, Inc. 特別股股票	-	長期投資	250	USD1,000	-	USD1,000
RapidStream, Inc. 特別股股票	-	長期投資	246	USD1,057	-	USD1,057
FabCentric, Inc. 債券	-	長期投資	不適用	USD250	-	USD250
Signia Technologies, Inc. 債券	-	長期投資	不適用	USD500	-	USD500
Advanced Analogic Technology, Inc. 債券	-	長期投資	不適用	USD1,250	-	USD1,250

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表四

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			期末		
				股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	
				(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)		(仟股)	(美金為仟元)	
<b>台灣積體電路公司</b>													
台北銀行股票	短期投資	-	-	8,750	\$236,250	-	\$-	8,750	\$288,719	\$236,250	\$52,469	-	\$-
國際萬鵠證券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	18,207	230,000	18,207	231,644	230,000	1,644	-	-
光華債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	25,495	323,000	25,495	326,273	323,000	3,273	-	-
日盛債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	26,382	300,000	26,382	302,604	300,000	2,604	-	-
群益安泰收益投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	24,468	300,000	24,468	302,748	300,000	2,748	-	-
元大萬泰投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	25,484	300,000	25,484	302,523	300,000	2,523	-	-
統一全臺打投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	28,222	332,000	28,222	333,627	332,000	1,627	-	-
大華債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	57,900	630,000	57,900	633,522	630,000	3,522	-	-
中信債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	26,842	340,000	26,842	341,476	340,000	1,476	-	-
怡富台灣債券基金	短期投資	-	-	-	-	25,593	330,000	25,593	332,564	330,000	2,564	-	-
建弘台灣債券基金	短期投資	-	-	-	-	25,556	300,000	25,556	301,955	300,000	1,955	-	-
建弘全家福基金	短期投資	-	-	-	-	2,956	410,000	2,956	411,752	410,000	1,752	-	-
聯合債券基金	短期投資	-	-	-	-	30,054	330,000	30,054	331,605	300,000	1,605	-	-
統一強棒基金	短期投資	-	-	-	-	46,405	600,000	46,405	603,210	600,000	3,210	-	-
世界先進公司股票	長期投資	世界先進公司	被投資公司	556,133	5,010,897	-	-	-	-	-	-	556,133	5,615,075
台積國際投資公司股票	長期投資	台積國際投資公司	子公司	464,788	12,454,280	315,000	10,409,490	-	-	-	-	779,788	23,678,522
													(註一)
System on Silicon Manufacturing Company (SSMC) 股票	長期投資	SSMC	被投資公司	26	360,177	64	989,690	-	-	-	-	90	935,870
台灣積體電路製造（北美）公司股票	長期投資	台灣積體電路製造（北美）公司	子公司	1,000	255,025	10,000	308,130	-	-	-	-	11,000	666,924
<b>功成投資公司</b>													
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	984	50,509	4,682	219,376	839	172,270	43,066	129,204	4,827	226,819

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		期末	
				股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益
				(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)		(美金為仟元)
<b>柏成投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	642	\$88,519	3,603	\$206,936	430	\$88,166	\$59,306	\$28,860
										3,814	\$236,150
<b>承輝投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	642	88,732	4,288	239,512	632	119,571	84,853	34,718
										4,298	243,391
<b>啓信投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	642	87,157	2,439	124,547	537	110,211	72,957	37,254
										2,544	138,747
<b>台積國際投資公司</b>											
TSMC Development Inc. 股票	長期投資	TSMC Development Inc.	子公司	1	USD42,018	-	USD315,000	-	-	-	1 USD648,332
InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.股票	長期投資	InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.	子公司	-	-	13,950	USD13,995	-	-	-	13,950 USD14,046
<b>TSMC Development</b>											
WAFERTECH, LLC股份	長期投資	WAFERTECH, LLC	子公司	-	USD401,464	-	USD226,105	-	-	-	USD623,957
<b>TSMC Partners</b>											
<b>台灣積體電路公司</b>											
美國存託憑證	短期投資	-	-	302	USD3,703	193	USD3,654	-	-	-	495 USD7,357
<b>InveStar Semiconductor Development Fund Inc. :</b>											
Empower Tel Networks, Inc.	長期投資	Empower Tel Networks, Inc.	被投資公司	3,087	USD1,878	752	USD3,250	-	-	-	3,840 USD5,128
Global Test Corp.	長期投資	Global Test Corp.	被投資公司	7,500	USD2,281	3,792	USD3,278	-	-	-	11,292 USD5,559

(接次頁)

(淨前頁)

有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			期末		
				股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	金額(註一)
				(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)			(仟股)	(美金為仟元)
<b>世界先進公司</b>													
中信債券型基金	-	-	-	-	-	58,761	\$750,000	58,761	\$761,731	\$750,000	\$11,731	-	-
光華債券型基金	-	-	-	-	-	42,671	550,000	42,671	558,584	550,000	8,584	-	-
大眾債券型基金	-	-	-	-	-	16,199	180,000	16,199	182,393	180,000	2,393	-	-
建弘全家福基金	-	-	-	-	-	3,921	550,000	3,921	558,516	550,000	8,516	-	-
元大萬泰基金	-	-	-	-	-	45,921	550,000	45,921	558,212	550,000	8,212	-	-
中華富泰基金	-	-	-	-	-	31,415	400,000	31,415	404,997	400,000	4,997	-	-
大華債券基金	-	-	-	-	-	21,446	240,000	21,446	242,656	240,000	2,656	-	-
<b>VIS Associates Inc.</b>													
Silicon Valley Equity Fund II	長期投資	Asia Tech Management LLC.	-	-	-	-	-	USD3,400	-	-	-	USD3,326 (註三)	

註一： 倘期初預付股款，於本期取得75,000仟股。

註二： 期末金額係包含按權益法認列之投資損益及累積換算調整數。

註三： 期末金額係包含信託基金淨值之變動。

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表五

單位：新台幣仟元

取得之 公司	財產名稱	交易日 或事實 發生日	交易金額	價款支付 情形	交易對象 關係	交易對象為關係人者， 其前次移轉資料		價格決定之 參考依據	取得目的及 使用之情形	其他約 定事項
						所有人 之關係	與公司 日期			
台灣積體 電路公司	六廠廠房 及辦公室	89/2/16~ 89/12/31	\$3,254,412	依工程進度 互助營造	-	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標 生產使用 無

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表六

單位：新台幣仟元

交易對象	關係	交易情形			交易條件與一般交易不同之情形及原因	應收（付）票據、帳款		備註
		進（銷）貨 金額	佔總進（銷）貨之比率 (%)	授信期間		餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率 (%)	
<b>台灣積體電路公司</b>								
工研院	本公司董事長為其董事	銷貨	\$198,146	- 月結45天	無	無	\$56,078	6
飛利浦及其聯屬公司	本公司主要股東之一	銷貨	5,289,927	3 發票日後30天	無	無	643,604	65
WAFERTECH, LLC	本公司間接持有之子公司	進貨	13,296,633	37 月結30天	無	無	(1,487,181)	(34)
世界先進公司	被投資公司	進貨	6,572,110	19 月結45天	無	無	(1,808,964)	(42)

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年十二月三十一日

附表七

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
台灣積體電路公司	飛利浦及其聯屬公司	本公司主要股東之一	\$643,604	27 天	\$175,828	持續催收	\$193,403	\$-
世界先進公司	被投資公司		159,890	不適用	10,080	持續催收	-	-

台灣積體電路製造股份有限公司及其轉投資公司

被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊

民國八十九年十二月三十一日

附表八

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資 公司本期 (損)益	本期認 列之投資 (損)益	備註
			本期期末	上期期末	股數 (仟股)	比率 %	帳面金額			
<b>台灣積體電路公司</b>										
台灣積體電路製造 (北美)公司	U.S.A, California, San Jose	市場行銷及 工程支援	\$333,718	\$25,588	11,000	100	\$666,924	\$131,107	\$131,107	子公司
台灣積體電路製造 (歐洲)公司	The Netherlands, Amsterdam	市場行銷及 工程支援	2,960	2,960	-	100	9,594	(14,668)	(14,668)	子公司
台灣積體電路製造 (日本)公司	Japan, Yokohama	市場行銷及 工程支援	35,142	7,440	2	100	37,803	2,261	2,261	子公司
世界先進積體電路公司	新竹市	積體電路設 計製造	6,503,640	6,503,640	556,133	25	5,615,075	2,573,745	597,812	被投資公司
台積國際投資有限公司	British Virgin Islands, Tortola	投資業務	24,159,958	13,750,468	779,788	100	23,678,522	138,589	138,589	子公司
柏成投資有限公司	台北市	投資業務	100,000	100,000	-	25	136,984	135,869	33,967	被投資公司
啓信投資有限公司	台北市	投資業務	100,000	100,000	-	25	139,000	143,951	35,988	被投資公司
功成投資有限公司	台北市	投資業務	100,000	100,000	-	25	158,752	223,915	55,979	被投資公司
積成投資有限公司	台北市	投資業務	100,000	100,000	-	25	130,794	112,094	28,023	被投資公司
欣瑞投資有限公司	台北市	投資業務	100,000	100,000	-	25	128,100	100,391	25,098	被投資公司
承暉投資有限公司	台北市	投資業務	100,000	100,000	-	25	138,200	140,781	35,195	被投資公司
TSMC Partners.	British Virgin Islands. Tortola	投資業務	10,350	10,350	300	100	535,162	494,966	494,966	子公司
Systems on Silicon Manu- facturing Company (SSMC )	Singapore	半導體晶 圓製造	1,432,482	442,792	90	32	935,870	(1,480,190)	(473,661)	被投資公司

## 九、 合併財務報表暨會計師查核報告書

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國八十九年及八十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國八十九年及八十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國八十九年度及八十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註二所述，台灣積體電路製造股份有限公司民國八十九年六月三十日合併德基半導體股份有限公司及世大積體電路股份有限公司，導致合併報表編製主體變動，因而重編台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國八十八年度之合併財務報表，俾使兩年度之報表主體一致。

此致

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師 黃樹傑

黃樹傑



台灣省會計師公會會員證第1723號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(83)台財證(六)第12213號

會計師 魏永篤

魏永篤



台灣省會計師公會會員證第705號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(72)台財證(一)第2583號

中華民國九十年一月二十九日

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國八十九年及八十八年十二月三十一日（附註二）

單位：除每股面額外，為新台幣仟元

資產	八十九年底		八十八年底	
	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金（附註二及四）	\$38,840,217	11	\$29,517,682	13
質押定存（附註二十）	-	-	3,161,000	1
短期投資（附註二、五及二十）	2,351,560	1	965,397	-
應收關係人款項（附註十八）	948,726	-	340,938	-
應收票據	125,175	-	210,980	-
應收帳款	30,335,314	8	14,240,095	6
備抵呆帳（附註二）	(946,734)	-	(422,202)	-
備抵退貨及折讓（附註二）	(2,458,323)	(1)	(706,886)	-
存貨（附註二及六）	12,785,723	3	7,104,042	3
遞延所得稅資產（附註二及十七）	8,178,016	2	2,616,618	1
預付費用及其他流動資產（附註十八、十九及二十二）	3,034,624	1	2,629,973	1
流動資產合計	<u>93,194,298</u>	<u>25</u>	<u>59,657,637</u>	<u>25</u>
長期投資（附註二、七及二十三）	<u>9,814,342</u>	<u>3</u>	<u>16,164,676</u>	<u>7</u>
<b>固定資產（附註二、八、十七、十八及二十）</b>				
成本				
土地及土地改良	829,239	-	783,809	-
建築物	53,874,708	15	33,929,572	14
機器設備	241,995,862	65	148,580,088	63
辦公設備	4,865,610	1	3,637,083	2
	<u>301,565,419</u>	<u>81</u>	<u>186,930,552</u>	<u>79</u>
累積折舊	(103,884,879)	(28)	(65,409,688)	(28)
預付款項及未完工程	47,067,352	13	28,539,044	13
固定資產淨額	<u>244,747,892</u>	<u>66</u>	<u>150,059,908</u>	<u>64</u>
合併借項（附註二）	<u>11,530,973</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>其他資產</b>				
出租資產（附註二）	625,647	-	-	-
遞延借項一淨額（附註二及九）	3,335,665	1	2,380,792	1
遞延所得稅資產（附註二及十七）	6,629,805	2	7,006,697	3
存出保證金	979,067	-	59,371	-
質押定存（附註二十）	-	-	693	-
其他	28,290	-	105,740	-
其他資產合計	<u>11,598,474</u>	<u>3</u>	<u>9,553,293</u>	<u>4</u>
資產總計	<u>\$370,885,979</u>	<u>100</u>	<u>\$235,435,514</u>	<u>100</u>

負債及股東權益	八十九年底		八十八年底	
	金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>				
短期借款（附註十及二十）	\$3,833,841	1	\$5,026,631	2
應付商業本票（附註十一）	-	-	94,797	-
應付關係人款項（附註十八）	2,606,339	1	1,036,348	1
應付帳款	8,507,827	2	3,273,894	1
應付工程及設備款	25,550,273	7	12,593,712	5
應付所得稅（附註二及十七）	3,298	-	155,127	-
一年內到期之長期負債（附註十二及二十）	51,055	-	1,001	-
應計費用及其他流動負債（附註二十二）	6,872,359	2	4,208,917	2
<b>流動負債合計</b>	<b>47,424,992</b>	<b>13</b>	<b>26,390,427</b>	<b>11</b>
<b>長期負債</b>				
長期借款（附註十三及二十）	23,339,367	6	22,743,462	10
應付公司債（附註二及十四）	29,000,000	8	20,000,000	8
<b>長期負債合計</b>	<b>52,339,367</b>	<b>14</b>	<b>42,743,462</b>	<b>18</b>
<b>其他負債</b>				
存入保證金	7,086,379	2	5,185,362	2
應計退休金負債（附註二及十六）	1,511,277	-	1,013,840	1
未實現售後租回利益（附註二）	434,183	-	-	-
應付租賃款（附註十二）	3,316	-	4,368	-
其他	11,040	-	3,370	-
<b>其他負債合計</b>	<b>9,046,195</b>	<b>2</b>	<b>6,206,940</b>	<b>3</b>
少數股權（附註二）	321,726	-	7,524,168	3
<b>負債合計</b>	<b>109,132,280</b>	<b>29</b>	<b>82,864,997</b>	<b>35</b>
<b>股東權益（附註二及十五）</b>				
股本－每股面額10元，額定一八九年17,800,000仟股， 八十八年9,100,000仟股				
普通股發行一八九年11,689,365仟股， 八十八年8,520,882仟股	116,893,646	32	85,208,817	36
特別股發行1,300,000仟股	13,000,000	3	-	-
預收股本	-	-	13,118,025	5
資本公積	55,285,821	15	23,951,411	10
法定公積	10,689,323	3	8,258,359	4
特別盈餘公積	1,091,003	-	-	-
未分配盈餘	65,143,847	18	23,124,011	10
長期投資未實現跌價損失	(71,564)	-	-	-
累積換算調整數	(278,377)	-	(1,090,106)	-
<b>股東權益合計</b>	<b>261,753,699</b>	<b>71</b>	<b>152,570,517</b>	<b>65</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$370,885,979</b>	<b>100</b>	<b>\$235,435,514</b>	<b>100</b>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。（參閱勤業會計師事務所民國九十年一月二十九日查核報告）

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司  
合併損益表  
民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日（附註二）

單位：除合併每股盈餘外，為新台幣仟元

	八十九年度		八十八年度	
	金額	%	金額	%
銷貨收入總額（附註二、十七及二十三）	\$169,192,312		\$77,298,726	
銷貨退回及折讓	(2,994,708)		(993,624)	
銷貨收入淨額	166,197,604	100	76,305,102	100
銷貨成本（附註十八）	89,681,764	54	46,237,403	61
銷貨毛利	76,515,840	46	30,067,699	39
營業費用（附註二十三）				
管理費用（附註十八）	8,807,156	5	2,845,299	4
行銷費用	1,282,499	1	1,861,621	2
研究發展費用	5,131,497	3	3,090,790	4
合計	15,221,152	9	7,797,710	10
營業利益	61,294,688	37	22,269,989	29
營業外收入（附註二十三）				
利息收入	1,679,736	1	1,114,530	2
保險理賠收入	1,623,832	1	184,607	-
處分短期投資淨益	1,060,919	1	48,575	-
兌換淨益（附註二及二十二）	828,025	-	-	-
權利金收入（附註二及二十二）	640,442	-	63,809	-
技術服務收入（附註十八）	138,514	-	-	-
處分固定資產利益	62,921	-	4,310	-
處分長期投資利益	15,144	-	67,772	-
迴轉備抵短期投資損失	688	-	140,137	-
其他收入	177,715	-	58,587	-
合計	6,227,936	3	1,682,327	2
營業外費用（附註二十三）				
利息費用（附註二、八、十八及二十二）	2,717,035	2	2,417,021	3
按權益法認列之投資淨損（附註二及七）	187,179	-	288,500	1
權利金費用（附註二及二十二）	108,133	-	86,746	-
處分固定資產損失	114,768	-	164,384	-
公司債發行成本	32,658	-	114,839	-
長期投資永久性跌價損失	-	-	31,568	-
兌換淨損（附註二）	-	-	119,141	-
其他損失	461,327	-	101,803	-
合計	3,621,100	2	3,324,002	4
稅前利益（附註二十三）	63,901,524	38	20,628,314	27
所得稅利益（附註二及十七）	1,167,884	1	2,382,782	3
綜合純益	65,069,408	39	23,011,096	30
少數股權損失（附註二及二十三）	36,786	-	515,898	1
合併純益	\$65,106,194	39	\$23,526,994	31
合併每股盈餘				
按普通股加權平均發行股數八十九年11,400,882仟股及 八十八年8,349,682仟股計算	\$5.71		\$2.82	
按追溯調整後10,656,033仟股計算				\$2.21

後附之附註係本合併財務報表之一部分。（參閱勤業會計師事務所民國九十年一月二十九日查核報告）

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日（附註二）

單位：新台幣仟元

	發行股本										資本公積（附註二）				保留盈餘（附註十五）				長期投資未實現盈損			累積換算		合計
	普通股 (仟股)	金額	特別股 (仟股)	金額	預收股本	合併溢額	股票發行溢價	長期投資	債券轉換溢價	處份固定資產利益	捐贈合計	法定公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	失（附註二）	（附註二）	（附註二）	（附註二）	實現盈損	調整數			
八十八年初餘額	6,647,176	\$66,471,760	-	\$-	\$-	\$7,120,000	\$-	\$99,128	\$-	\$65,036	\$55	\$7,284,219	\$6,724,240	\$-	\$16,532,518	\$23,256,758	\$-	(\$727,426)	\$96,285,311					
盈餘分配																								
法定公積																								
員工福利 - 股票	110,457	1,104,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
股票股利 - 23%	1,390,850	13,908,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
現金儲備 - 四月十五日	250,000	2,500,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-		7,500,000				
預收股本	-	-	-	-	-	13,118,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13,118,025				
八十八年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,526,994	23,526,994	-	-	23,526,994				
可轉換公司債權	122,399	1,223,986	-	-	-	-	-	11,289,998	-	-	11,289,998	-	-	-	-	-	-	-		12,513,984				
處分固定資產利益轉列資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
列資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,022	-	4,022	-	-	(4,022)	(4,022)	-	-	-				
認列被投資公司處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	-	246,218	-	-	246,218	-	-	-	(246,218)	(246,218)	-	-	-					
按權益法認列調整被投資公司股權比例變動	-	-	-	-	-	-	126,954	-	-	126,954	-	-	-	-	-	-	-	-		126,954				
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			(362,680)	(362,680)					
八十八年底餘額	8,520,882	85,208,817	-	-	13,118,025	12,120,000	-	472,300	11,289,998	69,058	55	23,951,411	8,258,359	-	23,124,011	31,382,370	-	(1,090,106)	152,570,517					
盈餘分配																								
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430,964	-	(2,430,964)	-	-	-	-	-	-	-				
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,091,003	-	(1,091,003)	-	-	-	-	-	-	-				
員工福利 - 股票	172,121	1,721,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,721,208)	(1,721,208)	-	-	-				
股票股利 - 25.55%	1,959,910	19,599,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,599,103)	(19,599,103)	-	-	-				
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(215,151)	(215,151)	-	-	(215,151)				
資本公積撥充股本 - 2.45%	187,937	1,879,366	-	-	-	-	-	(1,879,366)	-	-	(1,879,366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
現金儲備 - 一月二十八日	300,000	3,000,000	-	-	(13,118,025)	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-		1,881,975				
現金儲備 - 六月八日	115,000	1,150,000	-	-	-	23,172,550	-	-	-	-	23,172,550	-	-	-	-	-	-	-		24,322,550				
合併發行新股 - 六月三十日 (附註一)	433,515	4,335,152	-	-	-	(1,790,871)	-	-	-	-	(1,790,871)	-	-	-	1,803,168	1,803,168	-	(897)	4,346,552					
發行特別股 - 十一月二十九日	-	-	1,300,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13,000,000				
八十九年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,106,194	65,106,194	-	-	65,106,194					
處分固定資產利益轉列資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,178	-	58,178	-	(58,178)	(58,178)	-	-	-					
資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,502	-	5,502	-	(5,502)	(5,502)	-	-	-					
認列被投資公司處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
按權益法認列調整被投資公司股權比例變動	-	-	-	-	-	-	-	(231,583)	-	-	(231,583)	-	-	-	231,583	231,583	-	-	-					
提列子公司長期投資未實現盈虧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,564)	(71,564)	-	-	(71,564)				
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			812,626	812,626					
八十九年底餘額	11,689,365	\$116,893,646	1,300,000	\$13,000,000	-	\$- \$32,329,129	\$23,172,550	\$246,219	\$9,410,632	\$127,236	\$55	\$55,285,821	\$10,689,323	\$1,091,003	\$65,143,847	\$76,924,173	(\$71,564)	(\$278,377)	\$261,753,699					

後附之財務報表為本財務報表之一部分。（參閱勤業會計師事務所民國九十年一月二十九日查核報告）

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日（附註二）

單位：新台幣仟元

八十九年度 八十八年度

	八十九年度	八十八年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
純益	<b>\$65,106,194</b>	\$23,526,994
折舊及攤銷	<b>41,446,137</b>	25,197,866
遞延所得稅	<b>(956,118)</b>	(2,481,758)
按權益法認列之投資淨損	<b>187,179</b>	288,500
處分長期投資利益	<b>(15,144)</b>	(67,772)
處分固定資產淨損	<b>51,847</b>	160,427
應付利息補償金	-	585,614
長期投資永久性跌價損失	-	31,568
提列退休金費用	<b>370,276</b>	260,425
備抵呆帳	<b>524,532</b>	148,603
備抵退貨及折讓	<b>1,679,309</b>	402,068
固定資產數轉列費用	-	39,130
營業資產及負債之淨變動		
短期投資	<b>(1,373,616)</b>	5,049,694
應收遠匯款	<b>(113,730)</b>	-
應收關係人款項	<b>(737,105)</b>	(273,194)
應收票據	<b>38,959</b>	(176,112)
應收帳款	<b>(15,467,155)</b>	(6,215,651)
存貨	<b>(4,033,836)</b>	(2,765,251)
預付費用及其他流動資產	<b>351,988</b>	(1,278,128)
應付關係人款項	<b>2,334,247</b>	878,411
應付票據	<b>(4,303)</b>	-
應付帳款	<b>3,174,958</b>	985,875
應付所得稅	<b>(151,828)</b>	(622,297)
應付遠匯款	<b>(987,604)</b>	6,108
應計費用及其他流動負債	<b>2,024,180</b>	2,137,160
少數股權	<b>(36,786)</b>	(515,898)
營業活動之淨現金流入	<b>93,412,581</b>	45,302,382
<b>投資活動之現金流量：</b>		
質押定存減少（增加）	<b>3,161,693</b>	(2,290,000)
受限制使用之專戶存款減少	-	7,255
長期投資增加	<b>(2,107,296)</b>	(10,057,902)
處分長期投資價款	<b>49,376</b>	150,015
購置固定資產	<b>(103,761,905)</b>	(51,459,113)
處分固定資產價款	<b>364,875</b>	413,096
遞延借項增加	<b>(1,793,209)</b>	(1,179,300)
存出保證金（增加）減少	<b>(915,559)</b>	61,416
其他資產減少	<b>77,451</b>	13,470
少數股權減少	<b>(15,386,922)</b>	(1,660,815)
合併德碁世大兩家公司之現金流入	<b>736,594</b>	-
投資活動之淨現金流出	<b>(119,574,902)</b>	(66,001,878)

(接次頁)

(承前頁)

八十九年度 八十八年度

融資活動之現金流量：		
短期借款（減少）增加	(\$8,592,790)	\$2,917,409
應付商業本票減少	(4,241,048)	-
應付短期票券減少	-	(253,445)
公司債增加	9,000,000	9,450,634
長期借款（減少）增加	(2,648,853)	7,997,586
融資發行成本	(118,335)	(63,275)
董事事酬勞	(215,151)	(138,071)
應付租賃款減少	(1,052)	-
存入保證金增加（減少）	2,978,984	(938,463)
其他負債減少	-	(71,951)
發行新股	39,204,525	20,618,025
融資活動之淨現金流入	35,366,280	39,518,449
現金及約當現金淨增加	9,203,959	18,818,953
匯率影響數	118,576	(173,144)
年初現金及約當現金餘額	29,517,682	10,871,873
年底現金及約當現金餘額	\$38,840,217	\$29,517,682
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息（不含資本化利息）	\$4,036,210	\$2,441,840
支付所得稅	\$96,523	\$594,098
不影響現金流量之投資及融資活動：		
匯率影響數	\$1,009,264	(\$66,376)
一年內到期之長期負債	\$51,055	\$1,001
購置固定資產價款	\$113,996,068	\$56,857,625
應付工程及設備款	(10,234,163)	(5,398,512)
支付淨額	\$103,761,905	\$51,459,113
可轉換公司債轉換為股本及資本公積	\$-	\$12,513,984
吸收合併資訊之補充揭露：		
台積公司以發行新股方式吸收合併德碁公司與世大公司，該等公司八十九年六月三十日之資產負債金額表列如下：		
	德碁公司 (公平價值)	世大公司 (帳面價值)
		合計
現金	\$736,594	\$675,810
存貨	1,647,845	1,805,243
其他流動資產	2,308,391	3,150,257
固定資產－淨額	19,846,708	40,512,706
其他資產	7,335,526	5,101,000
流動負債	(16,699,147)	(12,454,686)
長期負債	(2,000,000)	(4,950,000)
其他負債	(654,863)	(23,498)
取得淨資產	12,521,054	33,816,832
因合併而註銷原持有消滅公司股份	(8,173,605)	-
合併發行新股	(4,335,152)	(11,500,000)
資本公積	\$12,297	\$22,316,832
		\$22,329,129

後附之附註係本合併財務報表之一部分。（參閱勤業會計師事務所民國九十年一月二十九日查核報告）

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司  
合併財務報表附註  
(除另予註明者外，金額為新台幣仟元)

(一) 公司沿革

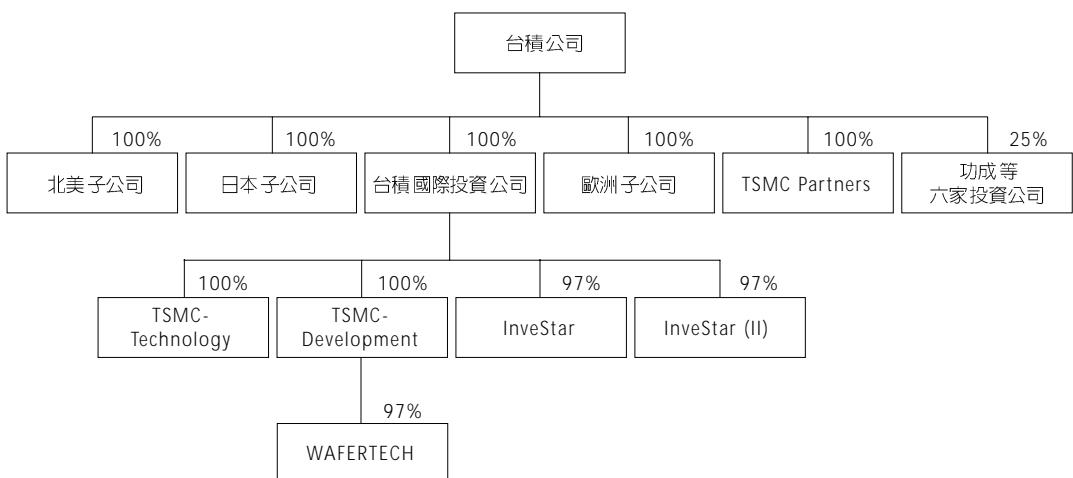
台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司）係由行政院開發基金管理委員會及荷蘭商飛利浦電子股份有限公司（飛利浦公司）等共同投資設立，主要業務為有關積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計，暨光罩之製造及設計服務。台積公司股票於台灣證券交易所上市。八十六年十月八日起，台積公司部分已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。

台積公司以八十九年六月三十日為合併基準日，採取吸收合併方式合併德碁半導體公司（德碁公司）及世大積體電路公司（世大公司），以台積公司為存續公司，德碁公司及世大公司則分別因合併而解散。合併股份換發比例約三點九股德碁公司股份換發一股台積公司股份及二股世大公司股份換發一股台積公司股份，合計台積公司因此合併案而增發1,583,515 仟股之普通股，其權利義務與台積公司原已發行股份相同。

德碁公司係於七九年三月三十一日核准設立，並於八十一年一月開始營業，主要業務為動態隨機存取記憶體及其他種類積體電路之研發、設計、製造、封裝、測試及銷售等服務。

世大公司係於八十五年三月六日核准設立，於八十七年十二月一日開始主要營業活動。主要營業項目為積體電路製造代工服務。

台積公司之子公司包括於英屬維京群島設立之台積國際投資公司、台灣積體電路製造（北美）公司（北美子公司）、台灣積體電路製造（歐洲）公司（歐洲子公司）、台灣積體電路製造（日本）公司（日本子公司）、TSMC Partners 及功成、積成、啓信、欣瑞、承暉、柏成等六家投資公司。截至八十九年底止，台積公司與子公司之投資關係及持股比例如下列圖表：



北美、歐洲及日本子公司主要係從事市場暨技術服務業務，TSMC Partners 及功成等六家公司主要係從事一般投資業務，台積國際投資公司及其子公司則以從事經營半導體設計、製造及相關業務之投資。WAFERTECH,LLC 係晶圓代工廠。

(二) 重要會計政策之彙總說明

合併財務報表編製準則

母公司直接或透過子公司間接持有被投資公司普通股股權百分之五十以上者，其財務報表予以合併。編製合併財務報表時母子公公司間重大之交易及其餘額業已銷除。

八十九年度合併財務報表個體包括台積公司、北美子公司、歐洲子公司、日本子公司、TSMC Partners、功成、積成、啓信、欣瑞、承暉、柏成等六家投資公司暨台積國際投資公司及其子公司InveStar Semiconductor Development Fund, Inc.、

InveStar Semiconductor Development Fund (II), Inc. (係八十九年度新增投資)、TSMC Development Inc. (包括 WAFERTECH, LLC) 及 TSMC Technology Inc.。另如附註一所述，台積公司於民國八十九年六月三十日合併德基及世大兩家公司，合併德基公司係採購買法；惟因合併世大公司係採權益結合法，因此導致合併報表編製主體變動，而故重編以台積公司及其子公司與世大公司為編製主體之民國八十八年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國八十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表。

本合併財務報表對其他公司持有 WAFERTECH, LLC 之 3% 股份（八十八年度 32% 股份）及持有 InveStar Semiconductor Development Fund, Inc.、InveStar Semiconductor Development Fund (II), Inc. 之 3% 股份（八十九年度），列於少數股權及少數股權損失項下。

#### 約當現金

約當現金係指自投資日起三個月內到期之附買回條件政府公債、商業本票。

#### 短期投資

短期投資係按成本與市價孰低計價。出售成本則採個別辨認。

#### 備抵呆帳

係按應收款項收回之可能性評估認列。

#### 銷貨收入及備抵退貨及折讓

銷貨收入係於貨物移轉時認列，備抵退貨及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售年度列為銷貨之減項，相關銷貨成本則列為銷貨成本之減項。

#### 存貨

存貨係以成本與市價孰低計價。存貨平時按標準成本計價，結帳日時再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。

#### 長期投資

具有重大影響力之長期股權投資，係採用權益法計價；被投資公司發生純益（或純損）時，認列投資損益。非按原持股比例認購採權益法計價之被投資公司增發之新股，致使投資比例發生變動，因而使所投資之股權淨值發生增減者，其增減數調整「資本公積」及「長期投資」。被投資公司之虧損如係以投資後產生之資產重估增值準備以外之資本公積彌補者，依持有股份比例計算應負擔金額，調整「資本公積」及「保留盈餘」。

不具有重大影響力之長期股權投資，係按成本法計價。被投資公司發放現金股利時，除投資當年度應貸記長期投資外，列為當年度股利收入。取得被投資公司發放之股票股利時，僅註記增加股數，不增加投資帳面價值，亦不認列投資收益。

長期投資為上市或上櫃公司股票者，則按成本與市價孰低評價，當投資帳面金額超過該股票市價時，則改按股票市價計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失列為股東權益之減項，若嗣後股票市價回升時，則應於已提列金額內予以沖回。投資於未上市公司之股票，當投資之價值確已減損且回復之希望甚小時，則調整其帳面價值，認列投資損失。

其他長期投資係投資海外基金，按成本與基金淨值孰低評價。當投資帳面金額超過該基金淨值時，則改按基金淨值計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失列為股東權益之減項，若嗣後基金淨值回升時，則應於已提列金額內予以沖回。

可轉換債券及認購權證按成本計價。

股票出售時，其成本係按加權平均法計算。

採權益法計價時，被投資公司之當期損益中，若有出售固定資產盈餘者，則按減除所得稅後之淨額，於認列投資損益年度，按持股比例轉列資本公積，嗣後出售時，再按出售比例轉回保留盈餘。若被投資公司長期投資按成本與市價孰低評價所產生之長期投資未實現跌價損失，則按持股比例認列，並於資產負債表上列為股東權益之減項。

與按權益法計價之被投資公司間順流交易所產生之未實現利益按持股比例予以銷除；若對被投資公司具有控制能力者，則全數予以銷除，俟實現始認列利益。

與按權益法計價之被投資公司間逆流交易所產生之未實現利益，皆按投資公司之持股比例予以銷除。

#### **固定資產或出租資產**

固定資產及出租資產係按成本減累積折舊計價。重大之增添、更新及改良列為資本支出，修理及維護支出，則列為當年度費用。固定資產於購建期間支出款項所負擔之利息予以資本化。租賃資產以最低租金給付額之現值總額及租賃資產在租賃開始日之公平市價孰低入帳，應付資本租賃款則按利息法在租賃期間分期攤銷。

折舊係以直線法按下列耐用年數計提：建築物，五至五十年；機器設備，五至十年；辦公設備，三至七年。

固定資產報廢或出售時，其成本及相關之累積折舊均自帳上予以減除，出售及處分損益列為當年度損益。出售利益扣除有關所得稅後再於當年底轉列資本公積。

#### **合併借項**

合併借項包括原始投資成本與取得股權時被投資公司股權淨值間之差額及因併購所產生之商譽，採直線法分五至十五年平均攤銷。

#### **遞延借項**

遞延借項主要係電腦軟體制度設計費用、公司債發行成本、應付短期票券發行成本及技術權利金及技術股作價等，分別按三、五年、票券發行期間攤銷及合約或經濟效益年限攤銷。

#### **員工退休金**

按精算結果認列退休金費用，未認列過渡性淨給付義務及未認列退休金損益皆按二十五年攤提。

#### **未實現售後租回利益**

固定資產出售後再自行租回時，則出售固定資產損益予以遞延，列為未實現售後租回利益，營業租賃按租賃期間，逐期攤銷為租金費用調整項目；資本租賃則按估計之使用年數或租賃期間，逐期攤銷為折舊費用調整項目。

#### **所得稅**

所得稅之會計處理係作跨期間之所得稅分攤，即將可減除暫時性差異、未使用以前年度虧損扣抵及投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列相關備抵評價金額；而應課稅暫時性差異所產生之影響數認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期回轉期間之長短劃分為流動或非流動項目。

以前年度應付所得稅之調整，包含於當年度所得稅中。

未分配盈餘加徵百分之十之所得稅，列為股東會決議年度費用。

#### **衍生性金融商品交易**

為規避外幣淨資產或淨負債匯率風險之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率衡量入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間攤銷，應收或應付遠期外匯年底餘額，再按年底之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

非以交易為目的之利率交換合約，於簽約日因無本金移轉，僅作備忘記錄，於約定結算日及資產負債表日就合約利率與市場實際利率所計得之應收或應付金額，作為被避險資產或負債有關之利息收入或利息費用之調整。

非以交易為目的之外幣選擇權合約，於訂約日不認列資產或負債，因實際交割所產生之兌換差額，則列為當期損益。購買（或出售）外幣選擇權時，所支付（或取得）之權利金於合約期間平均攤銷，列為當期損益。

#### **以外幣為準之交易事項**

非衍生性金融商品之外幣交易，係按交易當日匯率折算之新台幣金額入帳。外幣現金實際兌換成新台幣或外幣應收應付款以新台幣收付結清時，因適用不同匯率所產生之損失或盈益，列為兌換或結清年度之損益。外幣現金、資產及負債之年底餘額，按年底時之匯率予以換算，因而產生之兌換損益，則列為當期損益。

#### **外幣財務報表之換算**

國外子公司之財務報表換算為新台幣表達時，資產及負債科目按資產負債表日匯率換算；股東權益按歷史匯率換算；損益科目則按當年度加權平均匯率換算。換算所產生之兌換差額，則列為股東權益項下之累積換算調整數。

#### **科目重分類**

八十八年度合併財務報表若干科目經予重新分類，俾配合八十九年度合併財務報表之表達。

### 合併

台積公司合併德碁公司之會計處理係依照財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理」，自八十九年七月一日起將其損益科目併入台積公司；另合併世大公司之會計處理則係依照「權益結合法」，其八十九年度之損益科目全數併入台積公司。

另假設台積公司於八十八年初即吸收合併德碁公司，其八九年及八十八年度之合併經營結果之擬制性資訊如下：

	八十九年度	八十八年度
銷貨收入淨額	\$170,132,350	\$86,130,100
純益	65,050,836	17,084,089
每股盈餘 按加權平均發行股數－八九年11,616,455 仟股及八八年11,089,548 仟股計算	5.60	1.54
於合併基準日八九年六月三十日前德碁公司資訊：		
	八十九年度 上半年	八十八年度
銷貨收入淨額	\$3,934,746	\$10,655,995
純損	(55,358)	
(6,127,604)		

### (三) 母子公司間業已銷除之重大交易事項

公司名稱	沖銷科目	金額	交易對象
台積公司	應付關係人款項	\$166,063	北美子公司
		66,343	歐洲子公司
		16,165	日本子公司
		1,487,181	WAFERTECH, LLC
		4,487	TSMC-Technology
	應收關係人款項	20,361	WAFERTECH, LLC
		25,728	TSMC-Technology
	銷貨收入	370,762	世大公司
		30,816	WAFERTECH, LLC
	進貨	13,296,633	WAFERTECH, LLC
	管理費用	14,095	TSMC-Technology
	行銷費用（佣金）	994,686	北美子公司
	行銷費用（服務費）	118,852	北美子公司
	行銷費用（佣金）	143,461	歐洲子公司
	行銷費用（佣金）	165,087	日本子公司
	遞延收入	5,837	WAFERTECH, LLC
世大公司	應收帳款	1,670	德碁公司
	應付帳款	768,677	德碁公司
台積國際投資公司	應收利息	128,594	TSMC-Technology
	應收票據	330,790	TSMC-Technology
	利息收入	24,181	TSMC-Technology
TSMC Partners	遞延收入	10,791,704	台積國際投資公司
	權利金收入	491,733	台積國際投資公司
	應收票據	11,313,018	台積國際投資公司

(接次頁)

(承前頁)			
TSMC-Technology	遞延收入	\$40,962	WAFERTECH, LLC
	權利金收入	13,323	WAFERTECH, LLC
	銷貨收入	63,727	WAFERTECH, LLC
	應收款項	17,669	WAFERTECH, LLC

(四) 現金及約當現金

	八十九年底	八十八年底
現金及銀行存款	<u>\$38,229,510</u>	\$29,442,697
附買回條件政府公債	<u>610,707</u>	-
商業本票	-	74,985
	<u><u>\$38,840,217</u></u>	<u><u>\$29,517,682</u></u>

(五) 短期投資

	八十九年底	八十八年底
上市上櫃公司股票	<u>\$1,502,098</u>	\$927,856
開放型基金	<u>959,561</u>	37,541
	<u><u>2,461,659</u></u>	<u><u>965,397</u></u>
備抵跌價損失	<u>(110,099)</u>	-
	<u><u>\$2,351,560</u></u>	<u><u>\$965,397</u></u>

(六) 存貨

	八十九年底	八十八年底
製成品	<u>\$1,762,287</u>	\$905,626
在製品	<u>9,455,492</u>	5,924,555
原料	<u>770,884</u>	632,732
物料及零件	<u>1,364,686</u>	969,797
	<u><u>13,353,349</u></u>	<u><u>8,432,710</u></u>
備抵存貨損失	<u>(567,626)</u>	<u>(1,328,668)</u>
	<u><u>\$12,785,723</u></u>	<u><u>\$7,104,042</u></u>

(七) 長期投資

	八十九年底		八十八年底	
	帳列金額	持股比例	帳列金額	持股比例
	%	%		
股票				
按權益法計價				
世界先進積體電路公司	\$5,615,075	25	\$5,010,897	25
德碁半導體公司	-	-	3,630,193	32

(接次頁)

(承前頁)

SYSTEMS ON SILICON MANUFACTURING  
COMPANY PTE LTD. (SSMC)

<u>\$935,870</u>	<u>32</u>	<u>\$360,177</u>	<u>32</u>
<u>6,550,945</u>		<u>9,001,267</u>	

按成本法計價

普通股

台灣光罩公司 (上市公司)	<u>32,129</u>	<u>2</u>	32,129	2
台宏半導體公司	<u>500,000</u>	<u>19</u>	500,000	19
聯亞氣體工業公司	<u>146,250</u>	<u>10</u>	146,250	11
台灣信越半導體公司	<u>105,000</u>	<u>7</u>	105,000	7
普實創業投資公司	<u>50,000</u>	<u>4</u>	50,000	4
宏通創業投資公司	<u>120,000</u>	<u>10</u>	80,000	10
3Dfx Interactive	<u>9,826</u>		-	-
Programmable Microelectronics	<u>49,619</u>	<u>4</u>	-	-
Capella Microsystems	<u>345</u>		-	-
Equator Technologies	<u>2,978</u>		-	-
Global Test	<u>183,896</u>	<u>10</u>	71,613	5
ChipStrate Technology	<u>70,854</u>	<u>9</u>	32,927	2
Ritch Technology	<u>10,338</u>	<u>9</u>	7,407	1
Scenix Semiconductor	<u>5,697</u>	<u>2</u>	5,407	-
APE 富鼎先進	<u>50,222</u>	<u>6</u>	-	-
	<u>1,337,154</u>		<u>1,030,733</u>	

特別股

德碁半導體公司	-	-	4,854,742	28
Programmable Microelectronics	-	-	47,092	3
Marvell Technology	-	-	139,055	10
Lara Technology	-	-	83,197	6
Integrated Memory Logic	<u>59,845</u>	<u>10</u>	23,546	2
Divio	<u>16,540</u>	<u>4</u>	15,698	1
Integrated Micromachines	-	-	4,709	-
SiRF Technology	<u>44,105</u>	<u>1</u>	41,860	3
Rise Technology	<u>49,619</u>	<u>2</u>	47,092	3
Capella Microsystems	<u>42,949</u>	<u>8</u>	12,040	1
Sensory	<u>41,349</u>	<u>6</u>	39,244	3
Flow Wise Networks	-	-	15,697	1
Equator Technologies	<u>93,908</u>	<u>2</u>	42,011	3
LightSpeed Semiconductor	<u>101,368</u>	<u>6</u>	68,562	5
Centillium Technology	-	-	23,546	2
Scenix Semiconductor	<u>45,023</u>	<u>2</u>	66,277	5
RapidStream	<u>69,708</u>	<u>6</u>	32,965	2
Tropian, Inc. (Premier R.F.)	<u>77,209</u>	<u>5</u>	31,395	2
Krypton Isolation	-	-	39,244	3
Pico Turbo	<u>41,349</u>	<u>9</u>	39,244	3
Sonics	<u>116,752</u>	<u>7</u>	31,395	2
3Dfx Interactive	-	-	9,326	-
NanoAmp Solutions	<u>61,281</u>	<u>3</u>	26,537	2
T-Span System	<u>45,829</u>	<u>3</u>	15,698	1

(接次頁)

(承前頁)

Memsic	\$82,689	24	\$47,088	3
Monolithic Power System	66,158	17	62,790	4
Formfactor	66,158	1	62,790	4
Reflectivity	66,158	6	62,790	4
Signia	49,619	22	47,090	3
Lara Networks, Inc.	75,151	7	-	-
Empower Tel Networks	169,634	7	-	-
Match Lab	49,619	11	-	-
HINT Corporation	33,079	5	-	-
Creosys	49,619	8	-	-
Incentia Design Systems	16,539	2	-	-
Seagull Semiconductor	41,349	14	-	-
Oepic	24,809	-	-	-
FabCentric	8,270	-	-	-
	<u>1,705,685</u>		<u>6,032,720</u>	
<b>可轉換債券</b>				
Integrated Memory Logic	-	-	31,395	2
Sonics	-	-	23,546	2
Rise	9,924	-	9,419	1
FabCentric	8,270	-	-	-
Signia Technologies	16,540	-	-	-
Advanced Analogic Technology	41,349	-	-	-
	<u>76,083</u>		<u>64,360</u>	
<b>基金</b>				
Crimson Asia Capital	64,547	-	34,534	-
Horizon Ventures	93,304	-	31,744	-
	<u>157,851</u>		<u>66,278</u>	
<b>認購權證</b>				
Flow Wise Networks	-	-	6	-
	<u>9,827,718</u>		<u>16,195,364</u>	
<b>累積換算調整數</b>				
	(13,376)		-	-
<b>備抵跌價損失</b>				
	-		(30,688)	
	<u>\$9,814,342</u>		<u>\$16,164,676</u>	

八十九及八十八年度按權益法計價之長期投資（損）益金額，係按同期間經會計師查核之財務報表認列如下：

	八十九年度	八十八年度
世界先進積體電路公司	\$597,812	(\$527,823)
SSMC	(473,661)	(75,978)
德碁公司	<u>(311,330)</u>	<u>315,301</u>
	<u>(\$187,179)</u>	<u>(\$288,500)</u>

長期投資有關股票市價及淨值之資料如下：

	八十九年底	八十八年底
上市上櫃公司股票市價	<b>\$8,729,639</b>	\$19,762,968
未上市上櫃按普通股持股比例之淨值	<b>5,466,227</b>	8,351,897
基金淨值	<b>157,851</b>	66,278

截至八十九年底尚未執行之認股權證權利之相關資訊如下：

股票種類	可轉換股數	每股轉換價格（美金元）	可轉換期間
SiRF Technology 特別股	5,556	6	87.01.16-92.01.16
Sonics 特別股	450,000	1	87.09.25-90.09.27
Sonics 特別股	30,000	1.5	88.11.30-91.11.29
Sonics 特別股	30,000	1.5	89.03.14-91.03.14
Ubicom 特別股	45,490	2	87.12.23-92.12.23
Formfactor 特別股	66,666	7.5	88.07.30-93.07.30
Integrated Memory Logics 特別股	746,268	0.67	88.12.20-93.12.20
Integrated Memory Logics 特別股	333,333	1.5	88.12.20-93.12.20
Match Lab 特別股	625,000	0.8	89.01.14-94.01.14
Empower Tel Networks 普通股	317,307	1.625	88.01.29-98.01.29
Ubicom 普通股	90,980	0.2	88.03.22-92.12.23
Capella Microsystems 普通股	500,000	0.25	-
HINT 普通股	15,000	0.25	89.03.17-94.03.17

#### (八) 固定資產

累積折舊如下：

	八十九年底	八十八年底
土地改良	<b>\$64,006</b>	\$33,691
建築物	<b>10,692,112</b>	8,131,392
機器設備	<b>90,956,200</b>	55,576,499
辦公設備	<b>2,172,561</b>	1,668,106
	<b>\$103,884,879</b>	<b>\$65,409,688</b>

截至八十九年底止，擴建廠房及設備計畫如下：

擴廠計劃名稱	預計投資金額	累積支出金額	預訂或實際生產年月
第六廠	\$76,889,000	\$67,565,100	89.03
第七廠	22,540,400	11,121,100	90.03
第八廠	28,314,300	15,217,800	90.03
第十二廠－第一期	38,280,800	21,372,000	90.11
第十四廠－第一期	9,711,000	7,946,600	91.05

八十九及八十八年度利息資本化金額分別為541,078 仟元及845,246 仟元。

(九) 滯延借項 - 淨額

	八十九年底	八十八年底
技術權利金	\$1,442,292	\$1,636,596
電腦軟體設計費	1,420,635	625,306
技術股作價	157,500	-
公司債發行費用	142,881	37,238
專利權	-	18,105
其他	172,357	63,547
	<u>\$3,335,665</u>	<u>\$2,380,792</u>

(十) 短期借款

	八十九年底	八十八年底
新台幣銀行借款：		
抵押擔保借款（八十九年—九十年十月到期，年利率5.8%：		
八十八年—八十九年六月前到期，年利率0.75%~7.39%）	\$329,375	\$2,037,629
信用借款（八九年六月前到期，年利率0.75%~7.39%）	-	2,989,002
美金銀行借款：		
抵押及信用借款美金105,942仟元，九十年十二月陸續到期，		
年利率7.53%~9.25%	<u>3,504,466</u>	-
	<u>\$3,833,841</u>	<u>\$5,026,631</u>

截至八十九年底止，尚未使用之短期借款額度為470,625仟元及美金41,000仟元。

(十一) 應付商業本票

	八十八年底
八十九年三月前到期，年利率4.40%~5.51%	\$95,000
折價	(203)
	<u>\$94,797</u>

(十二) 應付租賃款

	八十九年底	八十八年底
九十年六月至九十二年底陸續到期	\$54,371	\$5,369
一年內到期部分	(51,055)	(1,001)
	<u>\$3,316</u>	<u>\$4,368</u>

### (十三) 長期借款

八十九年底

八十八年底

美金銀行借款：

抵押及信用借款—八十九年為美金705,564仟元：

八十八年為美金192,500仟元，九十四年三月前還清，

年利率八九年為6.91%~7.663%；八十八年為6.76%~6.83%

\$23,339,367 \$12,952,462

新台幣銀行借款：

中長期貸款—自九十年三月起陸續分期償還，

年利率為6.68~7.21%（已於八九年提前償還）

9,791,000

\$23,339,367 \$22,743,462

截至八十九年底止，尚未使用之長期借款額度為美金62,436仟元。

### (十四) 應付公司債

台積公司於八十七年三月四日發行國內第一次無擔保普通公司債，發行總額4,000,000仟元，票面年利率7.71%，每半年付息一次，至九十二年三月四日到期一次償還。

台積公司分別於八十七年十一月十八日至十二月一日間分次發行國內第二次無擔保普通公司債，面額總計6,000,000仟元，票面利率皆為7.12%，每年付息一次，分別於九十二年十一月底前到期，到期一次償還，債券持有人得於本公司債發行日後屆滿第二年及第三年之日前三十日，要求台積公司於本公司債屆滿第二年或第三年之日，以債券面額加計當期應計利息後，行使債券贖回權；台積公司亦可依上述條件行使債券贖回權。台積公司已於八十九年十一月提前贖回第二次無擔保普通公司債。

台積公司於八十八年十月二十一日發行國內第三次無擔保普通公司債，發行總額10,000,000仟元，分為甲、乙兩類，票面利率分別為5.67%及5.95%，均為每年付息一次，分別於九十一年十月二十一日及九十三年十月二十一日到期一次償還。

台積公司於八十九年十二月四日至十五日間分次發行國內第四次無擔保普通公司債，發行總額15,000,000仟元，分為甲、乙兩類。票面利率分別為5.25%及5.36%，均為每年付息一次，分別於九十四年十二月及九十六年十二月到期一次償還。

### (十五) 股東權益

依據公司法之規定，資本公積只能用於彌補虧損或撥充股本。

依據台積公司章程規定，每年度純益於彌補虧損後，應分配如下：

- 1 先提撥百分之十為法定公積；
- 2 次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積；
- 3 次提其餘額百分之一為董事事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利；
- 4 次則優先發放甲種特別股股息，股息訂為年率3.5%，按當年度實際發行日數計算；
- 5 剩餘部分依股東會決議分派之。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認，並於該年度入帳。

台積公司於民國八十九年十一月二十九日發行不得上市之甲種特別股1,300,000仟股，其權利義務如下：

- 1 股息為年率3.5%，累積且優先於普通股分派。
- 2 不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
- 3 對於剩餘財產權之求償權優先於普通股，但以不超過發行金額為限。
- 4 於股東會與普通股股東有相同之表決權。
- 5 發行期限為二年六個月且不得轉換為普通股。屆至期限未收回者，其權利義務得以延續至收回為止。

依公司法之規定，法定公積應繼續提撥至其總額達股本總額為止。法定公積得用以彌補虧損；且當該公積已達實收股本之百分之五十時，亦得以其半數撥充股本。

台積公司分配盈餘時，必須依法令規定就八十六年度（及以前年度）發生之股東權益減項提列特別盈餘公積1,091,003仟元後，方得以分配，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉金額分配盈餘。

台積公司若分配屬於八十六年度（含）以前未分配盈餘時，股東將不獲配股東可扣抵稅額。若分配屬於八十七年度（含）以後未分配盈餘時，除屬非中華民國境內居住者之股東外，其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣抵稅額。

#### (十六) 員工退休金

台積公司及其子公司對正式員工訂有退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休時之平均薪資計算。台積公司及其子公司每月分別按員工薪資總額百分之二提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶。

台積公司及其子公司之合併退休金相關資訊揭露如下：

淨退休金成本為：

	八十九年度	八十八年度
服務成本	\$376,689	\$272,228
利息成本	91,234	80,694
退休基金資產預期報酬	(26,675)	(22,931)
攤銷數	8,300	9,114
淨退休金成本	<u>\$449,548</u>	<u>\$339,105</u>

退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債之調節如下：

	八十九年底	八十八年底
給付義務		
既得給付義務	\$-	\$128
非既得給付義務	763,879	447,148
累積給付義務	763,879	447,276
未來薪資增加之影響數	1,550,009	1,008,650
預計給付義務	2,313,888	1,455,926
退休基金資產公平價值	(661,099)	(390,655)
提撥狀況	1,652,789	1,065,271
未認列前期服務成本	-	-
未認列過渡性淨給付義務	(165,991)	(179,348)
未認列退休金收益	22,737	127,684
補列之退休金負債	-	-
應計退休金負債	<u>\$1,509,535</u>	<u>\$1,013,607</u>

退休金給付義務及計算退休金成本之假設為：

折現率	6.0%	6.5%
未來薪資水準增加率	6.0%	6.0%
退休基金資產預期投資報酬率	6.0%	6.5%

退休金提撥及支付情況

本期提撥	\$95,932	\$83,053
吸收合併轉入	<u>\$173,339</u>	<u>\$-</u>
本期支付	<u>\$1,458</u>	<u>\$3,591</u>

(十七) 所得稅

1 帳列稅前利益按法定稅率計算之所得稅與當期應負擔所得稅費用調節如下：

	八十九年度	八十八年度
稅前利益按法定稅率計算之稅額	(\$12,787,660)	(\$4,889,210)
所得稅調項目之稅額影響數：		
免稅所得	7,770,000	3,434,802
暫時性差異	(49,497)	(221,129)
未分配盈餘加徵	(88,024)	-
當年度應負擔所得稅費用	<u>(\$5,155,181)</u>	<u>(\$1,675,537)</u>

2 所得稅利益構成項目如下：

	八十九年度	八十八年度
當年度應負擔所得稅費用	(\$5,155,181)	(\$1,675,537)
所得稅抵減	5,128,024	1,587,000
本期應付	<u>(27,157)</u>	<u>(88,537)</u>
遞延所得稅資產淨變動		
- 投資抵減	3,146,369	3,798,325
- 暫時性差異	(388,671)	(111,139)
- 其他	(73,559)	-
遞延所得稅備抵評價調整數	(1,678,791)	(1,303,500)
以前年度所得稅調整	189,693	87,633
	<u>\$1,167,884</u>	<u>\$2,382,782</u>

3 遞延所得稅資產（負債）明細如下：

	八十九年底	八十八年底
流動		
投資抵減	\$8,422,000	\$2,329,000
應計負債及其他	56,016	287,618
備抵評價	(300,000)	-
淨額	<u>\$8,178,016</u>	<u>\$2,616,618</u>
非流動		
投資抵減	\$12,591,291	\$8,769,605
虧損扣抵	-	981,149
利息費用	45,008	201,798
遞延收入	46,077	43,753
開辦費	-	65,006
折舊	(857,689)	(305,358)
其他	<u>267,831</u>	<u>(205,699)</u>
備抵評價金額	12,092,518	9,550,254
淨額	<u>(\$5,462,713)</u>	<u>(2,543,557)</u>
	<u>\$6,629,805</u>	<u>\$7,006,697</u>

4 兩稅合一相關資訊：

	八十九年底	八十八年底
可扣抵稅額帳戶餘額		
台積公司	<u>\$5,888</u>	<u>\$1,497</u>
世大公司	<u>\$-</u>	<u>\$2,116</u>

	八十九年底	八十八年底
	(預計)	(實際)
稅額扣抵比率		
台積公司	0.009%	0.006%
世大公司	-	-

由於台積公司得分配予股東之可扣抵稅額，應以股利盈餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為計算基礎，因是八十九年底預計盈餘分配之稅額扣抵比率可能會因依所得稅法規定預計可能產生之各項可扣抵稅額與實際不同而須調整。

八十九年底及八十八年底中屬於八十六年度（含）以前之未分配盈餘分別為4,827仟元和799,298仟元。

八十九年底及八十八年底台積公司用以計算遞延所得稅之有效稅率約7.54%及5.9%，子公司約32%~54%及32%~40%，世大公司八十八年底為20%。

截至八十九年底止，未使用之機器設備及研究發展費用投資抵減，得用以抵減以後年度應納稅額如下：

到期年度	投資抵減
九十	\$4,015,461
九十一	4,800,268
九十二	5,738,563
九十三	6,458,999
	\$21,013,291

截至八十九年底止，台積公司各次增資擴展可享受四年免稅如下：

增資擴展案	免稅期間
二廠擴建、電腦輔助設計擴充及新增三廠	八十五年至八十八年度
一廠、二廠第一、二生產單位及三廠擴建、新增四廠	八十六年至八十九年度
一廠、二廠第一、二生產單位、三廠及四廠擴建、新增五廠	八十八年至九十一年度

德基公司增資擴展免稅期間為八十七年一月一日至九十年十二月三十一日。

台積公司截至八十五年度、德基公司及世大公司截至八十六年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。另德基公司不服八十四年、八十五年及八十六年度所得稅之核定結果，已提起行政救濟程序，目前正在複查中。

### (十八) 關係人交易

除已於財務報表及其他附註中揭露者外，重大之關係人交易及餘額彙總如下：

#### 1 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與台積、德碁及世大公司之關係
工研院	台積公司及董事長為工研院之董事
飛利浦公司	台積公司主要股東之一
世界先進積體電路公司（世界先進公司）	台積公司之被投資公司
SYSTEMS ON SILICON MANUFACTURING COMPANY PTE LTD (SSMC)	台積公司之被投資公司
華邦電子股份有限公司（華邦公司）	世大公司董事同一人
太欣半導體股份有限公司（太欣公司）	世大公司董事同一人（八十八年三月六日解任）
中德電子材料股份有限公司（中德公司）	世大公司董事同一人

#### 2 關係人交易

	八九年		八八年	
	金額	百分比	金額	百分比
<b>全年度</b>				
銷貨收入				
工研院	\$198,146	-	\$132,507	-
飛利浦及其聯屬公司	5,289,927	3	2,864,149	4
世界先進公司	17,012	-	48,473	-
華邦公司	-	-	625,246	1
太欣公司	-	-	58,877	-
	<u>\$5,505,085</u>	<u>3</u>	<u>\$3,729,252</u>	<u>5</u>
進貨				
世界先進公司	\$6,572,110	19	\$381,989	3
中德公司	-	-	30,820	-
	<u>\$6,572,110</u>	<u>19</u>	<u>\$412,809</u>	<u>3</u>
租金費用				
工研院	<u>\$161,575</u>	<u>14</u>	<u>\$161,488</u>	<u>54</u>
製造費用				
飛利浦公司（技術報酬金）	\$2,137,175	3	\$862,398	2
華邦公司（技術權利金）	-	-	300,000	1
	<u>\$2,137,175</u>	<u>3</u>	<u>\$1,162,398</u>	<u>3</u>
管理費用				
世界先進公司（顧問費）	\$-	-	\$20,400	-
出售固定資產				
世界先進公司	<u>\$87,189</u>	<u>37</u>	<u>\$-</u>	<u>-</u>
營業外收入				
SSMC（主要係技術服務收入）	\$152,347	3	\$-	-
世界先進公司	5,604	-	-	-
其他	38	-	-	-
	<u>\$157,989</u>	<u>3</u>	<u>\$-</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

世大公司與華邦公司於民國八十六年一月簽訂技術移轉授權及服務合約，華邦公司依本契約將提供世大公司授權技術、相關資料及諮詢服務等，世大公司同意依其提供建廠協助及移轉授權技術之進度，支付技術報酬金總計800仟元。截至民國八十八年十二月三十一日止，世大公司皆已支付完畢。

**研發測試費**

華邦公司	\$-	-	\$3,531	-
<b>年底餘額</b>				
應收關係人款項				
工研院	\$56,078	6	\$18,458	5
飛利浦及其聯屬公司	643,604	68	133,245	39
世界先進公司	159,890	17	25,674	8
SSMC	89,154	9	5,353	1
德基公司	-	-	23,117	7
華邦公司	-	-	131,927	39
其他	-	-	3,164	1
	<u>\$948,726</u>	<u>100</u>	<u>\$340,938</u>	<u>100</u>
預付費用及其他流動資產				
預付租金－工研院	<u>\$42,664</u>	<u>6</u>	<u>\$42,541</u>	<u>2</u>
應付關係人款項				
飛利浦及其聯屬公司	\$797,375	31	\$305,756	29
世界先進公司	1,808,964	69	184,741	18
德基公司	-	-	539,466	52
中德公司	-	-	6,385	1
	<u>\$2,606,339</u>	<u>100</u>	<u>\$1,036,348</u>	<u>100</u>

上列與關係人交易之價格及收付款條件，除出售固定資產及技術服務係依合約規定外，餘均與非關係人相當。

**(十九) 重大長期租賃**

台積公司積體電路第一廠之土地、廠房及部分機器設備係向工業技術研究院（工研院）承租，至九十年三月底止。目前年租金為170,656仟元（含服務費及管理費），租約到期時雙方可協議續約。

台積公司積體電路第二廠至第十四廠之土地係向科學工業園區管理局承租，租期分別於九十七年三月至一〇八年十一月間到期。租金每年共計172,000仟元，到期時可再續約。

北美子公司之辦公室及部份設備及歐洲子公司辦公室係向他人承租，租約將分別於一〇九年九月及九十三年到期，目前年租金合計約57,379仟元。

前述租約未來五年及以後年度之租金如下：

年度	金額
九十	\$433,792
九十一	308,386
九十二	268,387
九十三	271,116
九十四	269,068
九十五至一〇九	1,990,581
	\$3,541,330

## (二十) 抵質押之資產

下列資產係作長短期借款、遠期外匯操作、信用狀、設質海關、外勞保證之擔保品。

	八十九年底	八十八年底
質押定存	\$-	\$3,161,693
短期投資	<u>937,428</u>	-
固定資產	<u>7,171,081</u>	46,343,950
	<u>\$8,108,509</u>	<u>\$49,505,643</u>

除上列抵質押資產外，WAFERTECH, LLC 之全部資產（帳列金額共計美金1,243,996仟元）業已提供作為其長期借款之擔保品。

## (二十一) 承諾事項

截至八十九年底止，重大承諾事項如下：

- 1 台積公司與飛利浦公司簽訂技術合作合約，自七十七年一月一日起，按約定產品銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金。合約有效期間為十年；除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。台積公司已於八十六年五月十二日與飛利浦公司修訂上述合約，自八十六年七月九日起生效，合約延展十年，並於到期後自動展期，每次三年。依據上述修訂合約之規定，自修訂合約生效滿五年後，台積公司若須支付權利金予任何第三人，該金額可自應支付予飛利浦公司之技術報酬金中扣除，惟每年應支付之技術報酬金仍不得低於特定比例。
- 2 台積公司於符合特定股權條件，承諾飛利浦及其聯屬公司每年得預訂台積公司最高達百分之三十之產能，惟應於合理期間前通知。
- 3 台積公司與工研院簽訂次微米技術授權契約，於五年內支付授權費129,400仟元（含5%加值型營業稅，業已全數支付），並按約定產品銷貨收入淨額之一定百分比支付權利金至八十七年底止，合約有效期間至八十九年十二月三十一日止。另與工研院簽訂技術合作契約，台積公司應於契約有效期限內提供經濟部及其指定對象最高達35%之產能。
- 4 台積公司與若干主要客戶簽訂晶圓代工相關合約，依合約之規定台積公司以預收保證金之方式保留一定產能予該等客戶。截至八十九年底止，該等存入保證金計美金213,865仟元。
- 5 台積公司與飛利浦公司及新加坡經濟發展局於八十八年三月三十日簽訂合資協議書。依該協議書約定，由三方共同出資約十二億新加坡幣於新加坡設立晶圓代工廠“Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd”（“SSMC”），其中台積公司持有股份百分之三十二。依約定飛利浦公司與台積公司有義務購買特定比例之SSMC 產能，若任一方無法購足其承諾之產能且SSMC 產能使用率低於一定比例時，應賠償SSMC 相關成本損失。
- 6 台積公司與SSMC 於八十八年五月十二日簽訂技術合作合約，依合約規定SSMC 應按其銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金予台積公司，合約有效期間為十年，除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。
- 7 台積公司與National Semiconductor Corporation（“National”）於八十九年六月二十七日簽訂技術移轉契約。依該契約約定，National 應給付技術授權費予台積公司。合約有效期間為十年，除非任一方於特定條件下提前終止本契約，本契約到期後自動展期，每次二年。
- 8 台積公司與世界先進公司簽訂晶圓代工合約，自八十九年二月起，世界先進公司應保留特定產能予台積公司，並按雙方約定之價金製造台積公司客戶所要求之產品，台積公司亦同意給付世界先進公司若干保證金。本合約有效期間為五年。
- 9 InveStar Semiconductor Development Fund, Inc.及InveStar Semiconductor Development Fund (II), Inc.與位於開曼群島之InveStar Capital Inc.簽訂投資管理顧問合約，每年以約定之加權平均股本及資本公積之2% 計算按季支付管理費。
- 10 某些建商控告因WAFERTECH, LLC 之影響，導致建廠過程中需額外花費較多的材料及人工成本，因此向WAFERTECH, LLC 求償。基於保守原則，WAFERTECH, LLC 已估列損失美金16,000仟元，並已與其中一建商達成協議，已於八十九年度實際支付美金10,750仟元，並預計於九十年度支付美金5,250仟元。
- 11 WAFERTECH, LLC 自八十五年起實施員工認股計劃，並於八六年修正。依修正後之辦法，WAFERTECH, LLC 得授與主管、主要員工及非員工之董事認股權。認股權之使用期限依認購日而定，但一般而言，其可使用期限為認購日起一、二、三或四年，員工每年可累積行使四分之一認股權。本計劃共計發行15,150,000單位認股權，約佔WAFERTECH, LLC 股權比例之6%。

認股計劃之資料彙總如下：

	可授與之認股權	已授與之認股權數	流通在外認股權 行使價格(美金)
八十八年初餘額	6,400,252	7,099,748	\$0.74
已授與之認股權			
認購價格高於市價	(3,084,305)	3,084,305	0.86
行使之認股權	-	(1,119,323)	0.74
取消之認股權	838,650	(838,650)	0.74
八十八年底餘額	4,154,597	8,226,080	0.78
額外核准之認股權	1,650,000	-	-
已授與之認股權			
認購價格高於市價	(3,203,302)	3,203,302	1.86
行使之認股權	-	(3,411,867)	0.74
取消之認股權	1,180,871	(1,180,871)	1.09
八十九年底餘額	3,782,166	6,836,644	1.23

上述已授與之認股權將於九十五年五月至九十九年十二月到期。

- 12 WAFERTECH, LLC 經稅務機關核定應補繳稅捐美金8,800仟元，WAFERTECH, LLC 不服其核定，除依法提起救濟外，並採保守原則暫將該稅捐估列入帳。
- 13 北美子公司自八十九年十二月起實施員工股票增值權計劃，依該計劃，員工可依各行使期間期末之台積公司股票市價與行使價格之差額，獲取員工紅利，截至八十九年底北美子公司尚未認列任何有關之薪資費用或負債。
- 14 台積公司為TSMC Development, Inc.及北美子公司之融資美金268,000仟元及40,000仟元提供背書保證。
- 15 台積公司於八十九年底已開立未使用之信用狀金額約250,338仟元。

## (二十二) 其他附註揭露之事項

(一) 重大交易事項及 (二) 轉投資相關資訊：

- 1 資金貸與他人。（附表一）
- 2 為他人背書保證。（附表二）
- 3 期末持有有價證券情形。（附表三）
- 4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表四）
- 5 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表五）
- 6 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 7 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表六）
- 8 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。（附表七）
- 9 被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊。（附表八）
- 10 從事衍生性金融商品交易：  
台積公司及子公司八十九年度從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率及利率波動所產生之風險，避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的，均屬非以交易為目的之避險活動，茲將有關資訊揭露如下：

(1) 遠期外匯買賣合約：

截至八十九年底止，尚未到期之遠期外匯買賣合約金額如下：

	幣別	合約金額（仟元）	公平價值（仟元）	到期日	到期值（仟元）
買入遠期外匯	美金	USD 60,000	NTD 1,978,998	90.01	NTD 1,989,006
買入遠期外匯	歐元	EUR 28,968	USD 27,080	90.01~09	USD 26,823
買入遠期外匯	日幣	JPY 42,772	USD 374	90.01	USD 374
賣出遠期外匯	美金	USD 106,993	NTD 3,582,959	90.01~02	NTD 3,553,080
賣出遠期外匯	美金	USD 156,875	NTD 5,100,386	90.01	NTD 5,091,560
賣出遠期外匯	美金	USD 365,000	NTD 12,105,459	90.01~12	NTD 12,032,465

八十九年底因遠期外匯買賣合約所產生之應收款項為119,227仟元（帳列其他流動資產）、應付款項為180,256仟元（帳列其他流動負債）。八十九年度認列之兌換淨益為266,393仟元。

上述遠期外匯合約係為規避下列淨資產或淨負債之匯率變動風險。

淨資產或淨負債

八九年底

應收帳款	USD	813,685
應付帳款及應付工程及設備款	USD	571,332
	JPY	21,237,708
	EUR	62,480

(2) 利率交換合約

台積公司與數家銀行簽訂利率交換合約，以固定區間利率換取浮動利率，用以規避長期借款採浮動利率計息產生之利率變動風險，八十九年度產生之利息支出為113,683仟元。截至八十九年底止，簽訂之利率交換合約彙總如下：

合約簽訂日	期間	合約金額（仟元）
87年4月28日	87年5月21日~92年5月21日	NTD \$2,000,000
87年4月29日	87年5月21日~92年5月21日	NTD 1,000,000
87年6月26日	87年6月26日~92年6月26日	NTD 1,000,000
87年6月26日	87年7月6日~92年7月6日	NTD 1,000,000

(3) 外幣選擇權合約

台積公司八十九年度因預期將自外銷銷售取得美金收入或外購機器設備以日幣支應，故與銀行簽訂外幣選擇權合約，以規避外幣匯率波動所可能造成之不利影響。

截至八九年底止，尚未到期之外幣選擇權合約彙總如下：

類別	交易	選擇權	合約金額（仟元）	帳面價值	公平價值	執行價格	到期日
歐式	出售	賣權	EUR 525,537	\$- (\$189,735)	0.8870~0.9680	（美元兌歐元）	90.05
歐式	出售	賣權	USD 203,500	- (264,885)	107.77~110.5	（美元兌日幣）	90.03
歐式	出售	買權	USD 20,000	- (1,485)	32.42	（美元兌台幣）	90.01
歐式	買入	賣權	USD 15,000	- 37	110~110.5	（美元兌日幣）	90.02

八九年度認列之權利金收入為116,248仟元；權利金費用為108,133仟元。

(4) 交易風險

- a 信用風險－交易對象皆為國內外信用良好之金融機構，預期不致產生重大信用風險。
- b 市場價格風險－從事衍生性金融商品交易即在規避外幣淨資產或淨負債及外幣承諾因匯率或利率波動所產生之風險，因是匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷；另利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場價格風險並不重大。

c 流動性風險及現金流量風險－從事遠期外匯及外幣選擇權交易即在規避淨資產或淨負債及外幣承諾之匯率變動風險，因到期時有相對之現金流入或流出，且考慮未來營運資金足以支應；而利率交換合約之利率亦已考量未來資金成本所訂定，故無籌資風險。因遠期外匯及外幣選擇權合約之匯率及利率交換合約之利率已確定，不致有重大之現金流量風險。

(5) 金融性商品之公平價值

非衍生性金融商品	八十九年底		八十八年底	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<b>資產</b>				
現金及約當現金	\$38,840,217	\$38,840,217	\$29,517,682	\$29,517,682
短期投資	2,351,560	2,351,560	965,397	965,397
應收關係人款項	948,726	948,726	340,938	340,938
應收票據及帳款	27,055,432	27,055,432	13,321,987	13,321,987
長期投資	9,814,342	14,353,717	16,164,676	28,181,143
存出保證金	979,067	979,067	59,371	59,371
質押定存	-	-	3,161,693	3,161,693
<b>負債</b>				
短期借款	3,833,841	3,833,841	5,026,631	5,026,631
應付商業本票	-	-	94,797	94,797
應付關係人款項	2,606,339	2,606,339	1,036,348	1,036,348
應付票據及帳款	8,507,827	8,507,827	3,273,894	3,273,894
應付工程及設備款	25,550,273	25,550,273	12,593,712	12,593,712
長期負債（含一年內到期部份）	23,390,422	23,390,422	22,748,831	22,748,831
應付公司債	29,000,000	29,035,803	20,000,000	20,222,611
存入保證金	7,086,379	7,086,379	5,185,362	5,185,362
<b>衍生性金融商品</b>				
買入遠期外匯	2,820,220	2,887,126	2,372,219	2,306,638
賣出遠期外匯	20,802,311	20,788,804	3,998,698	3,998,108
利率交換合約	1,601	234,017	7,488	7,488
選擇權合約	-	(456,068)	6,946	6,946

估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- a 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
- b 短期投資係以市場價格為公平價值。
- c 長期投資於上市上櫃公司者以其市場價格為公平價值，投資於非上市上櫃公司及其他長期投資者，以資產負債表日之淨值作為估計其公平價值之基礎。
- d 存出（入）保證金之未來收現（支付）金額與帳面金額相近，故以帳面金額為公平價值。
- e 長期負債以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以所能獲得類似條件之長期負債利率為準。長期負債利率除公司債外，均屬浮動利率，其帳面價值即為公平市價，故僅評估公司債之折現值。
- f 台積公司及子公司係以銀行報價所顯示之外匯換匯率及利率，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率及利率交換合約分別計算個別合約之公平價值。

因部份金融商品及非金融商品無須列示其公平價值，是以上表所列公平價值總數並不代表台積公司及其子公司之總價值。

(二十三) 部門別資訊

1 地區別資訊如下：

	北美洲及其他	國內	調整及沖銷	合併
<u>八十九年度</u>				
來自母公司及合併子公司以外客戶之收入	\$-	\$166,197,604	\$-	\$166,197,604
來自母公司及合併子公司之收入	14,451,231	30,816	(14,482,047)	-
收入合計	<u>\$14,451,231</u>	<u>\$166,228,420</u>	<u>(\$14,482,047)</u>	<u>\$166,197,604</u>
部門損益	<u>\$3,970,099</u>	<u>\$73,924,745</u>	<u>(\$1,379,004)</u>	<u>\$76,515,840</u>
營業費用				(15,221,152)
營業外收入				6,227,936
營業外費用				(3,621,100)
稅前利益				<u>\$63,901,524</u>
少數股權損失				<u>\$36,786</u>
可辨認資產	<u>\$64,659,712</u>	<u>\$320,273,323</u>	<u>(\$23,861,398)</u>	<u>\$361,071,637</u>
長期投資				9,814,342
資產合計				<u>\$370,885,979</u>
<u>八十八年度</u>				
來自母公司及合併子公司以外客戶之收入	\$5,193,000	\$71,112,102	\$-	\$76,305,102
來自母公司及合併子公司之收入	975,431	4,696,218	(5,671,649)	-
收入合計	<u>\$6,168,431</u>	<u>\$75,808,320</u>	<u>(\$5,671,649)</u>	<u>\$76,305,102</u>
部門損益	<u>\$5,670,076</u>	<u>\$30,069,272</u>	<u>(\$5,671,649)</u>	<u>\$30,067,699</u>
營業費用				(7,797,710)
營業外收入				1,682,327
營業外費用				(3,324,002)
稅前利益				<u>\$20,628,314</u>
少數股權損失				<u>\$515,898</u>
可辨認資產	<u>\$34,807,935</u>	<u>\$185,054,075</u>	<u>(\$591,172)</u>	<u>\$219,270,838</u>
長期投資				16,164,676
資產合計				<u>\$235,435,514</u>

2 外銷銷貨資訊

外銷銷貨明細如下：

地區	八十九年度	八十八年度
美洲	\$81,655,987	\$38,418,426
亞洲	42,906,968	16,744,842
歐洲	11,360,517	4,778,646
	<u>\$135,923,472</u>	<u>\$59,941,914</u>

外銷銷貨資訊係以收款地圖為計算基礎

3 重要客戶資訊

佔合併銷貨收入百分之十以上之客戶：無。

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

資金貸與他人

民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表一

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象 資金貸與限額 (美金為仟元)	本期最高餘額 (美金為仟元)	期末餘額 (美金為仟元)	利率區間	資金貸 與原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品		業務往 來金額	資金貸與最 高限額
										名稱	價值		
2	世界先進公司	VIS America	預付費用	(註一)	\$6,122	\$1,232	-	預付委託 開發設計費	\$-	-	-	\$5,706	\$4,400,000 (註二)

註一： 貸放資金予個別對象不得超過公司實收資本額之10%，並限於借款人實收資本額之30%以內。

註二： 貸放資金總額不得超過公司實收資本額之20%。

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司與其轉投資公司

為他人背書保證

民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象 公司名稱 (註二)	對單一企業背書保證之限額 關係	本期最高背書 保證餘額 (美金為仟元)	期末背書 保證餘額 (美金為仟元)	以財產擔保 之背書保證 金額	累計背書保 證金額佔最 近期財務報 表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註一)
0	台灣積體 電路公司	TSMC Development Inc.	3 不超過本公司實收資本額之 10%，惟以該被背書保證	\$8,865,172 (USD268,000)	\$8,865,172 (USD268,000)	\$8,865,172	3.39%	\$38,968,094
	台灣積體電路 (北美)公司		2 公司之實收資本額為限： 倘經董事會核准，則不受單 一企業背書保證之限制。	1,323,160 (USD40,000)	1,323,160 (USD40,000)	1,323,160	0.51%	

註一： 台積公司實收資本額百分之三十。

註二： 2 係直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

3 經母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

期末持有有價證券情形  
民國八十九年十二月三十一日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
<b>台灣積體電路公司</b>							
世界先進積體電路公司股票	被投資公司	長期投資	556,133	\$5,615,075	25	\$8,642,314	
SSMC 股票	被投資公司	長期投資	90	935,870	32	935,870	
台灣光罩公司股票	-	長期投資	6,887	32,129	2	87,325	
聯亞氣體工業公司股票	-	長期投資	10,058	146,250	10	155,041	
台灣信越半導體公司股票	-	長期投資	10,500	105,000	7	105,476	
普實創業投資公司股票	-	長期投資	5,000	50,000	4	81,059	
台宏半導體公司股票	-	長期投資	50,000	500,000	19	434,385	
宏通創業投資公司股票	-	長期投資	12,000	120,000	10	125,927	
Crimson Asia Capital 受益憑證	-	長期投資	-	64,547	不適用	64,547	
Horizon Ventures Fund 受益憑證	-	長期投資	-	93,304	不適用	93,304	
<b>積成投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	2,160	98,282	-	184,451	
<b>功成投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	4,827	226,819	-	412,317	質押4,827仟股
<b>柏成投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	3,814	236,150	-	325,790	質押2,814仟股
<b>承暉投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	4,298	243,391	-	367,074	質押3,297仟股
<b>啓信投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	2,544	138,747	-	217,270	質押2,543仟股

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱 行人之關係	與有價證券發 行 人 之 關 係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
<b>欣瑞投資公司</b>							
台灣積體電路公司股票	主要股東	短期投資	1,006	\$85,850	-	\$85,936	
<b>台積國際投資公司</b>							
3DFX. Interactive Inc. 股票	-	長期投資	68	USD297	-	USD84	
<b>世界先進公司</b>							
VIS Associates Inc. 股票	本公司之子公司	長期投資	23,570	464,077	100	464,077	
力晶半導體公司股票	被投資公司	長期投資	168,488	2,651,216	9	3,315,837	
鈺創科技公司股票	-	長期投資	5,590	310,132	3	278,118	
華新先進電子公司股票	被投資公司	長期投資	31,410	414,481	10	414,481	
米鵝科技公司股票	-	長期投資	16,500	177,000	15	177,000	
Form Factor Inc. 股票	-	長期投資	267	64,360	1	64,360	
聯亞氣體工業公司股票	-	長期投資	2,313	29,250	2	29,250	
<b>TSMC Partners</b>							
台灣積體電路公司美國存託憑證	母公司	短期投資	495	USD7,357	-	USD8,916	
<b>InveStar Semiconductor Development Fund Inc.</b>							
Silicon Image, Inc. 普通股股票	-	短期投資	411	USD720	-	USD2,237	
Sage, Inc. 普通股股票	-	短期投資	140	USD506	-	USD2,065	
Centillium Tec. Corp. 普通股股票	-	短期投資	165	USD650	-	USD3,671	
Marvell Technology Group Ltd. 普通股股票	-	短期投資	4,665	USD4,579	-	USD102,347	
Silicon Labo Ratories 普通股股票	-	短期投資	15	USD482	-	USD219	
Programmable Microelectronics	-	長期投資	1,113	USD1,500	-	USD1,500	
Capella Microsystems, Inc. 普通股股票	-	長期投資	42	USD10	-	USD10	
Equator Technologies, Inc. 普通股股票	-	長期投資	133	USD90	-	USD260	
Scenix Semiconductor Inc. 普通股股票	-	長期投資	861	USD172	-	USD172	

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末			備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	
Global Test Corp. 普通股股票	-	長期投資	11,292	USD5,559	-	USD9,242
Chip strate 普通股股票	-	長期投資	6,660	USD2,142	-	USD2,190
Ritch Tech 普通股股票	-	長期投資	790	USD313	-	USD302
APE 富鼎先進普通股股票	-	長期投資	2,750	USD1,518	-	USD1,411
Integrated Memory Logic, Inc.						
特別股股票	-	長期投資	1,831	USD1,809	-	USD2,559
Divio (Next wave) 特別股股票	-	長期投資	667	USD500	-	USD2,233
SiRF Technology Inc. 特別股股票	-	長期投資	306	USD1,333	-	USD1,771
Rise 特別股股票	-	長期投資	600	USD1,500	-	USD1,500
Capella Microsystems, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,383	USD1,298	-	USD1,383
Sensory, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,404	USD1,250	-	USD1,250
Equator Technologies, Inc. 特別股股票	-	長期投資	443	USD1,338	-	USD864
Light Speed Semiconductor Corporation 特別股股票	-	長期投資	2,252	USD3,064	-	USD5,639
Empower Tel Networks, Inc. 特別股股票	-	長期投資	3,840	USD5,128	-	USD14,980
Lara Networks, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,544	USD772	-	USD10,034
Scenix Semiconductor Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,056	USD1,361	-	USD2,919
RapidSteam 特別股股票	-	長期投資	2,056	USD1,050	-	USD7,286
Tropian, Inc. (Premier R.F., Inc.)						
特別股股票	-	長期投資	1,758	USD2,334	-	USD7,498
Sonics, Inc. 特別股股票	-	長期投資	2,686	USD3,530	-	USD4,110
Pico Turbo, Inc 特別股股票	-	長期投資	1,050	USD1,250	-	USD1,250
T-Span Systems Corporation						
特別股股票	-	長期投資	1,266	USD1,385	-	USD3,653
NanoAmp Solutions, Inc. 特別股股票	-	長期投資	541	USD853	-	USD1,900
Formfactor, Inc. 特別股股票	-	長期投資	267	USD2,000	-	USD2,747
Monolithic Power Systems, Inc						
特別股股票	-	長期投資	2,521	USD2,000	-	USD2,000
Memsic, Inc 特別股股票	-	長期投資	3	USD1,500	-	USD1,500
Reflectivity, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,064	USD2,000	-	USD2,000
Signia 特別股股票	-	長期投資	3,000	USD1,500	-	USD1,500

(接次頁)

(承前頁)

有價證券種類及名稱	與有價證券發 行人之關係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
Match Lab, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,875	USD1,500	-	USD1,500	
HINT Corporation 特別股股票	-	長期投資	1,000	USD1,000	-	USD1,000	
Creosys, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,500	USD1,500	-	USD1,500	
Incentia Design Systems, Inc. 特別股股票	-	長期投資	286	USD500	-	USD500	
Rise 債券	-	長期投資	不適用	USD300	-	USD300	
<hr/>							
InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.							
Lara Networks, Inc. 特別股股票	-	長期投資	188	USD1,500	-	USD1,500	
Seagull Semiconductor, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,389	USD1,250	-	USD1,250	
Memsic, Inc. 特別股股票	-	長期投資	1,818	USD1,000	-	USD1,000	
OEpic 特別股股票	-	長期投資	600	USD750	-	USD750	
FabCentric, Inc. 特別股股票	-	長期投資	500	USD250	-	USD250	
Equator Technologies, Inc. 特別股股票	-	長期投資	770	USD1,501	-	USD1,501	
NanAmp Solutions, Inc. 特別股股票	-	長期投資	250	USD1,000	-	USD1,000	
RapidStream, Inc. 特別股股票	-	長期投資	246	USD1,057	-	USD1,057	
FabCentric, Inc. 債券	-	長期投資	不適用	USD250	-	USD250	
Signia Technologies, Inc. 債券	-	長期投資	不適用	USD500	-	USD500	
Advanced Analogic Technology, Inc. 債券	-	長期投資	不適用	USD1,250	-	USD1,250	

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表四

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		期末	
				股數 (仟股)	金額 (美金為仟元)	股數 (仟股)	金額 (美金為仟元)	股數 (仟股)	售價 (美金為仟元)	帳面成本 (美金為仟元)	處分(損)益 (仟元)
<b>台灣積體電路公司</b>											
台北銀行股票	短期投資	-	-	8,750	\$236,250	-	\$-	8,750	\$288,719	\$236,250	\$52,469
國際萬隆證券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	18,207	230,000	18,207	231,644	230,000	1,644
光華債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	25,495	323,000	25,495	326,273	323,000	3,273
日盛債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	26,382	300,000	26,382	302,604	300,000	2,604
群益安穩收益投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	24,468	300,000	24,468	302,748	300,000	2,748
元大萬泰投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	25,484	300,000	25,484	302,523	300,000	2,523
統一全壘打投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	28,222	332,000	28,222	333,627	332,000	1,627
大華債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	57,900	630,000	57,900	633,522	630,000	3,522
中信債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	26,842	340,000	26,842	341,476	340,000	1,476
怡富台灣債券基金	短期投資	-	-	-	-	25,593	330,000	25,593	332,564	330,000	2,564
建弘台灣債券基金	短期投資	-	-	-	-	25,556	300,000	25,556	301,955	300,000	1,955
建弘全家福基金	短期投資	-	-	-	-	2,956	410,000	2,956	411,752	410,000	1,752
聯合債券基金	短期投資	-	-	-	-	30,054	330,000	30,054	331,605	300,000	1,605
統一強棒基金	短期投資	-	-	-	-	46,405	600,000	46,405	603,210	600,000	3,210
世界先進公司股票	長期投資	世界先進公司	被投資公司	556,133	5,010,897	-	-	-	-	556,133	5,615,075
<b>System on Silicon Manufacturing Company (SSMC) 股票</b>											
System on Silicon Manufacturing Company (SSMC) 股票	長期投資	SSMC	被投資公司	26	360,177	64	989,690	-	-	-	90
<b>功成投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	984	50,509	4,682	219,376	839	172,270	43,066	129,204
<b>柏成投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	642	88,519	3,603	206,936	430	88,166	59,306	28,860
<b>承偉投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	642	88,732	4,288	239,512	632	119,571	84,853	34,718

(接次頁)

(淨前頁)

有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		期末	
				股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益
				(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)		(仟股)(美金為仟元)
<b>啓信投資公司</b>											
台灣積體電路公司股票	短期投資	-	-	642	\$87,157	2,439	\$124,547	537	\$110,211	\$72,957	\$37,254
<b>TSMC Partners</b>											
台灣積體電路公司	美國存託憑證	短期投資	-	302	USD3,703	193	USD3,654	-	-	-	495
<b>InveStar Semiconductor Development Fund Inc. :</b>											
Empower Tel Networks, Inc.	長期投資	Empower Tel Networks, Inc.	被投資公司	3,087	USD1,878	752	USD3,250	-	-	-	3,840
Global Test Corp.	長期投資	Global Test Corp.	被投資公司	7,500	USD2,281	3,792	USD3,278	-	-	-	11,292
<b>世界先進公司</b>											
中信債券型基金	-	-	-	-	-	58,761	750,000	58,761	761,731	750,000	11,731
光華債券型基金	-	-	-	-	-	42,671	550,000	42,671	558,584	550,000	8,584
大眾債券型基金	-	-	-	-	-	16,199	180,000	16,199	182,393	180,000	2,393
建弘全家福基金	-	-	-	-	-	3,921	550,000	3,921	558,516	550,000	8,516
元大萬泰基金	-	-	-	-	-	45,921	550,000	45,921	558,212	550,000	8,212
中華富泰基金	-	-	-	-	-	31,415	400,000	31,415	404,997	400,000	4,997
大華債券基金	-	-	-	-	-	21,446	240,000	21,446	242,656	240,000	2,656

註一： 期末金額係包含按權益法認列之投資損益及累積換算調整數。

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表五

單位：新台幣仟元

取得之 公司	財產名稱	交易日 或事實 發生日	交易金額	價款支付 情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者， 其前次移轉資料		價格決定之 參考依據	取得目的及 使用之情形	其他約 定事項		
							所有人	與公司 之關係	移轉 日期	金額			
台灣積體 電路公司	六廠廠房 及辦公室	89/2/16~ 89/12/31	\$3,254,412	依工程進度 發生日	互助營造	-	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

與關係人進、銷貨金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表六

單位：新台幣仟元

交易對象	關係	交易情形			交易條件與一般交易及原因不同之情形		應收（付）票據、帳款		備註
		進（銷）貨 金額	佔總進（銷）貨之比率 (%)	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率 (%)	
<b>台灣積體電路公司</b>									
工研院	本公司董事長為其董事	銷貨	\$198,146	- 月結45天	無	無	\$56,078	6	
飛利浦及其聯屬公司	本公司主要股東之一	銷貨	5,289,927	3 發票日後30天	無	無	643,604	68	
世界先進公司	被投資公司	進貨	6,572,110	19 月結45天	無	無	(1,808,964)	(69)	

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年十二月三十一日

附表七

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
台灣積體電路公司	飛利浦及其聯屬公司	本公司主要股東之一	\$643,604	27 天	\$175,828	持續催收	\$193,403	\$-
世界先進公司	被投資公司		159,890	不適用	10,080	持續催收	-	-

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司與轉投資公司

被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊

民國八十九年十二月三十一日

附表八

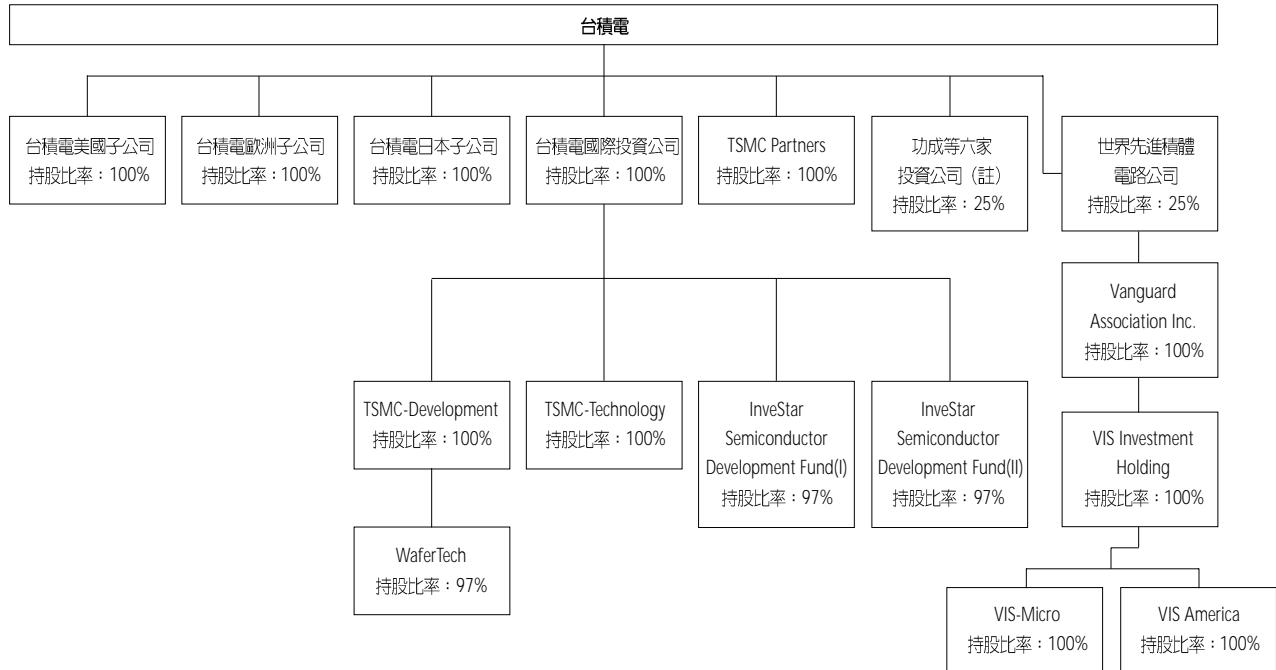
單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

被投資公司名稱	所在地區	主要營業 項目	原始投資金額		期末持有			被投資 公司本期 (損) 益	本期認 列之投資 (損) 益	備註
			本期期末	上期期末	股數 (仟股)	比率 %	帳面金額			
<b>台灣積體電路公司</b>										
世界先進積體電路公司	新竹市	積體電路設計製造	\$6,503,640	\$6,503,640	556,133	25	\$5,615,075	\$2,573,745	\$597,812	被投資公司
Systems on Silicon Manufacturing Company (SSMC)	Singapore	半導體晶圓製造	1,432,482	442,792	90	32	935,870	(1,480,190)	(473,661)	被投資公司

# 特 別 記 載 項

## 一、關係企業相關資料

### (一) 關係企業圖



(二)台灣積體電路製造股份有限公司各關係企業基本資料

截至民國89年12月31日止

單位：新台幣（外幣）仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
台灣積體電路製造（股）公司 北美子公司	77/01/18	San Jose, California, USA	US\$ 11,000	市場行銷及工程支援
台灣積體電路製造（股）公司 歐洲子公司	83/03/04	Amsterdam, The Netherlands	NLG 200	市場行銷及工程支援
台灣積體電路製造（股）公司 日本公司	86/09/10	Yokohama, Japan	JPY 120,000	市場行銷及工程支援
台積國際投資公司	85/04/09	Tortola, British Virgin Islands	US\$ 779,788	投資業務
TSMC Partners, Ltd.	87/03/26	Tortola, British Virgin Islands	US\$ 300	投資業務
TSMC Development, Inc.	85/02/16	Delaware, USA	US\$ 734,403	投資業務
TSMC Technology, Inc.	85/02/20	Delaware, USA	US\$ 0.001	投資業務
InveStar Semiconductor Development Fund Inc.	85/09/10	Cayman Island	US\$ 46,350	投資業務
InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.	89/08/25	Cayman Island	US\$ 14,369	投資業務
WaferTech, LLC	85/06/03	Washington, USA	US\$ 769,927	半導體晶圓製造
柏成投資有限公司	87/07/06	台北市	NT\$ 400,000	投資業務
啓信投資有限公司	87/07/06	台北市	NT\$ 400,000	投資業務
承暉投資有限公司	87/07/10	台北市	NT\$ 400,000	投資業務
欣瑞投資有限公司	87/07/13	台北市	NT\$ 400,000	投資業務
功成投資有限公司	87/07/14	台北市	NT\$ 400,000	投資業務
積成投資有限公司	87/07/15	台北市	NT\$ 400,000	投資業務
世界先進積體電路（股）公司	83/12/05	新竹市	NT\$ 22,000,000	積體電路設計製造
VIS Associates Inc.	85/09/24	Tortola, British Virgin Islands	US\$ 23,570	半導體相關事業投資
VIS Investment Holding, Inc.	85/11/16	Delaware, USA	US\$ 6,750	半導體相關事業投資
VIS Micro, Inc.	85/11/21	San Jose, California, USA	US\$ 200	半導體產品行銷及市場服務
Vanguard International Semiconductor-America	85/04/24	San Jose, California, USA	US\$ 6,500	半導體產品研究發展

註：報表日兌換率如下：

美金（USD）1元 = 新台幣 33.079元

荷蘭幣（NLG）1元 = 新台幣 13.9元

日幣（JPY）1元 = 新台幣 0.2892元

### (三)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，主要以「專業晶圓專業製造服務」為主，另有一小部份關係企業則以「投資業務」為其營業範圍。大體而言，關係企業間往來分工情形，在於透過技術、產能、行銷以及服務的互相支援，創造最大的綜效，進而使得台積公司能夠一直不斷地為其遍佈全球之客戶提供最佳的「專業晶圓專業製造服務」，確保在全球市場的領導地位。

### (四)台灣積體電路製造股份有限公司推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料

截至民國89年12月31日止

單位：新台幣仟元；股；%

推定原因	姓名或代表人（註1）	持有股份（註2）		設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
		股數	持股比例				
			無				

推定關係者包括執行業務股東、董事及持股超過50%之股東。

註一： 法人股東相同者，填法人名稱；自然人股東相同者，填自然人姓名。

註二： 持有股份係填入股東對控制公司之持股資料（不含對從屬公司資料）。

(五) TSMC 各關係企業董事、監察人及總經理資料  
截至民國89年12月31日止

單位：新台幣元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
台灣積體電路（北美）公司	董事	曾繁城	-	-
	董事	蔡力行	-	-
	總經理	Edward C. Ross	(台積持有11,000,000股)	(100%)
台灣積體電路（歐洲）公司	董事	張忠謀	-	-
	董事	蔡力行	-	-
	董事	林坤禧	-	-
	董事	Hans Richard Rohrer	-	-
	總經理	Hans Richard Rohrer	(台積持有200股)	(100%)
台灣積體電路（日本）公司	董事長	Sachiaki Nagae	-	-
	董事	張忠謀	-	-
	董事	曾繁城	-	-
	董事	蔡力行	-	-
	董事	Makoto Onodera	-	-
	監察人	張孝威	(台積持有2,400股)	(100%)
台積國際投資公司	董事	張忠謀	-	-
	總經理	曾繁城	(台積持有779,968,244股)	(100%)
TSMC Partners, Ltd.	董事	曾繁城	-	-
	董事	蔡力行	-	-
	董事	林坤禧	-	-
	董事	左大川	-	-
	董事	陳國慈	-	-
	董事	張孝威	(台積持有300,000股)	(100%)
TSMC Development, Inc.	董事長	張忠謀	-	-
	總經理	張忠謀	(台積國際投資公司持有734,403,200,000股)	(100%)
TSMC Technology, Inc.	董事長	張忠謀	-	-
	總經理	張忠謀	(台積國際投資公司持有1,000股)	(100%)

(接次頁)

(承前頁)

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
InveStar Semiconductor Development Fund Inc.	董事	邵中和	-	-
			(台積國際投資公司持有45,000,000 股)	(97%)
InveStar Semiconductor Development Fund Inc.	董事	邵中和	-	-
(II) LDC			(台積國際投資公司持有13,950,000 股)	(97%)
WaferTech, LLC	董事	張忠謀	普通股590,625 股	0.23%
	董事	Jerald Fishman	普通股33,334 股	0.01%
	董事	Rodney Smith	普通股75,000 股	0.03%
	董事	Jimmy Lee	普通股75,000 股	0.03%
	董事	蔡力行	-	-
	董事	Ronald C. Norris	-	-
	董事	左大川	-	-
	總經理	左大川	(TSMC Development, Inc. 持有特別股250,646,584 股)	(97%)
柏成投資有限公司	董事	陳國慈 (啓信投資有限公司代表)	(啓信出資額 NT\$60,000,000) (台積出資額 NT\$99,999,960)	(15%) (25%)
啓信投資有限公司	董事	張孝威 (柏成投資有限公司代表)	(柏成出資額 NT\$60,000,040) (台積出資額 NT\$99,999,960)	(15%) (25%)
承暉投資有限公司	董事	蔡力行 (欣瑞投資有限公司代表)	(欣瑞出資額 NT\$60,000,040) (台積出資額 NT\$99,999,960)	(15%) (25%)
欣瑞投資有限公司	董事	蔡力行 (承暉投資有限公司代表)	(承暉出資額 NT\$60,000,000) (台積出資額 NT\$99,999,960)	(15%) (25%)
功成投資有限公司	董事	曾繁城 (積成投資有限公司代表)	(積成出資額 NT\$60,000,040) (台積出資額 NT\$99,999,960)	(15%) (25%)
積成投資有限公司	董事	曾繁城 (功成投資有限公司代表)	(功成出資額 NT\$60,000,000) (台積出資額 NT\$99,999,960)	(15%) (25%)

(接次頁)

(承前頁)

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
世界先進積體電路（股）公司	董事長	張忠謀	3,240,448 股	0.15%
	董事	劉柏宏（行政院開發基金管理委員會代表）	(開發基金持有639,713,750 股)	(29.08%)
	董事	劉明忠（行政院開發基金管理委員會代表）		
	董事	史欽泰（行政院開發基金管理委員會代表）		
	董事	蔡力行（台灣積體電路製造（股）公司代表）	(台積持有556,133,496 股)	(25.28%)
	董事	曾繁城（台灣積體電路製造（股）公司代表）		
	董事	簡學仁（台灣積體電路製造（股）公司代表）		
	董事	謝徵榮（台灣積體電路製造（股）公司代表）		
	董事	吳亦圭（台灣聚合化學品（股）公司代表）	(台灣聚合持有155,978,533 股)	(7.09%)
	董事	焦佑衡（華新麗華（股）公司代表）	(華新麗華持有58,827,741 股)	(2.67%)
	監察人	葉惠青（行政院開發基金管理委員會代表）		
	監察人	陳國慈（台灣積體電路製造（股）公司代表）		
	監察人	周新懷（懋昌投資（股）公司代表）	(懋昌投資持有42,992,356 股)	(1.95%)
	總經理	簡學仁	2,478,229 股	0.00%
VIS Associates Inc.	董事	張忠謀（世界先進積體電路（股）公司代表）		
	董事	謝徵榮（世界先進積體電路（股）公司代表）		
	董事	簡學仁（世界先進積體電路（股）公司代表）	(世界先進持有23,570,000 股)	(100%)
VIS Investment Holding, Inc.	董事	張忠謀（VIS Associates Inc. 代表）		
	董事	謝徵榮（VIS Associates Inc. 代表）		
	董事	簡學仁（VIS Associates Inc. 代表）	(VIS Associates Inc. 持有6,750,000 股)	(100%)
VIS Micro, Inc.	董事	謝徵榮（VIS Investment Holding, Inc.代表）		
	董事	簡學仁（VIS Investment Holding, Inc.代表）		
	董事	Stephen Pletcher (VIS Investment Holding, Inc.代表)	(VIS Investment Holding, Inc.持有200,000股)	(100%)
Vanguard International Semiconductor- America	董事	蔡力行（VIS Investment Holding, Inc.代表）		
	董事	簡學仁（VIS Investment Holding, Inc.代表）		
	董事	蔡能賢（VIS Investment Holding, Inc.代表）		
	董事	Stephen Pletcher (VIS Investment Holding, Inc.代表)	(VIS Investment Holding, Inc.持有6,500,000 股)	(100%)

(六) TSMC 各關係企業營運狀況

截至民國89年12月31日止

單位：新台幣仟元

企業名稱	實收資本額	資產總值	負債總額	淨值	本期營業收入	本期營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
台灣積體電路製造（股）公司北美子公司	363,869	1,794,126	1,127,202	666,924	1,104,857	197,564	131,107	11.92
台灣積體電路製造（股）公司 歐洲子公司	2,780	47,214	37,620	9,594	96,409	8,764	(14,668)	不適用
台灣積體電路製造（股）公司 日本公司	34,704	68,394	30,591	37,803	164,001	8,389	2,261	942.23
台積國際投資公司	25,794,615	34,992,260	11,313,738	23,678,522	240,424	240,079	138,589	0.30
TSMC Partners, Ltd.	9,923	11,559,563	11,024,401	535,162	2,559	2,532	494,966	1,649.89
TSMC Development, Inc.	24,293,323	30,319,876	8,873,708	21,446,168	0	(879)	(258,770)	不適用
TSMC Technology, Inc.	0.033	210,091	693,187	(483,097)	615,401	51,896	(121,520)	不適用
InveStar Semiconductor Development Fund Inc.	1,533,212	2,101,401	275,106	1,826,295	861,148	621,341	615,978	13.29
InveStar Semiconductor Development Fund (II) Inc.	475,296	478,798	215	478,583	-	-	3,101	0.22
WaferTech, LLC	25,468,409	41,150,153	20,255,685	20,894,467	13,071,741	568,893	(168,294)	不適用
柏成投資有限公司	400,000	699,483	151,546	547,936	137,030	136,749	135,869	3.40
啓信投資有限公司	400,000	557,084	1,083	556,001	144,212	143,971	143,951	3.60
承暉投資有限公司	400,000	730,345	177,545	552,800	142,152	141,910	140,781	3.52
欣瑞投資有限公司	400,000	512,485	83	512,402	113,509	113,271	100,391	2.51
功成投資有限公司	400,000	636,089	1,083	635,006	224,167	223,649	223,915	5.60
積成投資有限公司	400,000	523,317	142	523,175	111,736	111,493	112,094	2.80
世界先進積體電路（股）公司	22,000,000	39,696,661	17,645,880	22,050,781	19,345,762	2,939,078	2,573,745	1.17
VIS Associates Inc.	737,741	785,117	19,588	765,530	364,497	9,763	7,091	0.30
VIS Investment Holding, Inc.	211,275	244,491	19,588	224,903	371,617	17,446	14,773	2.19
VIS Micro, Inc.	6,260	11,542	3,798	7,744	29,307	1,396	863	4.32
Vanguard International Semiconductor- America	203,450	232,206	15,674	216,532	342,309	16,300	14,087	2.17

### 聲明書

- 1 本公司民國八十九年度（八十九年一月一日至十二月三十一日）之關係企業合併財務報表，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」、相關法令及一般公認會計原則編製。
- 2 本公司編製之關係企業合併財務報表，無虛偽或隱匿之情事。

特此聲明



負責人： 張忠謀



中華民國九十年一月二十九日

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司  
關係企業合併財務報表會計師複核報告

台灣積體電路製造股份有限公司民國八十九年度之關係企業合併財務報表，業經本會計師依照「關係企業合併財務報表複核要點」，採行必要複核程序予以複核竣事。由於本會計師並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開關係企業合併財務報表之整體是否允當表達表示意見。

依本會計師之複核結果並未發現第一段所述台灣積體電路製造股份有限公司民國八十九年度之關係企業合併財務報表有違反「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」、相關法令規定及一般公認會計原則而須作重大修正或調整之情事。

此致

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師 黃樹傑

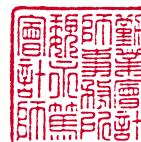
黃樹傑



台灣省會計師公會會員證第1723號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(83)台財證(六)第12213號

會計師 魏永篤

魏永篤



台灣省會計師公會會員證第705號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(72)台財證(一)第2583號

中華民國九十年一月二十九日

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司  
關係企業合併資產負債表  
民國八十九年十二月三十一日

單位：除每股面額外，為新台幣仟元

八十九年底

資產	金額	%
<b>流動資產</b>		
現金及約當現金（附註二及四）	\$44,718,006	11
質押定存(附註十九)	10,000	-
短期投資（附註二、五及十九）	2,351,560	1
應收關係人款項（附註十七）	788,836	-
應收票據	158,502	-
應收帳款	32,086,793	8
備抵呆帳（附註二）	(1,030,286)	-
備抵退貨及折讓（附註二）	(2,628,901)	(1)
存貨（附註二及六）	15,541,195	4
遞延所得稅資產（附註二及十六）	8,677,463	2
預付費用及其他流動資產（附註十七及二十一）	3,497,394	1
<b>流動資產合計</b>	<b>104,170,562</b>	<b>26</b>
 長期投資（附註二、七及二十二）	 8,309,783	 2
 <b>固定資產（附註二、八、十七及十九）</b>		
成本		
土地及土地改良	829,239	-
建築物	61,572,769	15
機器設備	274,176,958	68
辦公及其他設備	5,581,180	1
	342,160,146	84
累積折舊	(126,277,454)	(31)
預付款項及未完工程	47,895,602	12
<b>固定資產淨額</b>	<b>263,778,294</b>	<b>65</b>
 合併借項（附註二）	 11,571,460	 3
 <b>其他資產</b>		
出租資產	625,647	1
遞延借項－淨額（附註二及九）	4,878,588	1
遞延所得稅資產（附註二及十六）	8,627,357	2
存出保證金	41,410	-
其他	40,654	-
<b>其他資產合計</b>	<b>14,213,656</b>	<b>4</b>
 <b>資產總計</b>	<b>\$402,043,755</b>	<b>100</b>

	八十九年底	
	金額	%
<b>負債及股東權益</b>		
流動負債		
短期借款（附註十及十九）	\$4,630,978	1
應付關係人款項（附註十七）	958,105	-
應付帳款	9,528,743	2
應付工程及設備款	26,107,865	7
應付所得稅（附註二及十六）	3,298	-
一年內到期之長期負債（附註十一、十二及十三）	3,369,055	1
應計費用及其他流動負債（附註二十一）	7,967,651	2
流動負債合計	<u>52,565,695</u>	<u>13</u>
長期負債		
長期借款（附註十二及十九）	31,117,367	7
應付公司債（附註二及十三）	30,500,000	8
長期負債合計	<u>61,617,367</u>	<u>15</u>
其他負債		
存入保證金（附註二十一）	7,086,429	3
應計退休金負債（附註二及十五）	1,774,107	-
未實現售後租回利益（附註二）	434,183	-
應付租賃款（附註十一）	3,316	-
其他	11,040	-
	<u>9,309,075</u>	<u>3</u>
其他股權（附註二）	<u>16,797,919</u>	<u>4</u>
負債合計	<u>140,290,056</u>	<u>35</u>
股東權益（附註二及十四）		
股本－每股面額10元，額定17,800,000仟股，		
普通股發行11,689,365仟股	116,893,646	29
特別股發行1,300,000仟股	13,000,000	3
資本公積	55,285,821	14
法定公積	10,689,323	3
特別盈餘公積	1,091,003	-
未分配盈餘	65,143,847	16
長期投資未實現跌價損失	(71,564)	-
累積換算調整數	(278,377)	-
股東權益合計	<u>261,753,699</u>	<u>65</u>
負債及股東權益總計	<u>\$402,043,755</u>	<u>100</u>

後附之附註係本關係企業合併財務報表之一部分。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司  
關係企業合併損益表  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

單位：除合併每股盈餘外，為新台幣仟元

	八十九年度	
	金額	%
銷貨收入總額	\$182,260,420	
銷貨退回及折讓	<u>(3,347,516)</u>	
銷貨收入淨額（附註二、十七及二十二）	178,912,904	100
銷貨成本（附註十七）	<u>97,826,450</u>	55
銷貨毛利	<u>81,086,454</u>	45
營業費用（附註十七及二十二）		
管理費用	9,415,130	5
行銷費用	1,506,380	1
研發費用	<u>5,771,904</u>	3
合計	<u>16,693,414</u>	9
營業利益	<u>64,393,040</u>	36
營業外收入（附註二十二）		
保險理賠收入	1,981,554	1
利息收入	1,872,028	1
處分短期投資利益	1,108,008	1
兌換淨益（附註二及二十一）	844,281	1
權利金收入（附註二及二十一）	640,442	-
技術服務收入	132,910	-
處分長期投資淨益	121,969	-
處分固定資產利益	89,426	-
其他	<u>209,270</u>	-
合計	<u>6,999,888</u>	4
營業外費用（附註二十二）		
利息費用（附註二、八、十七及二十一）	3,653,435	2
按權益法認列之投資淨損（附註二及七）	1,110,218	1
處分固定資產損失	119,102	-
權利金費用	108,133	-
部門重整費用	85,776	-
公司債發行成本	32,658	-
其他	<u>661,974</u>	1
合計	<u>5,771,296</u>	4
稅前利益（附註二十二）	65,621,632	36
所得稅利益（附註二及十六）	<u>1,370,909</u>	1
綜合純益	<u>66,992,541</u>	37
其他股權純益（附註二十二）	<u>(1,886,347)</u>	(1)
合併純益	<u>\$65,106,194</u>	36
合併每股盈餘	<u>\$5.71</u>	
按普通股加權平均發行股數八十九年11,400,882 仟股計算		

後附之附註係本關係企業合併財務報表之一部分。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

關係企業合併財務報表附註

(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

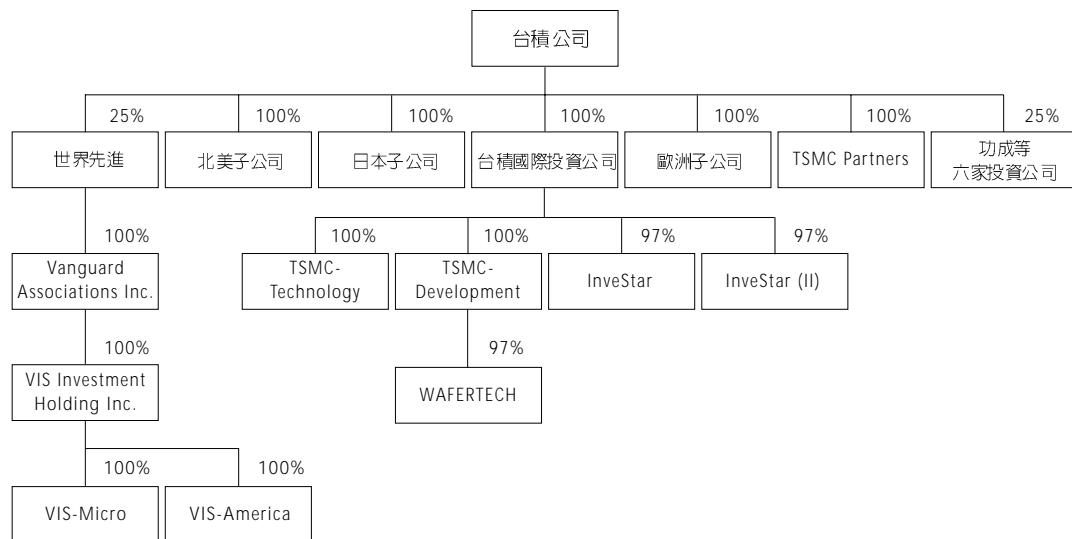
## (一) 公司沿革及業務

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司）係由行政院開發基金管理委員會及荷蘭商飛利浦電子股份有限公司（飛利浦公司）等共同投資設立。台積公司及其從屬公司世界先進積體電路公司（以下簡稱世界先進公司），主要業務為有關積體電路及其他半導體裝置之研發、製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計，暨光罩之製造及設計服務。台積公司股票於台灣證券交易所上市。八十六年十月八日起，台積公司部分已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。世界先進公司股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃。

台積公司以八十九年六月三十日為合併基準日，採取吸收合併方式合併德碁半導體公司（德碁公司）及世大積體電路公司（世大公司），以台積公司為存續公司，德碁公司及世大公司則分別因合併而解散。合併股份換發比例約三點九股德碁公司股份換發一股台積公司股份及二股世大公司股份換發一股台積公司股份，合計台積公司因此合併案而增發1,583,515仟股之普通股，其權利義務與台積公司原已發行股份相同。

台積公司之其他從屬公司包括於英屬維京群島設立之台積國際投資公司、台灣積體電路製造（北美）公司（北美子公司）、台灣積體電路製造（歐洲）公司（歐洲子公司）、台灣積體電路製造（日本）公司（日本子公司）、TSMC Partners 及功成、積成、啓信、欣瑞、承暉、柏成等六家投資公司。

截至八十九年底止，台積公司與從屬公司之控制關係及持股比例如下列圖表：



北美、歐洲及日本子公司主要係從事市場暨技術服務業務，TSMC Partners 及功成等六家公司主要係從事一般投資業務，台積國際投資公司及其子公司則以從事經營半導體設計、製造及相關業務之投資。WAFERTECH,LLC 係晶圓代工廠。世界先進公司之從屬公司主要係從事行銷、研發及一般投資業務。

## (二) 重要會計政策之彙總說明

關係企業合併財務報表編製準則

編製關係企業合併財務報表時，控制與從屬公司間重大之交易及其餘額，業已全數銷除。台積公司八十九年度關係企業合併財務報表編製之主體中，世界先進公司（持有股權百分之二十五）及功成等六家投資公司係屬實質控制關係，餘則為持股超過百分之五十之持股控制關係（本年度新增台積國際公司投資公司之子公司—InveStar Semiconductor Development Fund (II)）。

世界先進公司之從屬公司Vanguard Associates Inc. 及其子公司之總資產及營業收入皆未達台積公司各該項金額百分之十，因是皆未編入八十九年度關係企業合併財務報表。另八十八年度之從屬公司—德碁公司如附註一所述已與台積公司合併而解散，故已包含於本合併財務報表中。

其他公司持有上述從屬公司之股份，列於其他股權項下。

#### 約當現金

約當現金係指自投資日起三個月內到期之附買回條件政府公債。

#### 短期投資

短期投資係按成本與市價孰低計價。出售成本則採個別辨認。

#### 備抵呆帳

係按應收款項收回之可能性評估認列。

#### 銷貨收入及備抵退貨及折讓

銷貨收入係於貨物移轉時認列，備抵退貨及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售年度列為銷貨之減項，相關銷貨成本則列為銷貨成本之減項。

#### 存貨

存貨係以成本與市價孰低計價。存貨平時按標準成本計價，結帳日時再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。

#### 長期投資

具有重大影響力之長期股權投資，係採用權益法計價；被投資公司發生純益（或純損）時，認列投資收益。非按原持股比例認購採權益法計價之被投資公司增發之新股，致使投資比例發生變動，因而使所投資之股權淨值發生增減者，其增減數調整「資本公積」及「長期投資」。

不具有重大影響力之長期股權投資，係按成本法計價。被投資公司發放現金股利時除投資當年度應貸記長期投資外，於當年度認列為股利收入。取得被投資公司發放之股票股利時，僅註記增加股數，不增加投資帳面價值，亦不認列投資收益。

長期投資為上市或上櫃公司股票者，則按成本與市價孰低評價，當投資帳面金額超過該股票市價時，則改按股票市價計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失列為股東權益之減項，若嗣後股票市價回升時，則應於已提列金額內予以沖回。投資於未上市上櫃公司之股票，當投資之價值確已減損且回復之希望甚小時，則調整其帳面價值，認列投資損失。

其他長期投資係投資海外基金，按成本與基金淨值孰低評價。當投資帳面金額超過該基金淨值時，則改按基金淨值計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失，列為股東權益之減項，若嗣後基金淨值回升時，則應於已提列金額內予以沖回。

可轉換債券及認購權證按成本計價。

股票出售時，其成本係按加權平均法計算。

採權益法計價時，被投資公司之當期損益中，若有出售固定資產盈餘者，則按減除所得稅後之淨額，於認列投資損益年度，按持股比例轉列資本公積，嗣後出售時，再按出售比例轉回保留盈餘。若被投資公司長期投資按成本與市價孰低評價所產生之長期投資未實現跌價損失，則按持股比例認列，並於資產負債表上列為股東權益之減項。

與按權益法計價之被投資公司間順流交易所產生之未實現利益按持股比例予以銷除；若對被投資公司具有控制能力者，則全數予以銷除，俟實現始認列利益。

與按權益法計價之被投資公司間逆流交易所產生之未實現利益，皆按投資公司之持股比例予以銷除。

#### 固定資產及出租資產

固定資產及出租資產係按成本減累積折舊計價。重大之增添、更新及改良列為資本支出，修理及維護支出，則列為當年度費用。固定資產於構建期間支出款項所負擔之利息予以資本化。租賃資產以最低租金給付額之現值總額及租賃資產在租賃開始日之公平市價孰低入帳，應付資本租賃款則按利息法在租賃期間分期攤銷。

折舊係以直線法按下列耐用年數計提：建築物，五至二十年；機器設備，五至十年；辦公及其他設備，二至七年。

固定資產報廢或出售時，其成本及相關之累積折舊均自帳上予以減除，出售及處分損益列為當年度損益。出售利益扣除有關所得稅後再於當年底轉列資本公積。

#### 合併借項

合併借項係原始投資成本與取得股權時被投資公司股權淨值間之差額及因併購所產生之商譽，採直線法分五年至十五年平均攤銷。

#### 遞延借項

遞延借項主要係專門技術，專利權、電腦軟體設計費用、公司債發行成本、應付短期票券發行成本及技術權利金及技術股作價等，分別按十、二至十年、三至五年、五至七年、票券發行期間及合約或經濟效益年限攤銷。

#### 員工退休金

按精算結果認列退休金費用，未認列過渡性淨給付義務及未認列退休金損益分別按二十五年攤提，未認列過渡性淨資產係按二十六年攤提。

#### 未實現售後收回利益

固定資產出售後再行收回時，其相關之出售資產損益予以遞延列為未實現售後收回損益，營業租賃按租賃期間，逐期攤銷為租金費用調整項目；資本租賃則按估計之使用年數或租賃期間，逐期攤銷為折舊費用調整項目。

#### 所得稅

所得稅之會計處理係作跨期間之所得稅分攤，即將可減除暫時性差異、未使用以前年度虧損扣抵及投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列相關備抵評價金額；而應課稅暫時性差異所產生之影響數認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期回轉期間之長短劃分為流動或非流動項目。

以前年度應付所得稅之調整，包含於當年度所得稅中。

未分配盈餘加徵百分之十之所得稅，列為股東會決議年度費用。

#### 衍生性金融商品交易

為規避外幣淨資產或淨負債匯率風險之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率衡量入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間攤銷，應收或應付遠期外匯年底餘額，再按年底之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履行結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

非以交易為目的之利率交換合約，於簽約日因無本金移轉，僅作備忘記錄，於約定結算日及資產負債表日就合約利率與市場實際利率所計得之應收或應付金額，作為避險資產或負債有關之利息收入或利息費用之調整。

非以交易為目的之外幣選擇權合約，於訂約日不認列資產或負債，因實際交割所產生之兌換差額，則列為當期損益。購買（或出售）外幣選擇權時，所支付（或取得）之權利金於合約期間平均攤銷，列為當期損益。

#### 以外幣為準之交易事項

非衍生性金融商品之外幣交易，係按交易當日匯率折算之新台幣金額入帳。外幣現金實際兌換成新台幣或外幣應收應付款以新台幣收付結清時，因適用不同匯率所產生之損失或盈益，列為兌換或結清年度之損益。

#### 外幣財務報表之換算

國外子公司之財務報表換算為新台幣表達時，資產及負債科目按資產負債表日匯率換算；股東權益按歷史匯率換算；損益科目則按當年度加權平均匯率換算。換算所產生之兌換差額，則列為股東權益項下之累積換算調整數。

#### 合併

台積公司合併德碁公司之會計處理係依照財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理」，並自八十九年七月一日起將其損益科目併入台積公司；另合併世大公司之會計處理則係依照「權益結合法」，其八十九年度之損益科目全數併入台積公司。

**(二) 關係企業間已沖銷之重大交易事項**

公司名稱	沖銷科目	金額	交易對象
台積公司	應付關係人款項	\$166,063	北美子公司
		66,343	歐洲子公司
		16,165	日本子公司
		1,487,181	WAFERTECH, LLC
		4,487	TSMC-Technology
		1,808,964	世界先進公司
	應收關係人款項	20,361	WAFERTECH, LLC
		25,728	TSMC-Technology
		159,890	世界先進公司
	銷貨收入	370,762	世大公司
		30,816	WAFERTECH, LLC
		17,012	世界先進公司
	進貨	13,296,633	WAFERTECH, LLC
		6,572,110	世界先進公司
	管理費用（權利金）	14,095	TSMC-Technology
	行銷費用（佣金）	994,686	北美子公司
	行銷費用（服務費）	118,852	北美子公司
	行銷費用（佣金）	143,461	歐洲子公司
	行銷費用（佣金）	165,087	日本子公司
	遞延收入	5,837	WAFERTECH, LLC
	處分固定資產利益	2,240	世界先進公司
	營業外收入	5,604	世界先進公司
世大公司	應收帳款	1,670	德碁公司
	應付帳款	768,677	德碁公司
台積國際投資公司	應收利息	128,594	TSMC-Technology
	應收票據	330,790	TSMC-Technology
	利息收入	24,181	TSMC-Technology
TSMC Partners	遞延收入	10,791,704	台積國際投資公司
	權利金收入	491,733	台積國際投資公司
	應收票據	11,313,018	台積國際投資公司
TSMC-Technology	遞延收入	40,962	WAFERTECH, LLC
	權利金收入	13,323	WAFERTECH, LLC
	銷貨收入	63,727	WAFERTECH, LLC
	應收款項	17,669	WAFERTECH, LLC

**(四) 現金及約當現金**

八十九年底

現金及銀行存款	\$43,194,039
附買回條件政府公債	1,523,967
	<u>\$44,718,006</u>

(五) 短期投資

	八十九年底
上市上櫃公司股票	\$1,502,098
開放型基金	<u>959,561</u>
	<u>2,461,659</u>
備抵跌價損失	<u>(110,099)</u>
	<u>\$2,351,560</u>

(六) 存貨

	八十九年底
製成品	\$2,174,015
在製品	11,468,169
原料	932,576
物料及零件	<u>1,681,850</u>
	<u>16,256,610</u>
備抵存貨損失	<u>(715,415)</u>
	<u>\$15,541,195</u>

(七) 長期投資

	八十九年底	帳列金額	持股比例%
<u>股票</u>			
按權益法計價			
VIS Associates Inc.	\$464,077	100	
SYSTEMS ON SILICON MANUFACTURING COMPANY PTE LTD. (SSMC )	<u>935,870</u>	<u>32</u>	
	<u>1,399,947</u>		
按成本法計價			
普通股			
台灣光罩公司 (上市公司)	32,129	2	
力晶半導體公司 (上櫃公司)	2,651,216	9	
鈺創科技公司 (上櫃公司)	310,132	3	
台宏半導體公司	500,000	19	
聯亞氣體工業公司	175,500	12	
台灣信越半導體公司	105,000	7	
普實創業投資公司	50,000	4	
宏通創業投資公司	120,000	10	
3Dfx Interactive	9,826	-	
Programmable Microelectronics	49,619	4	
Capella Microsystems	345	-	
Equator Technologies	2,978	-	
Global Test	183,896	10	
ChipStrate Technology	70,854	9	

(接次頁)

(承前頁)

Ritch Technology	\$10,338	9
Scenix Semiconductor	5,697	2
APE 富鼎先進	50,222	6
華新先進電子公司	414,481	10
米謹科技公司	177,000	15
Form Factor Inc.	64,360	1
	<u>4,983,593</u>	
特別股		
Empower Tel Networks	169,634	7
Sonics	116,752	7
LightSpeed Semiconductor	101,368	6
Equator Technologies	93,908	2
Memsic	82,689	24
Tropian, Inc. (Premier R.F.)	77,209	5
Lara Networks, Inc.	75,151	7
RapidStream	69,708	6
Integrated Memory Logic	59,845	10
Divio	16,540	4
SiRF Technology	44,105	1
Rise Technology	49,619	2
Capella Microsystems	42,949	8
Sensory	41,349	6
Scenix Semiconductor	45,023	2
Pico Turbo	41,349	9
NanoAmp Solutions	61,281	3
T-Span System	45,829	3
Monolithic Power System	66,158	17
Formfactor	66,158	1
Reflectivity	66,158	6
Signia	49,619	22
Match Lab	49,619	11
HINT Corporation	33,079	5
Creosys	49,619	8
Incentia Design Systems	16,539	2
Seagull Semiconductor	41,349	14
OEpic	24,809	-
FabCentric	8,270	-
	<u>1,705,685</u>	
可轉換債券		
Rise	9,924	-
FabCentric	8,270	-
Signia Technologies	16,540	-
Advanced Analogic Technology	41,349	-
	<u>76,083</u>	

(接次頁)

(承前頁)

基金

Crimson Asia Capital  
Horizon Ventures

\$64,547

93,304

157,851

8,323,159

累積換算調整數

(13,376)

\$8,309,783

按權益法計價之長期投資損失金額，係按同期間經會計師查核之財務報表認列如下：

八十九年度

VIS Associate	\$325,227
SSMC	473,661
德基公司	311,330
	<u>\$1,110,218</u>

長期投資有關股票市價及淨值之資料如下：

八十九年底

上市上櫃公司股票市價	\$3,681,280
未上市上櫃按普通股持股比例之淨值	7,506,791
基金淨值	157,851

**(八) 固定資產**

累積折舊如下：

八十九年底

土地改良	\$64,006
建築物	13,542,134
機器設備	109,889,527
辦公及其他設備	2,781,787
	<u>\$126,277,454</u>

截至八十九年底止，擴建積體電路廠房及設備計畫如下：

擴廠計劃名稱	預計投資金額	累積支出金額	預訂生產年月
台積公司積體電路第六廠	\$76,889,000	\$67,565,100	89.03
台積公司積體電路第七廠	22,540,400	11,121,100	90.03
台積公司積體電路第八廠	28,314,300	15,217,800	90.03
台積公司積體電路第十二廠	38,280,800	21,372,000	90.11
台積公司積體電路第十四廠	9,711,000	7,946,600	91.05
世界先進公司積體電路第二廠	6,912,000	260,448	92.01

八十九年度利息資本化金額為614,817仟元。

#### (九) 遲延借項 - 淨額

八十九年底

電腦軟體設計費	\$1,550,539
技術權利金	2,172,095
專利權	675,302
技術股作價	157,500
公司債發行費用	150,795
其他	172,357
	<u>\$4,878,588</u>

#### (十) 短期借款

八十九年底

短期購料借款 - 美金24,098 仟元，九十年一月至六月間陸續到期，年利率為7.13%~7.48%	\$797,137
抵押擔保借款 - 九十年十月到期，年利率為5.80%	329,375
抵押及信用借款 - 美金105,942 仟元，九十年十二月陸續到期，年利率7.53%~9.25%	3,504,466
	<u>\$4,630,978</u>

截至八十九年底止，尚未使用之短期借款額度為8,079,625 仟元及美金41,000 仟元。

#### (十一) 應付租賃款

八十九年底

九十年六月至九十二年底陸續到期	\$54,371
一年內到期部分	(51,055)
	<u>\$3,316</u>

#### (十二) 長期借款

八十九年底

抵押及信用借款 - 美金705,564 仟元，於九十四年三月前還清，年利率為6.91%~7.663%	\$23,339,367
購置廠房及自動化機器借款 - 自八十八年十一月起，每半年為一期償還，至九十三年六月還清， 浮動利率，年利率八十九年為6.35%	5,460,000
購置自動化機器借款 - 自八十九年十月起，每半年為一期償還，至九十四年十月還清， 年利率為6.42%	3,640,000
購置自動化機器借款 - 自八九年二月起，每半年為一期償還，至九十四年二月還清， 年利率為6.505%~6.765%	328,000
購置自動化機器借款 - 自八十八年七月起，每半年為一期償還，至九十三年七月還清， 年利率為6.63%~6.765%	292,000
購置自動化機器借款 - 自八十七年二月起，每半年為一期償還，至九十二年二月還清， 年利率為6.755%~6.765%	184,000
購置自動化機器借款 - 自八十六年五月起，每半年為一期償還，至九十一年五月還清， 年利率為6.755%~6.765%	112,000

(接次頁)

(承前頁)

購置自動化機器借款－自九十二年一月起，每季為一期償還，至九十六年七月還清， 年利率為6.755%~6.765%	\$330,000
	<u>33,685,367</u>
一年內到期部分	<u>(2,568,000)</u>
	<u>\$31,117,367</u>

上述長期借款（外幣借款除外）及附註十三中世界先進公司發行之公司債及聯貸案，皆受有流動比例、負債比例及自有資產比例之限制。截至八十九年底止，世界先進公司財務比例均符合前述之規定。

截至八十九年底止，尚未使用之長期借款額度為70,000仟元及美金62,436仟元。

### **(十三) 應付公司債**

台積公司於八十七年三月四日發行國內第一次無擔保普通公司債，發行總額4,000,000仟元，票面年利率7.71%，每半年付息一次，至九十二年三月四日到期一次償還。

台積公司分別於八十七年十一月十八日至十二月一日間分次發行國內第二次無擔保普通公司債，面額總計6,000,000仟元，票面利率皆為7.12%，每年付息一次，分別於九十二年十一月底前到期，到期一次償還，債券持有人得於本公司債發行日後屆滿第二年及第三年之日前三十日，要求台積公司於本公司債屆滿第二年或第三年之日，以債券面額加計當期應計利息後，行使債券賣回權；台積公司亦可依上述條件行使債券賣回權。台積公司已於八十九年十一月提前贖回第二次無擔保普通公司債。

台積公司於八十八年十月二十一日發行國內第三次無擔保普通公司債，發行總額10,000,000仟元，分為甲、乙兩類，票面利率分別為5.67%及5.95%，均為每年付息一次，分別於九十一年十月二十一日及九十三年十月二十一日到期一次償還。

台積公司於八十九年十二月四日至十五日間分次發行國內第四次無擔保普通公司債，發行總額15,000,000仟元，分為甲、乙兩類。票面利率分別為5.25%及5.36%，均為每年付息一次，分別於九十四年十二月及九十六年十二月到期一次償還。

世界先進公司由金融機構保證發行普通公司債，發行總額2,250,000仟元，年利率6.59%，自八十九年十一月六日起，每年為一期償還，至九十二年十一月六日還清。一年內到期部分為750,000仟元。

### **(十四) 股東權益**

依據公司法之規定，資本公積只能用於彌補虧損或撥充股本。

依據台積公司章程規定，每年度純益於彌補虧損後，應分配如下：

- 1 先提撥百分之十為法定公積；
- 2 次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積；
- 3 次提其餘額百分之一為董事事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利；
- 4 次則優先發放甲種特別股股息，股息訂為年率3.5%，按當年度實際發行日數計算；
- 5 剩餘部分依股東會決議分派之。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認，並於該年度入帳。

台積公司於民國八十九年十一月二十九日發行不得上市之甲種特別股1,300,000仟股，其權利義務如下：

- 1 股息為年率3.5%，累積且優先於普通股分派。
- 2 不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
- 3 對於剩餘財產權之求償權優先於普通股，但以不超過發行金額為限。
- 4 於股東會與普通股股東有相同之表決權。
- 5 發行期限為二年六個月且不得轉換為普通股。屆至期限未收回者，其權利義務得以延續至收回為止。

依世界先進公司章程規定，每年度決算如有盈餘先彌補虧損並依法繳納營利事業所得稅後，應先提列百分之十為法定公積，餘額依下列順序分配：

- 1 視需要提撥特別公積；
- 2 百分之一為董事、監察人酬勞；
- 3 不低於百分之一為員工紅利；
- 4 其餘依股東會決議分派之。

依公司法之規定，法定公積應繼續提撥至其總額達股本總額為止。法定公積得用以彌補虧損；且當該項公積已達實收股本百分之五十時，亦得以其半數撥充股本。

台積公司分配盈餘時，必須依法令規定就八十八年度（及以前年度）發生之股東權益減項提列特別盈餘公積1,091,003仟元後，方得以分配，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉金額分配盈餘。

該等公司若分配屬於八十六年度（含）以前未分配盈餘時，各該公司股東將不獲配股東可扣抵稅額。若分配屬於八十七年度（含）以後未分配盈餘時，除屬非中華民國境內居住者之股東外，其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣抵稅額。

#### **(十五) 員工退休金**

台積公司及其從屬公司對正式員工訂有退休辦法。依該等辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休時之平均薪資計算。台積公司及其從屬公司每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶。另世界先進公司依薪資總額百分之六提列應計退休金負債。

退休金相關資訊揭露如下：

淨退休金成本為：

	八十九年度
服務成本	\$434,590
利息成本	104,711
退休基金資產預期報酬	(32,397)
攤銷數	5,594
淨退休金成本	<u>\$512,498</u>

退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債之調節如下：

	八十九年底
給付義務	
既得給付義務	\$-
非既得給付義務	830,688
累積給付義務	830,688
未來薪資增加之影響數	1,703,596
預計給付義務	2,534,284
退休基金資產公平價值	(760,627)
提撥狀況	1,773,657
未認列前期服務成本	-
未認列過渡性淨資產	7,511
未認列過渡性淨給付義務	(165,991)
未認列退休金收益	157,189
補列之退休金負債	-
應計退休金負債	<u>\$1,772,366</u>

(接次頁)

(承前頁)

退休金給付義務及計算退休金成本之假設為：

折現率	6%
未來薪資水準增加率	6%
退休基金資產預期投資報酬率	6%

退休金提撥及支付情況：

本期提撥	\$114,417
吸收合併轉入	\$173,339
本期支付	\$1,458

#### (十六) 所得稅

1 列稅前利益按法定稅率計算之所得稅與當期應負擔所得稅費用調節如下：

	八十九年度
稅前利益按法定稅率計算之稅額	(\$13,261,804)
所得稅調整項目之稅額影響數：	
免稅所得	7,902,733
暫時性差異	(176,027)
永久性差異	43,995
未分配盈餘加徵	(88,024)
當年度應負擔所得稅費用	<u>(\$5,579,127)</u>

2 所得稅利益構成項目如下：

	八十九年度
當年度應負擔所得稅費用	(\$5,579,127)
所得稅抵減	<u>5,551,970</u>
本期應付	<u>(27,157)</u>
遞延所得稅資產淨變動	
- 投資抵減	3,151,627
- 虧損扣抵	43,800
- 暫時性差異	(234,704)
- 其他	(73,559)
遞延所得稅備抵評價調整數	(1,678,791)
以前年度所得稅調整	<u>189,693</u>
	<u>\$1,370,909</u>

3 遞延所得稅資產（負債）明細如下：

	八十九年底
流動	
投資抵減	\$9,139,156
虧損扣抵	67,478
應計負債及其他	<u>56,016</u>
	<u>9,262,650</u>
備抵評價金額	(585,187)
	<u>\$8,677,463</u>

(接次頁)

(承前頁)

非流動

投資抵減	\$14,086,176
虧損扣抵	1,821,125
利息費用	45,008
折舊	(56,033)
遞延收入	46,077
其他	(589,858)
	<u>15,352,495</u>
備抵評價金額	(6,725,138)
淨額	<u>\$8,627,357</u>

4 兩稅合一相關資訊：

八十九年底

可扣抵稅額帳戶餘額

台積公司	\$5,888
世界先進公司	<u>\$610</u>

八十九年底（預計）

稅額扣抵比率

台積公司	0.009%
世界先進公司	7.18%

由於得分配予股東之可扣抵稅額，應以股利益餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為計算基礎，因是八十九年底預計盈餘分配之稅額扣抵比率可能會因依所得稅法規定預計可能產生之各項可扣抵稅額與實際不同而須調整。

台積公司八十九年底中屬於八十六年度（含）以前之未分配盈餘分別為4,827仟元。

台積公司及其從屬公司八十九年底用以計算遞延所得稅之有效稅率分別約7.54%及20%~40%。

截至八十九年底止，未使用之虧損扣抵及投資抵減之有效期限如下：

到期年度	虧損扣抵金額	投資抵減金額
九十	\$337,390	\$4,732,617
九十一	1,030,365	5,468,790
九十二	5,694,914	6,266,645
九十三	2,380,345	6,757,280
	<u>\$9,443,014</u>	<u>\$23,225,332</u>

截至八十九年底止，台積公司及其從屬公司各次增資擴展可享受四年免稅如下：

增資擴展案	免稅期間
台積一廠、二廠第一、二生產單位及三廠擴建、新增四廠	八十六年至八十九年度
台積一廠、二廠第一、二生產單位、三廠及四廠擴建、新增五廠	八十八年至九十一年度
世界先進公司原始投資免徵所得稅	八十四年至八十九年
世界先進公司第一次增資擴展免徵所得稅	八十九年至九十二年
德碁公司第一次增資擴展免徵所得稅	八十七年至九十年

台積公司截至八十五年度、德碁公司、世大公司及世界先進公司截至八十六年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。另德碁公司不服八十四年、八十五年及八十六年度所得稅之核定結果，已提起行政救濟程序，目前正在複查中。

### (十七) 關係人交易

除已於財務報表及其他附註中揭露者外，重大之關係人交易及餘額彙總如下：

#### 1 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與公司之關係
工研院台積公司及世界先進公司之董事長為工研院之董事	
飛利浦公司	台積公司之主要股東之一
SYSTEMS ON SILICON MANUFACTURING COMPANY PTE LTD (SSMC)	台積公司之被投資公司
VIS America	世界先進公司之被投資公司 (VIS Associates Inc.) 之子公司
VIS Micro	世界先進公司之被投資公司 (VIS Associates Inc.) 之子公司
華新麗華公司	世界先進公司之董事
力晶半導體公司	世界先進公司依成本法評價之被投資公司
華新先進電子公司	世界先進公司依成本法評價之被投資公司

#### 2 關係人交易

	八十九年	
	金額	百分比
<b>全年度</b>		
銷貨收入		
工研院	\$198,146	-
飛利浦及其聯屬公司	<u>5,289,927</u>	3
力晶半導體公司	<u>162</u>	-
	<u>\$5,488,235</u>	<u>3</u>
進貨		
力晶半導體公司	<u>\$379,405</u>	<u>1</u>
租金費用		
工研院	<u>\$161,575</u>	<u>14</u>
製造費用		
飛利浦公司	\$2,137,175	3
華新先進電子公司	<u>403,245</u>	1
華新麗華公司	<u>1,893</u>	-
力晶半導體公司	<u>1,722</u>	-
工研院	<u>23,905</u>	-
	<u>\$2,567,940</u>	<u>4</u>
管理費用		
工研院	<u>\$14</u>	-
行銷費用		
VIS Micro	\$26,604	12
工研院	<u>95</u>	-
	<u>\$26,699</u>	<u>12</u>

(接次頁)

(承前頁)

研究發展費用		
力晶半導體公司	\$9,082	-
VIS America	5,706	-
工研院	28	-
	<u>\$14,816</u>	<u>-</u>
購買固定資產		
華新麗華公司	\$1,303	-
VIS America	3,340	-
	<u>\$4,643</u>	<u>-</u>
營業外收入		
SSMC	\$152,347	3
力晶半導體公司	255	-
其他	38	-
	<u>\$152,640</u>	<u>3</u>
<u>年底餘額</u>		
應收關係人款項		
工研院	\$56,078	7
飛利浦及其聯屬公司	643,604	82
SSMC	89,154	11
	<u>\$788,836</u>	<u>100</u>
預付費用及其他流動資產		
VIS America	\$1,232	-
預付租金—工研院	42,664	1
	<u>\$43,896</u>	<u>1</u>
應付關係人款項		
飛利浦及其聯屬公司	\$797,375	83
華新先進電子公司	118,754	12
工研院	21,192	3
力晶半導體公司	18,419	2
VIS Micro	2,365	-
	<u>\$958,105</u>	<u>100</u>

上列與關係人交易之價格及收付款條件除技術服務係依合約規定及世界先進公司委託美國VIS America 及VIS Micro 從事部分產品之研究發展及銷售，約定按其實際支出金額加計百分之五支付相關費用外，餘均與非關係人相當。其中與VIS America 之研究合約已於八九年一月終止。

(十八) 重大長期租賃

台積公司積體電路第一廠之土地、廠房及部分機器設備係向工業技術研究院（工研院）承租，至九十年三月底止。目前年租金為170,656 仟元（含服務費及管理費），租約到期時雙方可協議續約。

台積公司積體電路第二廠至第十四廠之土地係向科學工業園區管理局承租，租期分別於九十七年三月至一〇八年十一月到期。租金每年共計172,000 仟元，到期時可再續約。

世界先進公司積體電路廠及綠地停車場之土地係向新竹科學工業園區管理局承租，租期分別於九十九年四月、一〇四年六月及一〇七年三月陸續到期。目前租金每年合計45,677 仟元，惟科學工業園區管理局得依規定調整租金，租約到期時可再續約。

另世界先進公司向美商翰迪克公司以營業租賃方式承租若干機器設備，分別於九十年九月、九十年六月及九十年十一月、十二月陸續到期。目前每年租金為292,540 仟元（美金8,263 仟元及新台幣19,200 仟元）。

北美子公司之辦公室及部分設備及歐洲子公司辦公室係向他人承租，租約將分別於一〇九年九月及九十三年到期，目前年租金合計約57,379仟元。

前述租約未來五年及以後年度之租金如下：

年度	金額
九十	\$772,009
九十一	,317
九十二	314,064
九十三	316,793
九十四	314,745
九十五至一〇九	2,429,353
	<u>\$4,755,281</u>

#### (十九) 抵質押之資產

下列資產係作長短期借款、遠期外匯操作、信用狀、設質海關、外勞保證及關稅記帳保證之擔保品。

	八十九年底
質押定期存款	\$10,000
短期投資	937,428
固定資產－淨額	16,389,623
	<u>\$17,337,051</u>

除上列抵押資產外，WAFERTECH, LLC 之全部資產（帳列金額共計美金1,243,996仟元）業已提供作為其長期借款之擔保品。

#### (二十) 承諾事項

截至八十九年底止，重大承諾事項如下：

- 1 台積公司與飛利浦公司簽訂技術合作合約，自七十七年一月一日起，按約定產品銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金。合約有效期間為十年；除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。台積公司已於八十六年五月十二日與飛利浦公司修訂上述合約，自八十六年七月九日起生效，合約延展十年，並於到期後自動展期，每次三年。依據上述修訂合約之規定，自修訂合約生效滿五年後，台積公司若須支付權利金予任何第三人，該金額可自應支付予飛利浦公司之技術報酬金中扣除，惟每年應支付之技術報酬金仍不得低於特定比例。
- 2 台積公司於符合特定股權條件，承諾飛利浦及其聯屬公司每年得預訂台積公司最高達百分之三十之產能，惟應於合理期間前通知。
- 3 台積公司與工研院簽訂次微米技術授權契約，於五年內支付授權費129,400仟元（含5%加值型營業稅，業已全數支付），並按約定產品銷貨收入淨額之一定百分比支付權利金至八十七年底止，合約有效期間至八十九年十二月三十一日止。另與工研院簽訂技術合作契約，台積公司應於契約有效期限內提供經濟部及其指定對象最高達35%之產能。
- 4 台積公司與若干主要客戶簽訂晶圓代工相關合約，依合約之規定台積公司以預收保證金之方式保留一定產能予該等客戶。截至八十九年底止，該等存入保證金計美金213,865仟元。
- 5 台積公司與飛利浦公司及新加坡經濟發展局於八十八年三月三十日簽訂合資協議書。依該協議書約定，由三方共同出資約十二億新加坡幣於新加坡設立晶圓代工廠”Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd” (“SSMC”)，其中台積公司持有股份百分之三十二。依約定飛利浦公司與台積公司有義務購買特定比例之SSMC產能，若任一方無法購足承諾之產能且SSMC產能使用率低於一定比例時，應賠償SSMC相關成本損失。
- 6 台積公司與SSMC於八十八年五月十二日簽訂技術合作合約，依合約規定SSMC應按其銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金予台積公司，合約有效期間為十年，除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。
- 7 台積公司與National Semiconductor Corporation (“National”) 於八十九年六月二十七日簽訂技術移轉契約。依該契約

約定，National 應給付技術授權費予台積公司。合約有效期間為十年，除非任一方於特定條件下提前終止本契約，本契約於到期後自動展期，每次二年。

- 8 世界先進公司與工研院於八十四年八月二十三日簽訂次微米技術授權契約，本契約產品自八十三年十一月十一日開始商業性銷售之日起五年內，按約定產品售價之一定百分比支付權利金。
- 9 世界先進公司與美商台灣朗訊科技公司（原美國電話電報公司）於八十五年七月八日簽訂修正之專利權授權合約，自八十五年一月一日起，連續五年應按使用該特定技術之約定產品售價之一定百分比支付權利金。
- 10 世界先進公司於八十六年六月十二日與美國德州儀器公司簽訂專利權授權合約，自八六年一月一日起連續十年應按使用該特定技術之約定產品售價之一定百分比支付權利金。
- 11 世界先進公司於八十六年五月二十三日與日本HITACHI 公司簽訂專利權授權合約，應自合約簽訂之日起五年內每半年支付一定金額之授權費。
- 12 世界先進公司於八十七年一月二十七日與美商台灣朗訊科技公司簽訂技術授權契約，並需支付一定金額之簽約金予朗訊科技公司，本契約產品自開始商業性銷售之日起二年内，按約定產品售價之一定百分比支付權利金。
- 13 世界先進公司於八十七年一月二十七日與美商台灣朗訊科技公司簽訂專利權授權合約，應自合約簽訂之日起三年內分三期支付一定金額之授權費，並自合約生效日起連續三年應按使用該特定技術之約定產品售價之一定百分比支付權利金。
- 14 世界先進公司於八十八年二月二十六日與NEC Corporation 簽訂專利權授權合約，自簽約日起至九十二年止分六次支付一定金額之權利金。
- 15 世界先進公司於八十八年八月二十五日與MITSUBISHI 簽訂技術授權合約，世界先進公司應負擔一定金額之技術授權費。並自簽約日起連續五年按使用該特定技術之約定產品售價之一定百分比支付權利金。
- 16 InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. 及InveStar Semiconductor Development Fund (II), Inc. 與位於開曼群島之InveStar Capital Inc. 簽訂投資管理顧問合約，每年以約定之該公司加權平均股本及資本公積之2% 計算按季支付管理費。
- 17 某些建商控告因WAFERTECH,LLC 之影響，導致建廠過程中需額外花費較多的材料及人工成本，因此向WAFERTECH,LLC 求償。基於保守原則，WAFERTECH,LLC 已估列損失美金16,000 仟元，並已與其中一建商達成協議，已於八九年實際支付美金10,750 仟元，並預計於九十年度支付美金5,250 仟元。
- 18 WAFERTECH,LLC 自八十五年起實施員工認股計劃，並於八六年修正。依修正後之辦法，WAFERTECH,LLC 得授與主管、主要員工及非員工之董事認股權。認股權之使用期限依認購日而定，但一般而言，其可使用期限為認購日起一、二、三或四年，員工每年可累積行使四分之一認股權。本計劃共計發行15,150,000 單位認股權，約佔WAFERTECH,LLC 股權比例之6 % 。

認股計劃之資料彙總如下：

	流通在外認股權		
	可授與之 認股權	已授與之 認股權數	行使價格 (美金元)
年初餘額	4,154,597	8,226,080	\$0.78
額外核准之認股權	1,650,000	-	-
已授與之認股權			
認購價格高於市價	(3,203,302)	3,203,302	1.86
行使之認股權	-	(3,411,867)	0.74
取消之認股權	1,180,871	(1,180,871)	1.09
年底餘額	<u>3,782,166</u>	<u>6,836,644</u>	1.23

上述已授與之認股權將於九十五年五月至九十九年十二月到期。

- 19 WAFERTECH, LLC 經當地稅務機關核定應補繳當地稅捐美金8,800 仟元，WAFERTECH, LLC 不服其核定，除依法提起救濟外，並採保守原則暫將該稅捐估列入帳。
- 20 北美子公司自八十九年十二月起實施員工股票增值權計劃，依該計劃，員工可依各行使期間期末之台積公司股票市價與行使價格之差額，獲取現金紅利，截至八十九年底，北美子公司尚未認列任何有關之薪資費用或負債。
- 21 台積公司為TSMC Development, Inc. 及北美子公司之融資美金268,000 仟元及40,000 仟元提供背書保證。
- 22 台積公司及其從屬公司於八十九年底已開立未使用之信用狀金額約為新台幣250,338 仟元、美金6,494 仟元、日幣376,170 仟元及歐元175 仟元。

## (二十一) 其他附註揭露之事項

(一) 重大交易事項及(二) 轉投資相關資訊：

- 1 資金貸與他人。(附表一)
- 2 為他人背書保證。(附表二)
- 3 期末持有有價證券情形。(附表三)
- 4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表四)
- 5 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表五)
- 6 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 7 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表六)
- 8 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表七)
- 9 被投資公司名稱、所在地區....等相關資訊。(附表八)
- 10 從事衍生性金融商品交易：

台積公司及其從屬公司八十九年度從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率及利率波動所產生之風險，避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的，均屬非以交易為目的之避險活動，茲將有關資訊揭露如下：

(1) 遠期外匯買賣合約：

截至八十九年底止，尚未到期之遠期外匯買賣合約金額如下：

幣別	合約金額 (仟元)	公平價值 (仟元)	到期日	到期值 (仟元)
<u>八十九年底</u>				
買入遠期外匯 美金	USD 60,000	NTD 1,978,998	90.01	NTD 1,989,006
買入遠期外匯 歐元	EUR 28,968	USD 27,080	90.01~09	USD 26,823
買入遠期外匯 日幣	JPY 42,772	USD 374	90.01	USD 374
賣出遠期外匯 美金	USD 106,993	NTD 3,582,959	90.01~02	NTD 3,553,080
賣出遠期外匯 美金	USD 156,875	NTD 5,100,386	90.01	NTD 5,091,560
賣出遠期外匯 美金	USD 365,000	NTD 12,105,459	90.01~12	NTD 12,032,465
賣出遠期外匯 美金	USD 43,000	NTD 1,413,083	90.01~03	NTD 1,407,809

八十九年底因遠期外匯買賣合約所產生之應收款項為119,227仟元（帳列其他流動資產）、應付款項為192,677仟元（帳列其他流動負債）。八十九年度認列之兌換淨益為198,035仟元。

上述遠期外匯合約係為規避下列淨資產或淨負債之匯率變動風險。

單位：仟元

淨資產或淨負債	八十九年底
應收帳款	USD 868,522
應付帳款及應付工程及設備款	USD 571,332
	JPY 21,237,708
	EUR 62,480

(2) 利率交換合約

台積公司與數家銀行簽訂利率交換合約，以固定區間利率換取浮動利率，用以規避長期借款採浮動利率計息產生之利率變動風險，八十九年度產生之利息支出為113,683仟元。截至八十九年底止，簽訂之利率交換合約彙總如下：

合約簽訂日	期間	合約金額 (仟元)
87年04月28日	87年05月21日~92年05月21日	NTD 2,000,000
87年04月29日	87年05月21日~92年05月21日	NTD 1,000,000
87年06月26日	87年06月26日~92年06月26日	NTD 1,000,000
87年06月26日	87年07月06日~92年07月06日	NTD 1,000,000

(3) 外幣選擇權合約

台積公司八十九年度因預期將自外銷銷貨取得美金收入或外購機器設備以日幣支應，故與銀行簽訂外幣選擇權合約，以規避外幣匯率波動所可能造成之不利影響。

截至八九年底止，尚未到期之外幣選擇權合約彙總如下：

類別	交易	選擇權	合約金額(仟元)	帳面價值	公平價值	執行價格	到期日
歐式	出售	賣權	EUR 525,537	\$-	(\$189,735)	0.8870~0.9680 (美元兌歐元)	90.05
歐式	出售	買權	USD 203,500	-	(264,885)	107.77~110.5 (美元兌日幣)	90.03
歐式	出售	買權	USD 20,000	-	(1,485)	32.42 (美元兌台幣)	90.01
歐式	買入	賣權	USD 15,000	-	37	110~110.5 (美元兌日幣)	90.02

八九年度認列之權利金收入為116,248仟元；權利金支出為108,133仟元。

(4) 交易風險

- a 信用風險—交易對象皆為國內外信用良好之金融機構，預期不致產生重大信用風險。
- b 市場價格風險—從事衍生性金融商品交易即在規避外幣淨資產或淨負債及外幣承諾因匯率或利率波動所產生之風險，因是匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷；而規避外幣承諾產生之遞延兌換損益，將調整被避險項目之交易價格；另利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場價格風險並不重大。
- c 流動性風險及現金流量風險—從事遠期外匯及外幣選擇權交易即在規避淨資產或淨負債及外幣承諾之匯率變動風險，因到期時有相對之現金流入或流出，且考慮未來營運資金足以支應，而利率交換合約之利率亦已考量本公司未來資金成本所訂定，故無籌資風險。因遠期外匯合約、外幣選擇權合約、及利率交換合約之利率皆已確定，不致有重大之現金流量風險。

(5) 金融性商品之公平價值

八九年底		
	帳面價值	公平價值
<u>非衍生性金融商品</u>		
<u>資產</u>		
現金及約當現金	\$44,718,006	\$44,718,006
質押定存	10,000	10,000
短期投資	2,351,560	2,351,560
應收關係人款項	788,836	788,836
應收票據及帳款	28,586,108	28,586,108
長期投資	8,309,783	11,345,922
存出保證金	41,410	41,410
<u>負債</u>		
短期借款	4,630,978	4,630,978
應付關係人款項	958,105	958,105
應付帳款	9,528,743	9,528,743
應付工程及設備款	26,107,865	26,107,865
長期負債（含一年內到期部分）	34,489,738	34,489,738
應付公司債	30,500,000	30,500,000
存入保證金	7,086,429	7,086,429
<u>衍生性金融商品</u>		
買入遠期外匯	2,820,220	2,887,126
賣出遠期外匯	22,224,708	22,201,887
利率交換合約	1,601	234,017
選擇權合約	-	(456,068)

估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- a 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平市價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
- b 短期投資係以市場價格為公平價值。
- c 長期投資市上櫃公司者，以其市場價格為公平價值；投資於非上市上櫃公司及其他長期投資者，以資產負債表日之淨值作為估計其公平價值之基礎。
- d 存出（入）保證金之未來收現（支付）金額與帳面金額相近，故以帳面價值為公平價值。
- e 長期負債以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以所能獲得類似條件之長期負債利率為準。長期負債利率除公司債外，均屬浮動利率，其帳面價值即為公平市價，故僅評估公司債之折現值。
- f 台積公司及其從屬公司係以銀行報價所顯示之外匯換匯匯率及利率，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率及利率交換合約分別計算個別合約之公平價值。

因部分金融商品及非金融商品無須列示其公平價值，是以上表所列公平價值總數並不代表台積公司及其從屬公司之總價值。

#### (二十二) 部門別資訊

##### 1 地區別資訊如下：

八十九年度	北美洲及其他	國內	調整及沖銷	合併
來自母公司及合併子公司以外客戶之收入	\$ -	\$178,929,916	(\$17,012)	\$178,912,904
來自母公司及合併子公司之收入	14,451,231	6,644,266	(21,095,497)	-
收入合計	<u>\$14,451,231</u>	<u>\$185,574,182</u>	<u>(\$21,112,509)</u>	<u>\$178,912,904</u>
部門損益	<u>\$3,970,099</u>	<u>\$78,336,085</u>	<u>(\$1,219,730)</u>	<u>\$81,086,454</u>
營業費用				(16,693,414)
營業外收入				6,999,888
營業外費用				(5,771,296)
稅前利益				\$65,621,632
其他股權純益				\$1,886,347
可辨認資產	<u>\$64,659,712</u>	<u>\$354,919,052</u>	<u>(\$25,844,792)</u>	<u>\$393,733,972</u>
長期投資				8,309,783
資產合計				<u>\$402,043,755</u>

##### 2 外銷貨資訊

外銷貨明細如下：

地區	八十九年度
美洲	\$84,606,754
亞洲	44,921,269
歐洲	12,596,580
	<u>\$142,124,603</u>

外銷貨資訊係以收款區為計算基礎

##### 3 重要客戶資訊

佔合併銷貨收入百分之十以上之客戶：無。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

資金貸與他人

民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表一

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象 資金貸與限額 (美金為仟元)	本期最高餘額 (美金為仟元)	期末餘額 (美金為仟元)	利率區間	資金貸 與原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品	業務往 來金額	資金貸與最 高限額
										名稱		
2	世界先進公司	VIS America	預付費用	(註一)	\$6,122	\$1,232	-	預付委託 開發設計費	\$-	-	\$5,706	\$4,400,000 (註二)

註一： 貸放資金予個別對象不得超過公司實收資本額之10%，並限於借款人實收資本額之30%以內。

註二： 貸放資金總額不得超過公司實收資本額之20%。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

為他人背書保證

民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象 公司名稱 (註二)	對單一企業背書保證之限額 關係	本期最高背書 保證餘額 (美金為仟元)	期末背書 保證餘額 (美金為仟元)	以財產擔保 之背書保證 金額	累計背書保 證金額佔最 近期財務報 表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註一)
0	台灣積體 電路公司	TSMC Develop- ment Inc.	3 不超過本公司實收資本額之 10%，唯以該被背書保證	\$8,865,172 (USD268,000)	\$8,865,172 (USD268,000)	\$8,865,172	3.39%	\$38,968,094
	台灣積體電路 (北美)公司		2 公司之實收資本額為限；倘 經董事會核准，則不受單一 企業背書保證之限制。	1,323,160 (USD40,000)	1,323,160 (USD40,000)	1,323,160	0.51%	

註一： 本公司實收資本額百分之三十。

註二： 2係直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

3係母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

期末持有有價證券情形  
民國八十九年十二月三十一日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末				備註
			股數 (仟股)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率 (%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
<b>台灣積體電路公司</b>							
SSMC 股票	被投資公司	長期投資	90	\$935,870	32	\$935,870	
台灣光罩公司股票	-	長期投資	6,887	32,129	2	87,325	
聯亞氣體工業公司股票	-	長期投資	10,058	146,250	10	155,041	
台灣信越半導體公司股票	-	長期投資	10,500	105,000	7	105,476	
普實創業投資公司股票	-	長期投資	5,000	50,000	4	81,059	
台宏半導體公司股票	-	長期投資	50,000	500,000	19	434,385	
宏通創業投資公司股票	-	長期投資	12,000	120,000	10	125,927	
Crimson Asia Capital 受益憑證	-	長期投資	-	64,547	不適用	64,547	
Horizon Ventures Fund 受益憑證	-	長期投資	-	93,304	不適用	93,304	
<b>台積國際投資公司</b>							
3DFX. Interactive Inc. 股票	-	長期投資	68	USD297	-	USD84	
<b>世界先進公司</b>							
VIS Associates Inc. 股票	本公司之子公司	長期投資	23,570	464,077	100	464,077	
力晶半導體公司股票	被投資公司	長期投資	168,488	2,651,216	9	3,315,837	
鈺創科技公司股票	-	長期投資	5,590	310,132	3	278,118	
華新先進電子公司股票	被投資公司	長期投資	31,410	414,481	10	414,481	
米韻科技公司股票	-	長期投資	16,500	177,000	15	177,000	
Form Factor Inc. 股票	-	長期投資	267	64,360	1	64,360	
聯亞氣體工業公司股票	-	長期投資	2,313	29,250	2	29,250	

註一： 期末持股比率等於期中最高持股比率。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表四

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		期末	
				股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益
				(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)	(仟股)	(美金為仟元)		(美金為仟元)
<b>台灣積體電路公司</b>											
台北銀行股票	短期投資	-	-	8,750	\$236,250	-	\$-	8,750	\$288,719	\$236,250	\$52,469
國際萬寶證券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	18,207	230,000	18,207	231,644	230,000	1,644
光華債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	25,495	323,000	25,495	326,273	323,000	3,273
日盛債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	26,382	300,000	26,382	302,604	300,000	2,604
群益安穩收益投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	24,468	300,000	24,468	302,748	300,000	2,748
元大萬泰投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	25,484	300,000	25,484	302,523	300,000	2,523
統一全壘打投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	28,222	332,000	28,222	333,627	332,000	1,627
大華債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	57,900	630,000	57,900	633,522	630,000	3,522
中信債券投資信託基金	短期投資	-	-	-	-	26,842	340,000	26,842	341,476	340,000	1,476
怡富台灣債券基金	短期投資	-	-	-	-	25,593	330,000	25,593	332,564	330,000	2,564
建弘台灣債券基金	短期投資	-	-	-	-	25,556	300,000	25,556	301,955	300,000	1,955
建弘全家福基金	短期投資	-	-	-	-	2,956	410,000	2,956	411,752	410,000	1,752
聯合債券基金	短期投資	-	-	-	-	30,054	330,000	30,054	331,605	300,000	1,605
統一強棒基金	短期投資	-	-	-	-	46,405	600,000	46,405	603,210	600,000	3,210
System on Silicon股票	長期投資	SSMC Manufacturing Company (SSMC)	被投資公司	26	360,177	64	989,690	-	-	-	90 935,870
<b>世界先進公司</b>											
中信債券型基金	-	-	-	-	-	58,761	750,000	58,761	761,731	750,000	11,731
光華債券型基金	-	-	-	-	-	42,671	550,000	42,671	558,584	550,000	8,584
大眾債券型基金	-	-	-	-	-	16,199	180,000	16,199	182,393	180,000	2,393
建弘全家福基金	-	-	-	-	-	3,921	550,000	3,921	558,516	550,000	8,516
元大萬泰基金	-	-	-	-	-	45,921	550,000	45,921	558,212	550,000	8,212
中華富泰基金	-	-	-	-	-	31,415	400,000	31,415	404,997	400,000	4,997
大華債券基金	-	-	-	-	-	21,446	240,000	21,446	242,656	240,000	2,656

註一： 期末金額係包含按權益法認列之投資損益及累積換算調整數。

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表五

單位：新台幣仟元

取得之 公司	財產名稱	交易日 或事實 發生日	交易金額	價款支付 情形	交易對象 關係	交易對象為關係人者， 其前次移轉資料		價格決定之 參考依據	取得目的及 使用之情形	其他約 定事項
						所有人 之關係	與公司 日期			
台灣積體 電路公司	六廠廠房 及辦公室	89/2/16~ 89/12/31	\$3,254,412	依工程進度 互助營造	-	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標 生產使用 無

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

與關係人進、銷貨金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年一月一日至十二月三十一日

附表六

單位：新台幣仟元

交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易及原因不同之情形		應收（付）票據、帳款		備註
		進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率(%)	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	
<b>台灣積體電路公司</b>										
工研院	本公司董事長為其董事	銷貨	\$198,146	-	月結45天	無	無	\$56,078	7	
飛利浦及其聯屬公司	本公司主要股東之一	銷貨	5,289,927	3	發票日後30天	無	無	643,604	82	
<b>世界先進公司</b>										
力晶半導體公司	本公司之被投資公司	進貨	379,405	-	月結45天	無	無	(18,419)	(2)	

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上  
民國八十九年十二月三十一日

附表七

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
台灣積體電路公司	飛利浦及其聯屬公司	本公司主要股東之一	\$643,604	27 天	\$175,828	持續催收	\$193,403	\$-

台灣積體電路製造股份有限公司及其從屬公司

被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊

民國八十九年十二月三十一日

附表八

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期 (損)益	本期認列之投資 (損)益	備註
			本期期末	上期期末	股數 (仟股)	比率 %	帳面金額			
<b>台灣積體電路公司</b>										
Systems on Silicon Manufacturing Company (\$SSMC)	Singapore	半導體晶圓製造	\$1,432,482	\$442,792	90	32	\$935,870	(\$1,480,190)	(\$473,661)	被投資公司

## 二、公司股利政策及執行狀況

### (一) 股利政策（經董事會通過，尚未經股東會同意）

本公司股利政策，依下列原則經股東會決議後分派之：

- 1 除依本條第2項規定以公積分派外，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。但法定盈餘公積已超過資本總額百分之五十時，或於有盈餘之年度所提存之盈餘公積，有超過該盈餘百分之二十數額者，得以其超過部份派充股息及紅利。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，但因本公司屬資金密集之產業，目前正處於營運成長期盈餘之分派以股票股利為優先，亦得以現金股利之方式分派，惟現金股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十（50%）為原則。
- 2 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。

本公司未來三年之股利政策，將依循前述原則分派。因公司處於成長階段，保留盈餘將用以支應再投資為主，預期未來三年之股利仍將以股票股利為主。

(二) 過去二年度與本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：除每股盈餘為新台幣元外，為新台幣仟元

項目	年度		88 年度	89 年度	90 年度 (預估)
	期初實收資本額		60,471,760	76,708,817	129,893,646
本年度配股配息情形	每股現金股利（元）		-	-	-
	盈餘轉增資每股配股數（股）		0.23	0.2555	0.400
	資本公積轉增資每股配股數（股）		-	0.0245	-
營業績效變化情形	營業利益		25,916,619	60,541,105	29,375,645
	營業利益較去年同期增（減）比率（%）		59.96	133.60	(51.48)
	稅後純益		24,559,884	65,106,194	25,737,275
	稅後純益較去年同期增（減）比率（%）		60.06	165.09	(60.47)
	每股盈餘		3.24	5.71	1.50
	每股盈餘較去年同期增（減）比率（%）（註）		59.61	129.32	(62.18)
	年平均投資報酬率（年平均本益比倒數）（%）		2.77	3.90	1.66
擬制性每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘	3.81	6.76	1.84
		擬制年平均投資報酬率（%）	3.25	4.62	2.04
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	-	5.80	-
		擬制年平均投資報酬率（%）	-	3.97	-
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	-	6.89	-
		擬制年平均投資報酬率（%）	-	4.71	-

註：係按盈餘轉增資、資本公積撥充股本及員工紅利配股比例追溯調整後之加權平均發行股數計算。

本公司本表所使用之資料為：

- 1 九十年一月二十九日經會計師查核之八十九年度及八十八年度財務報告。
- 2 九十年四月二十日經會計師複核之九十年度財務預測。
- 3 計算擬制性之資料所使用之稅率係採用有效稅率：九十年為12.17%、八十九年為7.54%及八十八年為5.9%，一年期一般放款利率則是依照台灣銀行一年期放款利率，九十年為7.04%，八十九年及八十八年為7.00%。

公司負責人：



經理：



承辦人：



本表擬制性資料所使用之歷史性財物資訊暨依據之基本假設業經本會計師複核無誤。

簽證會計師：



中華民國九十年四月二十三日

註：

- 1 若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘 = (稅後純益 - 計算現金股利應負擔利息費用 \* (1-稅率)) / (當年底發行股份總數 \* 盈餘配股股數\*\*)  
計算現金股利應負擔利息費用 \* = 盈餘轉增資數額 \* 一年期一般放款利率  
盈餘配股股數\*\*：係就前一年度盈餘分配股票股利所增加股份之股數
- 2 年平均本益比 = 年平均每股市價 / 年度財務報告每股盈餘

### 三、內部控制制度執行狀況

#### (一) 內部控制聲明書



日期：九十年三月六日

本公司民國八十九年元月一日至八十九年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 1 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及管理階層之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 2 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 3 本公司係依據財政部證券暨期貨管理委員會訂頒「公開發行公司建立內部控制制度實施要點」（以下簡稱「實施要點」）規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「實施要點」所採用之內部控制判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制劃分為五個組成要素：（1）控制環境，（2）風險評估，（3）控制作業，（4）資訊及溝通，及（5）監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「實施要點」之規定。
- 4 本公司業已採用上述內部控制判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 5 本公司基於前項評估結果，認為本公司上開期間的內部控制制度，包括與營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 6 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 7 本聲明書業經本公司民國日期：九十年三月六日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣積體電路製造股份有限公司

董事長 張 忠 謂



總經理 曾 繁 城



#### (二) 經證期會要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

### 四、其他必要補充說明事項

前一年度如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重影響之事項，應逐項載明：無



台灣積體電路製造股份有限公司  
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

300 新竹科學工業園區園區三路121號

No. 121, Park Ave. III, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 300, R.O.C.  
Tel: 886-3-578-0221 Fax: 886-3-578-1546  
<http://www.tsmc.com.tw>

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長 張 忠 謂

